

# 목 차

분기보고서 .....	1
【대표이사 등의 확인】 .....	2
I. 회사의 개요 .....	3
1. 회사의 개요 .....	3
2. 회사의 연혁 .....	6
3. 자본금 변동사항 .....	12
4. 주식의 총수 등 .....	14
5. 의결권 현황 .....	14
6. 배당에 관한 사항 등 .....	15
II. 사업의 내용 .....	17
III. 재무에 관한 사항 .....	43
IV. 감사인의 감사의견 등 .....	50
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 .....	53
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 .....	54
1. 이사회에 관한 사항 .....	54
2. 감사제도에 관한 사항 .....	60
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 .....	62
4. 계열회사 등의 현황 .....	62
VII. 주주에 관한 사항 .....	73
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .....	79
1. 임원 및 직원의 현황 .....	79
2. 임원의 보수 등 .....	83
IX. 이해관계자와의 거래내용 .....	86
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 .....	88
XI. 재무제표 등 .....	95
XII. 부속명세서 .....	110
【전문가의 확인】 .....	112
1. 전문가의 확인 .....	112
2. 전문가와의 이해관계 .....	112

# 분기보고서

(제 66 기)

사업연도      2013년 01월 01일      부터  
                  2013년 09월 30일      까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2013년      11월      14일

회 사 명 :                    에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :                박 성 욱

본 점 소 재 지 :            경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091  
(전 화) 031-630-4114

(홈페이지) <http://www.skhynix.com>

작 성 책 임 자 :            (직 책) 재경실장            (성 명) 이 명 영  
(전 화) 02-3459-5541~8

## 【 대표이사 등의 확인 】

### 확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 내용이 기재 또는 표시사항을 이용하는자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

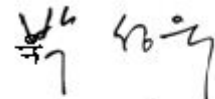
또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2013. 11. 14

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사

박 성



공시 책임자

이 병 영



# I. 회사의 개요

## 1. 회사의 개요

에스케이하이닉스는 이천, 청주의 국내 사업장을 비롯하여 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 생산 공장과 10개 판매 법인 및 18개의 국내외 사무소를 두고 있는 글로벌 기업으로서 지속적인 연구개발 및 투자로 기술 및 원가 경쟁력을 확보하고 있으며, 세계 반도체시장을 선도하기 위해 노력하고 있습니다.

당사의 개요와 관련한 보다 자세한 내용은 다음과 같습니다.

### 가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도 도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
에스케이하이엔지(주)	2001.04	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	47,917	의결권 과반수 소유	X
에스케이하이텍(주)	2008.03	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	22,748	의결권 과반수 소유	X
SK hynix America Inc.(SKHYA)	1983.03	3101 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A.	반도체 판매	867,351	의결권 과반수 소유	○
Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc.(HSMA)	1995.07	1830 Willow Creek Circle, Eugene OR,97104, U.S.A.	반도체 생산	52,500	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	1989.03	Am Prime Parc 13, Kelsterbacher Str.16, D- 65479 Raunheim, Germany	반도체 판매	82,039	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Europe Holding Ltd.(SKHYE)	1995.07	243 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 ORH, U.K.	해외현지 투자 지주회사	199,518	의결권 과반수 소유	○
SK hynix U.K. Ltd.(SKHYU)	1995.07	243 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 ORH, U.K.	반도체 판매	81,677	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Asia Pte.Ltd.(SKHYS)	1991.09	7 Temasek Boulevard #42-02 Suntec City Tower1 Singapore 038987	반도체 판매	146,471	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Semiconductor India PrivateLtd.(SKHYIS)	2006.11	Unit 10, Level 8, Innovator Building, ITPB(International Technology Park Bangalore), Whitefield Road, Bangalore 560066, India	반도체 판매	837	의결권 과반수 소유	X
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SKHYH)	1995.04	Suite 2401, 24F., Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong	반도체 판매	326,673	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(SKHYCS)	2001.08	Room 2702-2705, Maxdo Center, No.8, Xing Yi RD, Changning Zone, Shanghai, China	반도체 판매	54,294	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	1996.09	23F SHIROYAMA TRUST TOWER, 4-3-1 Toranomom, Minatoku, Tokyo	반도체 판매	194,729	의결권 과반수 소유	○

SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SKHYT)	1996.07	11F, No.392, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei11492, Taiwan, R.O.C.	반도체 판매	276,666	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	2005.04	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in WuxiNew District, Wuxi, Jiangsu Province, China	웨이퍼 생산 및 판매	3,234,346	의결권 과반수 소유	○
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	2006.04	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in WuxiNew District, Wuxi, Jiangsu Province, China	웨이퍼 생산 및 판매	246,213	의결권 과반수 소유	○
SK hynix(Wuxi) Semiconductor SalesLtd.(SKHYCW)	2010.08	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in WuxiNew District, Wuxi, Jiangsu Province, China	반도체 판매	933	의결권 과반수 소유	X
SK hynix Italy S.r.l.(SKHYIT)	2012.05	V.le Colleoni 15, Palazzo Orione 20864 Agrate Brianza (MB), Italy	기술센타	3,240	의결권 과반수 소유	X
SK hynix memory solutions Inc.(SKHMS)	2012.08	2550 Walsh Avenue, Suite 200, Santa Clara, CA 95051	기술센타	7,373	의결권 과반수 소유	X
SK hynix Flash Solution Taiwan(SKHYFST)	2013.08	6F-1, No.6, Taiyuen 1st St. (Taiyuen Hi-Tech Industrial Park), Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan	기술센타	-	의결권 과반수 소유	X
SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)	2013.09	Suite 1707-08, 17/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong	해외현지투자 지주회사	-	의결권 과반수 소유	X
SK hynix Semiconductor(Chongqing) Ltd.(SKHYCQL)	2013.09	6-8, zongbao st., Shapingbaq, Choongching, China	웨이퍼 생산 및 판매	-	의결권 과반수 소유	X

※ 주요 종속회사 판단기준: 직전 사업연도말 자산총액 500억원 이상

## 나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 에스케이하이닉스 주식회사이며, 영문으로는 SK hynix Inc.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 SK하이닉스 또는 SK hynix라고 표기합니다.

## 다. 설립일자

당사는 1949년 10월 국도건설 주식회사로 설립되어 1983년 2월 현대전자산업주식회사로 상호를 변경하였으며, 이후 2001년 3월 주식회사 하이닉스반도체로, 2012년 3월 에스케이하이닉스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '000660'입니다.

## 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소: 경기도 이천시 경충대로 2091  
전화번호: 031-630-4114  
홈페이지: <http://www.skhynix.com>

## 마. 주요 사업의 내용

현재 당사의 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반

도체 제품이며, 2007년부터는 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에 재진출하여 종합반도체 회사로 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

당사 정관에 근거하여 현재 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

- 반도체소자 제조 및 판매
- 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매
- 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업
- 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업
- 기계부분품 제조업 및 금형제조업
- 기술연구 및 용역수탁업
- 전자 전기기계, 기구의 임대업
- 특수통신(위성통신 등) 방송관련 기기 제작, 판매, 임대업 및 서비스업
- 정보서비스업
- 출판업
- 무역업
- 부동산 매매 및 임대업
- 발전업
- 건설업
- 전자관 제조업
- 창고업
- 주차장업
- 위성통신사업
- 전기통신회선설비 임대사업
- 전자상거래 및 인터넷 관련사업
- 전기 각호와 관련되는 사업 및 투자

사업부문별 보다 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

### 바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(1) 기업집단의 명칭 : SK계열

(2) 기업집단에 소속된 회사 (2013. 9. 30일 기준 계열사 : 83개사)

업종	상장사	비상장사
지주회사(1)	SK(주)	-
에너지·화학 (34)	SK이노베이션(주), SK케미칼(주), SKC(주), SK가스(주), (주)부산도시가스	SK E&S(주), SK에너지(주), SK종합화학(주), SK루브리컨츠(주), (주)대한송유관공사, SK모바일에너지(주), 충청에너지서비스(주), 영남에너지서비스(주), 이니츠(주), 전북에너지서비스(주), 전남도시가스(주), 강원도시가스(주), 평택에너지서비스(주), 엔티스(주), SK유화(주), SKC에어가스(주), 코원에너지서비스(주), SK더블유(주), 유베이스매뉴팩처링아시아(주), 울산아로마틱스(주), 김천에너지(주), 피엠티(주), 위례에너지서비스(주), 하남에너지서비스(주), 지허브(주), SK인천석유화학(주), SK트레이딩인터내셔널(주), 보령LNG터미널(주), SK컨티넨탈이모션코리아(주)

정보통신/ 전기전자 (22)	SK텔레콤(주), (주)로엔엔터테인먼트, SK커뮤니케이션즈(주), SK브로드밴드(주), SK C&C(주), SK하이닉스(주), (주)실리콘화일, SKC솔믹스(주)	SK플래닛(주), SK텔레시스(주), SK텔링크(주), 인포섹(주), (주)커머스플래닛, 텔레비전미디어코리아(주), 서비스에이스(주), 서비스탑(주), 네트워크앤에스(주), SKC라이팅(주), (주)에이앤티에스, 엘씨앤씨(주), 비젠(주), 피에스앤마케팅(주)
건설/물류/서비스 (21)	SK네트웍스(주)	SK건설(주), SK해운(주), 행복나래(주), SK디앤디(주), 엠앤서비스(주), SK에스엠(주), 에프앤유신용정보(주), SK네트웍스서비스(주), 리얼베스트(주), SK핀크스(주), 내트럭(주), 앤츠개발(주), SK신택(주), 스피드모터스(주), SK하이이엔지(주), 엠케이에스개런티(유), SK임업(주), 대전맑은물(주), 광주맑은물(주), SK하이스텍(주)
금융(1)	SK증권(주)	-
기타(4)	(주)유비케어	SK바이오팜(주), SK와이번스(주), 제주유나이티드FC(주)

(\*) 사명 변경 : 울산아로마틱스(주) (舊 아로케미(주)), 행복나래(주) (舊 엠알오코리아(주)), 비젠(주) (舊 텔스크(주)),  
SK하이스텍(주) (舊 (주)하이스텍), SK하이이엔지(주) (舊 (주)하이닉스엔지니어링),  
엔티스(주) (舊 SK사이텍(주))

## 사. 신용평가에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 당사의 신용등급은 다음과 같습니다.

구분	평가기관	현등급	최종평가일
국내	NICE신용평가	A+	2013.06.27
	한국기업평가	A+	2013.06.20
	한국신용평가	A+	2013.06.20
해외	Moody's	Ba2	2013.08.20
	S&P	BB	2013.02.22

최근 3개 사업연도 신용등급과 관련한 상세 내역 및 각 등급에 따른 정의는 본 보고서 'II. 11. 나. 최근 3년간 신용등급'을 참고하여 주시기 바랍니다.

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립 이후의 중요한 변동사항

#### (1) 회사의 주된 변동내용

- 1949. 10     국도건설 주식회사 설립
- 1983. 02     현대전자산업주식회사로 상호 변경
- 1996. 12     기업공개 및 상장
- 1997. 03     대표이사 김영환 외 이사 5인 변경 선임

- 이사 5인, 감사 1인 변경 선임
1999. 05 LG그룹과 LG반도체 주식 양수도 계약 체결
1999. 07 LG반도체 대주주 지분 인수
1999. 10 현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병
2000. 03 박종섭 대표이사 외 이사 1인, 감사위원 2인 변경 선임
2000. 05 전장사업부문 (주)현대오토넷으로 분사
2000. 08 모니터사업부문 "현대이미지퀘스트(주)"로 분사
2001. 03 주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경  
박상호 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
2001. 05 통신단말기 사업부문 "현대큐리텔"로 분사  
통신 ADSL 사업부문 "현대네트웍스"로 분사
2001. 07 통신 네트워크 사업부문 "현대시스콤"으로 분사
2001. 08 현대그룹으로부터 계열분리
2001. 10 채권금융기관 공동관리 시작
2001. 12 현대큐리텔, '팬택 컨소시엄'에 지분 매각
2002. 01 현대시스콤, '쓰리알'에 지분 매각
2002. 05 시러스 로직社와 파운드리 전략적 장기공급 계약체결  
박종섭 대표이사 사임
2002. 06 최대주주 변경(현대상선(주) → (주)한국외환은행)
2002. 07 우의제 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
2002. 12 현대네트웍스, '엠비엔'에 지분 매각
2003. 02 박상호 대표이사 사임
2003. 04 STMicro社와 낸드플래시 메모리 공동 개발 및 파운드리 공급 계약 체결
2003. 06 환경/안전/보건 기술연구소 설립
2004. 06 매그나칩반도체 유한회사와 비메모리 사업부문 영업양도계약 체결
2004. 08 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시와 중국 현지공장설립 협력계약 체결
2004. 10 비메모리 사업부문 영업양도
2004. 11 STMicro社와 중국 현지 합작공장설립을 위한 협력계약 체결
2005. 03 황학중, 김덕수, 민형욱, 이준호 사외이사 선임  
박시룡, 장윤중 사외이사 임기만료 퇴임
2005. 07 채권금융기관 공동관리 조기종료  
현대이미지퀘스트(주), (주)빅터스캐피탈코리아에 지분 매각
2005. 10 (주)현대오토넷 지분매각 완료  
출자전환주식 공동관리협의회 1차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일 )
2006. 03 권오철 이사, 손방길 사외이사 선임, 정형량 이사 임기만료 퇴임
2006. 04 중국 현지생산법인(HSMC) 설립
2006. 06 출자전환주식 공동관리협의회 2차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일 )



2006. 09 300mm 연구소(R3 R&D Fab) 개소
2007. 03 김종갑 대표이사 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 4인 포함) 선임  
 - 이사 선임: 김종갑, 최진석  
 - 사외이사 선임: 박종선, 김경한, 조동성, 김형준  
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 황학중, 민형욱, 손방길, 손성호  
 우의제 대표이사 임기만료 퇴임  
 이사 1인(오춘식), 사외이사 4인(김범만, 김수창, 이선, 이준호) 임기만료 퇴임
2007. 04 청주 신규 M11(300mm) 공장 착공
2007. 07 공정거래 자율준수프로그램 도입
2007. 10 환경운동연합과 '환경경영검증위원회' 협약 체결
2007. 11 '일하는 이사회'를 위한 신(新)이사회 제도 도입
2008. 02 김경한 사외이사 중도 퇴임
2008. 03 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임  
 - 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 정홍원, 최장봉  
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈  
 사외이사 3인(황학중, 민형욱, 손방길) 임기만료 퇴임
2008. 06 정홍원 사외이사 중도 퇴임
2009. 03 권오철 이사 재선임 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임  
 - 이사 선임: 권오철, 박성욱  
 - 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 최장봉, 한부환  
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈
2009. 11 중국 후공정 합작사 HITECH 설립
2010. 03 최대주주 변경((주)한국외환은행 → 한국정책금융공사)  
 최대주주 변경(한국정책금융공사 → 미래에셋자산운용투자자문(주))  
 권오철 대표이사외 이사 1인 신규 선임, 김종갑 이사 재선임  
 사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임  
 - 이사 선임: 김종갑, 권오철, 김민철  
 - 사외이사 선임: 박종선, 전인백, 한부환, 최장봉, 정병태, 김형준  
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑종, 송재용, 김창호
2010. 06 중국 후공정 합작공장 HITECH 준공
2010. 08 최대주주 변경(미래에셋자산운용투자자문(주) → 한국정책금융공사)
2010. 10 최대주주 변경(한국정책금융공사 → 국민연금공단)
2011. 03 사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임  
 - 사외이사 선임: 한부환, 전인백, 정병태, 이달곤, 김갑희, 정상환  
 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑종, 송재용, 조현명
2011. 09 정상환 사외이사 중도 퇴임
2012. 02 최대주주 변경(국민연금공단 → 에스케이텔레콤(주))  
 사외이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임

- 이사 선임: 최태원, 하성민, 박성욱
  - 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 윤세리, 김대일, 이창양
  - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양
2012. 06 낸드플래시 개발업체 아이디어플래시(Ideafly S.r.l.) 인수,  
이탈리아 기술센터(SK Hynix Italy S.r.l.) 전환 설립
- 미 컨트롤러 업체 LAMD(Link\_A\_Media Devices) 인수 본계약 체결
2012. 09 플래시 솔루션 디자인 센터 설립
2013. 03 김준호 사내이사 1인 신규 선임

## (2) 주요종속회사의 주된 변동내용

1983. 03 미국 현지법인(HSA) 설립
1989. 03 독일 현지법인(HSD) 설립
1991. 08 싱가포르 현지법인(HSS) 설립
1995. 04 홍콩 현지법인(HSH) 설립
1995. 07 영국 현지법인(HSE) 설립  
영국 현지판매법인(HSU) 설립
1995. 08 미국 생산법인(HSMA) 설립
1996. 07 대만 현지법인(HST) 설립
1996. 09 일본 현지법인(HSJ) 설립
2001. 05 사업지원 서비스부문 "(주)현대아스텍" 분사
2001. 07 LCD 사업부문 "(주)현대디스플레이테크놀로지"로 분사
2001. 08 중국 현지판매법인(HSCS) 설립
2001. 12 "에스알씨(주)" 분사
2002. 11 "(주)현대디스플레이테크놀로지" TFT-LCD 사업부문 매각
2005. 04 중국 합작법인(HSSL) 설립  
에스알씨(주)→(주)큐알티반도체 사명 변경  
(주)현대아스텍→(주)아스텍 사명 변경
2006. 04 중국 현지생산법인(HSMC) 설립
2006. 10 중국 현지생산법인(HSMC) 준공
2007. 01 인도 현지법인(HSIS) 설립
2008. 03 (주)아스텍에서 (주)하이닉스인재개발원 분할  
(주)아스텍에서 (주)하이닉스로 분할  
(주)아스텍에서 (주)하이로지텍으로 분할  
(주)아스텍에서 (주)하이닉스엔지니어링으로 분할
2010. 01 (주)하이닉스엔지니어링에서 (주)아미파워로 분할
2010. 08 중국 현지판매법인(HSCW) 설립
2011. 09 "(주)현대디스플레이테크놀로지" 청산, 주요종속회사 제외

"프로모스엔에이치유한회사, 티와이프로주식회사, 외환은행특정금전신탁" 청산, 주요 종속회사 제외

- 2012. 10 (주)하이닉스엔지니어링, (주)큐알티반도체 흡수합병  
(주)하이스텍, (주)하이로지텍/(주)하이닉스인재개발원 흡수합병
- 2012. 10 (주)하이닉스엔지니어링→에스케이하이이엔지(주) 사명 변경  
(주)하이스텍→에스케이하이스텍(주) 사명 변경

#### 나. 상호의 변경

- 1983. 02 현대전자산업주식회사로 상호 변경
- 2001. 03 주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경
- 2012. 03 에스케이하이닉스 주식회사로 상호 변경

#### 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수·양도 등

- 1999. 10 현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병
- 2004. 10 비메모리 사업부문 영업양도
- 2011. 11 에스케이텔레콤, 하이닉스반도체 지분인수계약

#### 라. 생산설비의 변동

- 2006. 10 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 C2(300mm), C1(200mm)공장 준공
- 2008. 07 미국 유진 공장 E1(200mm) 가동 중단
- 2008. 08 청주 신규 NAND Flash 전용 M11공장(300mm) 준공
- 2008. 09 이천 M7(200mm) 및 청주 M9(200mm) 공장 가동 중단
- 2008. 12 중국 C1(200mm) 공장 가동 중단
- 2010. 06 중국 후공정 합작공장 HITECH 준공
- 2012. 06 청주 신규 NAND Flash 전용 M12공장(300mm) 준공

#### 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

- 2005. 01 전력 소모 30% 줄인 서버용 메모리 모듈 개발
- 2005. 01 대만 프로모스社와 전략적 제휴를 위한 본계약 체결
- 2005. 07 2GB DDR2-667 노트북용 모듈 업계 최초 인텔社 인증 획득
- 2005. 07 당사 출자전환 주식 공동관리 협의회와 '특별 약정' 체결
- 2005. 11 JEDEC 표준형 8GB DDR2 R-DIMM과 2GB DDR VLP R-DIMM 개발
- 2005. 12 512Mb GDDR4 DRAM 개발
- 2006. 03 80나노 512Mb DDR2 DRAM 인텔社 인증 획득
- 2006. 12 200Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발  
60나노급 1Gb DDR2 기반 1GB DDR2 800Mbps 모듈 개발

- 2007. 03 ECC회로 적용한 185Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발
- 2007. 04 퓨전메모리 제품 DOC(Disk On Chip) H3 양산
- 2007. 05 80나노 DDR3 1Gb DRAM 단품 및 모듈 인텔사 인증 획득  
초박형(25 $\mu$ m) 20단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package) 개발
- 2007. 08 200Mbps 1Gb 모바일 DRAM 개발  
이노베이티브 실리콘사와 신개념 메모리 'ZRAM' 라이선스계약 체결
- 2007. 09 초박형(25 $\mu$ m) 24단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package)개발
- 2007. 10 오보닉스사와 차세대 메모리 'PRAM' 기술 라이선스 계약 체결
- 2007. 11 1Gb GDDR5 개발  
50나노급 1Gb DDR2 DRAM 인텔사 인증 획득  
실리콘화일사와 CMOS 이미지 센서(CIS) 사업 추진을 위한 협력 계약 체결
- 2008. 01 50나노급 1GB/2GB DDR2 모듈 인텔사 인증 획득
- 2008. 03 피델릭스사와 전략적 제휴를 위한 협력계약 체결
- 2008. 04 그란디스사와 'STT-RAM' 라이선스 및 공동개발계약 체결
- 2008. 05 프로모스사와 포괄적 제휴 협력 계약 체결
- 2008. 06 파이슨사와 낸드플래시 응용제품 기술에 대한 사업협력계약 체결  
실리콘화일사 지분취득 결정 및 기존 파운드리 계약범위 확대  
3중셀(X3) 기술 기반 32Gb 낸드플래시 개발
- 2008. 07 씨엔에스테크놀로지사와 시스템반도체 공동개발 및 파운드리 협력계약 체결
- 2008. 08 뉴모닉스사와 낸드플래시 기술 및 제품 공동 개발 협력계약 체결  
16GB 서버용 모듈 개발
- 2008. 12 8단 적층 낸드플래시 개발  
50나노급 2Gb 고용량 모바일 DRAM 개발
- 2009. 01 DDR3 서버용 모듈 4GB ECC UDIMM 인텔사 인증 획득
- 2009. 02 40나노급 DDR3 DRAM 개발
- 2009. 05 뉴모닉스사 및 파이슨사와 낸드플래시 응용제품용 컨트롤러 3자 공동개발 계약 체결  
중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 무석산업발전집단유한공사와 합작 반도체 후공정 전문회사 설립을 위한 본계약 체결
- 2009. 06 4GB 1333Mbps 노트북용 모듈 외 10건 인텔사 DDR3 전용 플랫폼 인증획득
- 2009. 07 대만 프로모스사와 전략적 제휴 협력계약 종결
- 2009. 08 50나노급 4Gb 모바일 DRAM 인텔사 인증 획득
- 2009. 10 2세대 1Gb DDR3 개발
- 2009. 12 40나노급 2Gb GDDR5 개발
- 2010. 01 40나노급 2Gb 모바일 DRAM 개발
- 2010. 02 20나노급 64Gb 낸드플래시 개발
- 2010. 09 휴렛팩커드(HP)사와 Re램 공동개발 계약 체결
- 2010. 12 30나노급 4Gb DDR3 개발
- 2011. 03 30나노급 2Gb DDR4 개발
- 2011. 07 도시바사와 STT-MRAM 공동개발 및 합작사 설립을 위한 공동생산 계약 체결

2012. 03	30나노급 2Gb DDR3 저탄소제품 인증 획득
2012. 04	스팬션사와 특허사용 크로스라이선스 및 SLC낸드플래시 공급계약 체결
2012. 06	IBM社와 PC램 공동개발 및 기술 라이선스 계약 체결
2012. 08	20나노급 64Gb 낸드플래시 저탄소제품 인증 획득
2012. 09	20나노급 4Gb 그래픽 DDR3 개발
2013. 06	20나노급 8Gb LPDDR3 개발 램버스사와 포괄적 특허 라이선스 계약 체결
2013.07	삼성전자와 반도체 특허 크로스라이선스 계약 체결
2013.10	20나노급 6Gb LPDDR3 개발

### 3. 자본금 변동사항

#### 가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2013년 09월 30일 )

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		주식의 종 류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2008년 01월 23일	주식매수선택 권행사	보통주	45,200	5,000	5,000	
2008년 07월 16일	주식매수선택 권행사	보통주	328,962	5,000	5,000	우리사주매수 선택권행사
2009년 01월 17일	유상증자(일반 공모)	보통주	60,000,000	5,000	5,400	
2009년 02월 18일	주식매수선택 권행사	보통주	18,260	5,000	5,000	
2009년 05월 06일	전환권행사	보통주	12	5,000	24,184	
2009년 05월 19일	유상증자(일반 공모)	보통주	70,000,000	5,000	10,350	
2009년 06월 23일	주식매수선택 권행사	보통주	4,600	5,000	5,000	
2009년 08월 13일	전환권행사	보통주	8,731	5,000	23,328	2009.08.13~ 2009.09.21
2009년 09월 22일	주식매수선택 권행사	보통주	3,740	5,000	5,000	
2009년 12월 14일	전환권행사	보통주	428	5,000	23,328	
2010년 01월 04일	전환권행사	보통주	28,608	5,000	23,328	2010.01.04~2 010.03.22

2010년 04월 01일	전환권행사	보통주	565,120	5,000	23,328	2010.04.01~2 010.06.25
2010년 07월 08일	전환권행사	보통주	44,150	5,000	23,328	2010.07.08~2 010.09.01
2010년 10월 29일	전환권행사	보통주	115	5,000	23,328	2010.10.29~2 010.11.16
2011년 01월 13일	전환권행사	보통주	434,385	5,000	23,328	2011.01.13~2 011.03.25
2011년 04월 01일	전환권행사	보통주	1,460,643	5,000	23,328	2011.04.01~2 011.06.10
2012년 01월 27일	전환권행사	보통주	855	5,000	23,328	2012.01.27~2 012.02.13
2012년 02월 14일	유상증자(제 3차배정)	보통주	101,850,000	5,000	23,000	
2012년 02월 15일	전환권행사	보통주	4,159	5,000	23,328	2012.02.15~2 012.02.23
2012년 04월 06일	전환권행사	보통주	3,000	5,000	23,328	
2012년 05월 02일	주식매수선택 권행사	보통주	93,500	5,000	22,800	우리사주매수 선택권행사
2012년 05월 04일	전환권행사	보통주	428	5,000	23,328	
2012년 08월 20일	전환권행사	보통주	21	5,000	23,328	
2012년 10월 30일	주식매수선택 권행사	보통주	30,300	5,000	22,800	우리사주매수 선택권행사
2012년 12월 07일	전환권행사	보통주	3,016	5,000	23,328	2012.12.07~2 012.12.18
2013년 02월 13일	전환권행사	보통주	9,527	5,000	23,328	2013.02.13~ 2013.03.28
2013년 04월 01일	전환권행사	보통주	551,689	5,000	23,328	2013.04.01~ 2013.06.27
2013년 07월 02일	전환권행사	보통주	15,483,908	5,000	23,328	2013.07.02~ 2013.08.05

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2013.09.30 )

(단위 : 원, 주)

종류 \ 구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상 주식의 종류	전환청구가 능기간	전환조건		미상환사채		비고
						전환비율 (%)	전환가액	권면총액	전환가능주식 수	
제7회 해외 공모	2010년 05월 14일	2015년 05월 14일	US\$500,000,000	보통주	2011.05.15 ~	100	34,394	US\$500,000,000	16,482,526	-

무보증 전환사채					2015.04.28					
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	16,482,526	-

※ 상기 '권면총액'은 최초발행시의 권면총액이며, '미상환사채의 권면총액'은 기준일 현재의 잔액 기준임.

## 4. 주식의 총수 등

### 가. 주식의 총수

2013년 09월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 9,000,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,704,178,735주입니다. 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다. 당기말 현재의 유통주식수는 보통주 710,200,891주 입니다.

(기준일 : 2013년 09월 30일 )

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류			비고
	보통주	우선주	합계	
I. 발행할 주식의 총수	9,000,000,000	-	9,000,000,000	-
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,704,178,735	-	5,704,178,735	-
III. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,993,977,844	-	4,993,977,844	-
1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타	4,990,449,799	-	4,990,449,799	2003.03.31, 주식병합 (21:1)
	3,528,045	-	3,528,045	2000.03.31, 이익소각
	-	-	-	-
	-	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)	710,200,891	-	710,200,891	-
V. 자기주식수	-	-	-	-
VI. 유통주식수 (IV-V)	710,200,891	-	710,200,891	-

## 5. 의결권 현황

(기준일 : 2013년 09월 30일 )

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	710,200,891	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	710,200,891	-
	우선주	-	-

## 6. 배당에 관한 사항 등

### 가. 배당에 관한 사항

정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다.

#### (1) 제52조(이익배당)

- ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당 할 수 있다.

#### (2) 제54조(중간배당)

- ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.
- ③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
- ④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
- ⑤ 제53조(배당금 지급청구권의 소멸시효)는 중간배당의 경우에 준용한다.

### 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제66기 3분기	제65기	제64기
주당액면가액 (원)		5,000	5,000	5,000
당기순이익 (백만원)		2,131,937	-489,990	129,142
주당순이익 (원)		3,002	-719	218
현금배당금총액 (백만원)		-	-	-
주식배당금총액 (백만원)		-	-	-



현금배당성향 (%)		-	-	-
현금배당수익률 (%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주식배당수익률 (%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 주식배당 (주)	-	-	-	-
	-	-	-	-

※ 별도재무제표 기준으로 작성되었으며, 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

## II. 사업의 내용

### 1. 사업의 개요

#### 가. 업계의 현황

##### (1) 산업의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다. 시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2013년 9월, 금액기준)에 따르면, 지난 2012년도 세계 반도체 시장규모는 US\$2,999억에 이르렀으며, 이중 메모리 제품은 US\$557억의 시장규모를 기록하며 전체 반도체 시장의 약 19% 수준에 달하였습니다. 또한 메모리 반도체 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 DRAM은 지난 2012년 US\$262억을 기록하며 전체 메모리 시장의 약47%를 차지하였고, 그 뒤를 이어 낸드플래시가 US\$235억으로42%, 노어플래시가 US\$33억으로 6%를 차지하였습니다.

아래 표에 나타낸 바와 같이 반도체 산업은 우리 나라 산업 생산 및 수출에 있어서 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 2012년에는 세계 경기 침체로 인해 전세계 반도체 시장 규모가 축소되었음에도 불구하고, 프로세서와 컨트롤러 등의 성장에 힘입어 반도체 수출이 전년 대비 0.1% 증가하였습니다. 또한 우리 나라 전체 수출액 중 반도체의 비중은 9.3%로 중요 수출품의 자리를 차지하고 있습니다.

※ 전체 수출중 반도체 비중

(단위: 백만USD, %)

구분	2012	2011	2010	2009	2008
총수출	548,076	555,214	466,384	363,534	422,007
반도체	50,949	50,879	51,464	31,918	32,792
전년비 증감율	0.1	-1.1	61.2	-2.7	-16
비중	9.3	9.2	11.0	8.8	7.8

출처 : 관세청, 2013년 1월

특히, 반도체 수출의 대부분은 메모리 반도체 산업을 통해 이룬 것으로, 메모리 반도체는 우리나라 최대의 수출 산업입니다. 이러한 메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.

반도체 제품을 직접 설계하고 제조, 판매까지 하는 업체들을 가리켜 IDM이라고 하는데 이들은 자체 디자인 능력, 제조 노하우(know-how) 및 생산 설비 등을 바탕으로 비 IDM(non-IDM) 업체들에 비해 독자적 기술개발력과 제조 경쟁력을 확보함으로써 산업 내에서의 위치를 더욱 확고히 하고 있습니다. (DRAM 상위 4개 업체의 시장 점유율: 1990년 49% →2012년 90%, 출처: 가트너, 매출액 기준)

##### 가) 메모리 반도체

정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과 '비휘발성(Non-

volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시메모리를 생산하고 있습니다.

#### [DRAM(Dynamic Random Access Memory)]

DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory)로 사용되고 있으며, 가전 제품의 디지털화에 따라 스마트 TV, 스마트 냉장고 그리고 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다. 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿 PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있습니다.

#### [플래시메모리(Flash Memory)]

플래시메모리는 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code저장형)과 낸드(NAND)형(Data저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이 중 당사가 생산하는 낸드플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다.

낸드플래시 제품이 주로 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 네비게이션, SSD(Solid State Drive) 그리고 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 모바일 기기 등입니다. 한편, 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품개발 및 철저한 고객대응의 중요성이 커지고 있습니다.

#### 나) 비메모리 반도체

##### [CIS(CMOS Image Sensor)]

논리적 연산 등 정보처리기능을 담당하는 비메모리 반도체 중에서도, 이미지센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 두 가지 타입으로 나뉩니다. 최근 CMOS 이미지센서의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영기기가 소형화됨에 따라, 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서의 활용 범위가 점차 확대되고 있으며, 디지털 일안 반사식 카메라와 캠코더 등 고화질을 요구하는 고가 제품에도 많이 사용되는 추세입니다. 이에 따라 CIS 시장에서는 기술 경쟁력과 원가 경쟁력이 점차 중요한 성공 요인으로 부각되고 있습니다.

## (2) 산업의 성장성

메모리 반도체 산업은 2010년 이후 새로운 IT 기기의 등장과 디지털 기기의 모바일화, 스마트화로 역대 최대 매출을 기록한 이후 2011년에는 유럽 재정 위기 해소가 더디게 진행되고 주요 수요처인 PC 시장 정체로 인해 시장 성장세가 다소 주춤하였습니다. 그러나 2012년 하반기 이후 반등하는 양상을 보이고 있으며, 2013년에는 2010년의 수준을 뛰어넘는 최대 매출이 기대되고 있습니다. 또한 DRAM 수요는 PC에서 모바일 영역으로, NAND 수요는 모바일에서 PC영역으로 주요 수요처가 확대됨에 따라 향후 지속적인성장이 예상됩니다.

시장의 지속 성장 전망에 반해 생산(공급) 측면에서는 어려움이 예상됩니다. 공정 미세화 기술은 한계에 다다르고 있으며, 생산 및 연구 개발을 위한 투자 비용 급증, 고객들의 요구 성능과 품질 수준은 더욱 다양화, 고도화되고 있어 선발업체와 후발업체의 기술 및 원가 경쟁력 격차가 점차 확대되고 있습니다. 이에 기존과 같이 외형 경쟁을 위한 공급 확대는 제한적일 것으로 보입니다. 향후 메모리 반도체 산업은 안정적 수요와 제한적인 공급으로 인해 메모리 시장 성장의 기회가 더욱 증대할 것으로 예상됩니다.

#### [DRAM]

시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2013년 9월, 금액기준)에 따르면, DRAM 시장은 세계 경제 침체의 영향으로 인한 PC 수요 감소로 2012년에는 2011년 보다 11.3% 하락한 US\$262억을 기록했습니다. 반면, 2013년에는 점진적 경기 회복 및 모바일 시장 확대, 공급 안정 등의 요인으로 전년대비 34% 상승한 \$350억의 매출을 거둘 것으로 예상됩니다. 분야별로 살펴 보면, PC 시장은 경기 침체로 인한 저성장 기조가 유지되어 DRAM 수요를 견인하는데 어려움을 겪고 있으나, 개인용 컴퓨터의 이동성(Mobility)에 대한 요구가 증가함에 따라 노트북 컴퓨터로의 교체 및 신규 수요가 확대될 전망입니다. 이에 개인용 컴퓨터 중 울트라북을 포함한 노트북의 출하 비중이 2017년 65%에 이를 것으로 업계는 예상하고 있습니다. 또한 디지털 기기의 스마트화 및 모바일화의 진전에 따라 스마트폰은 2017년까지 연평균 19% 성장(Gartner, 2013년 9월, Shipment 기준), 태블릿 PC는 연평균 26% 성장(Gartner, 2013년 9월, Shipment 기준)하는 등 모바일 기기 수요의 폭발적 증가가 예상되며, 대용량의 콘텐츠를 처리할 수 있는 그래픽 메모리의 수요도 지속 증가할 전망입니다. 이와 같이 DRAM 수요 확대에 따른 수량 증가 뿐만 아니라 대용량 콘텐츠 처리를 위한 기기당 탑재량 증가에 따라 DRAM 수요는 앞으로도 지속 증가할 것으로 예상됩니다.

#### [낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 디지털 미디어의 성장과 더불어 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털 카메라, MP3 플레이어 그리고 기타 멀티미디어 가전에 사용되는 플래시카드와 USB 드라이브, SSD와 같은 정보저장장치(Storage Devices)등에 널리 사용되고 있습니다.

가트너(Gartner, 2013년 9월, 금액기준)의 전망에 따르면 낸드플래시 시장은 글로벌 경기 침체에도 불구하고 2011년에 약 18% 정도 성장하였습니다. 2012년에는 다소 성장이 정체되어 -3%로 역성장 하였으나, 2013년에는 SSD 등 스토리지 분야 적용 확대를 통해 24%(\$291억)의 고성장이 전망됩니다. 또한 스마트폰을 포함한 휴대전화 시장에서의 메모리 카드 채용 및 울트라북의 노트북용 SSD, 응용복합 제품 등 향후 낸드플래시의 수요를 견인할 제품 시장이 지속 성장하고 있어, 지속적인 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.

#### [CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지센서는 1990년대 중반 디지털 카메라에 장착되어 일반 소비자에게 선보인 이후 PC 카메라, 자동차 블랙박스, 휴대폰카메라, 감시카메라 등 다양한 분야에 활용되어 시장 규모도 크게 증가하는 추세입니다. 특히 DSLR 카메라 및 휴대폰 카메라 시장의 수요 증가로 시장이 지속 성장할 것으로 보입니다. 가트너(Gartner, 2013년 9월, 금액기준)의 전망에 따르면 이미지센서 시장은 2017년 US\$133억 규모로 2012년 이래 연평균 7.5%의 성장이 예상되며, 특히 당사가 생산중인 CMOS이미지센서 시장은 다양한 응용기기의 확대 적용과 수요 증가로 전체 이미지 센서 시장에서의 비중이 2012년 79%에서 2017년 92%까지 증가하며 연평균 10.8%의 높은 성장이 전망됩니다.

### (3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 지금까지 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며 제품 수명주기가 매우 짧은 특징을 가지고 있습니다. 아울러 대규모 장치 산업의 특성을 가짐과 동시에 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 비교적 크게 나타났으나, 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 일부 경쟁력이 부족한 업체들의 구조조정 등으로 인해 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었다고 볼 수 있습니다.

#### [DRAM]

DRAM은 PC 수요에 상당 부분 의존하고 있어, 세계 IT 경기 사이클의 영향을 크게 받아왔습니다. 그러나 최근에는 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 기기의 폭발적 성장에 따라 DRAM의 주요 수요처가 PC에서 모바일로 이동하고 있어, 경기 변동성이 과거에 비해 약화되는 모습을 보이고 있습니다.

한편, 수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 및 중국 춘절 등의 수요 증가로 인한 매출액 증가를 들 수 있습니다. 하지만 최근에는 아시아 시장의 성장으로 인한 판매시장의 다변화로 이 같은 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다.

#### [낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 과거 MP3 플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 또한주요 공급업체들이 DRAM을 함께 생산하고 있어 DRAM 시장의 안정적 성장에도 우호적인 여건을 제공해 왔습니다. 하지만 최근에는 IT 기기가 스마트화됨에 따라 낸드플래시의 주 수요처가 eMMC, SSD 등으로 바뀌고 있으며, 이들 제품은 경기에 민감한 소비재 제품이기 때문에 DRAM과 마찬가지로 세계 경제상황에 따라 NAND 시장이 함께 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 전체적으로는 고용량 낸드플래시를 탑재하는 스마트폰 및 태블릿 PC 시장이 확대되고 노트북의 SSD 채택이 늘어남에 따라 세계 경기 회복과 더불어 향후 낸드플래시 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.

#### [CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지센서 시장은 스마트폰, DSLR 등 전통적인 수요처의 강세가 지속되는 가운데, 자동차용 블랙박스/후방카메라, 스마트 TV 등 다양한 산업군과의 Convergence를 통해 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 또한 이미지센서 중 자사가 생산중인 CMOS 이미지센서는 휴대폰, 캠코더, PC 등 멀티미디어 기기 시장의영향을 크게 받는 제품으로서 소비재의 특성상 경기변동과 기술변화에 매우 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다. 따라서 가격경쟁력을 지닌 제품을 적시에 출시하여 시장을 선점하는 것이 사업 성공에 있어 매우 중요한 요소라 할 수 있습니다.

#### (4) 경쟁요소

반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1. 인적자원(R&D 및 엔지니어링), 2. 기술 및 원가 경쟁력, 3. 시장 대응 능력(고객확보, 제품 포트폴리오), 4. 설비투자 능력 등이 있습니다. 최근 대량생산이 용이한 표준제품 위주에서 응용 분야가 점차 다양화, 융복합화함에 따라 시설투자와 생산성 향상을 통한 원가경쟁력 중심에서 제품 가치를 증대를 통한 수익성 중심으로 경쟁의 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다. 지금까지 생산능력 확대와 생산원가 절감이 주요 경쟁 목표였던 시기에는 제조/공정기술, 대규모 설비투자, 규모의 경제 등이 중요한 사업 성공 요인이었지만, 공정 미세화의 난이도 증가와 투자의 불확실성 증대 등 사업환경이 변화함에 따라 앞으로는 제품 경쟁력과 부가가치 증대를 위해 선행기술 및 응용기술 개발, 마케팅 및 고객 만족 등이 더욱 중요한사업 경쟁력이 되고 있습니다.

이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 시장 대응력(Time to Market) 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

### 나. 회사의 현황

#### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

##### (가) 영업개황

지난 2013년 3분기는 우호적인 가격 환경과 모바일 신제품 출시 등의 영향으로 매출이 소폭 증가하면서 분기 매출로는 처음으로 4조원을 돌파하며 전 분기에 이어 다시 한번 분기 최고 매출을 경신하였으며, 영업이익 또한 PC DRAM 가격 강세 유지와 미세공정전환 및 수율 개선을 바탕으로 한 원가절감 노력에 힘입어 사상 최대의 분기 실적을 기록하였습니다.

당사의 연결 기준 매출은 전분기 대비 약 4% 증가한 약 4조 8백 4십억원을 기록하였으며, 연결 기준 영업이익은 전분기 대비 약 5% 증가한 약 1조 1천 6백 4십억원을 기록하였습니다. 당기순이익은 약 9천 5백 8십억원을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기 (2013.07.01~ 2013.09.30)	제66기 2분기 (2013.04.01~ 2013.06.30)	전기 대비 증감	제66기 3분기누계 (2013.01.01~ 2013.09.30)	제65기 3분기누계 (2012.01.01~ 2012.09.30)	전년 동기 대비 증감
매출액	4,083,621	3,932,647	3.8%	10,797,415	7,443,823	45.1%
영업이익	1,164,481	1,113,603	4.6%	2,595,034	-282,321	흑자전환
당기순이익	958,236	946,761	1.2%	2,083,710	-322,489	흑자전환

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

### (나) 공시대상 사업부문의 구분

[제66기]

(단위: 백만원)

구 분	매출액	매출액 비중 (%)	주 요 제 품
반도체 부문	10,797,415	100.0%	DRAM, NAND Flash, MCP 등
합계	10,797,415	100.0%	

※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 및 기타 전자부품 제조업(분류번호: 321)'에 해당하며, 반도체부문의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 반도체부문으로 기재함.

### (2) 시장점유율 등

구 분	'13년 2분기	'13년 1분기	'12년	'11년	'10년	'09년	'08년
DRAM	29.6%	26.0%	24.7%	22.8%	21.8%	22.9%	19.2%
NAND Flash	14.0%	11.5%	11.8%	11.7%	9.5%	8.4%	12.6%

출처: IDC, 2013년 9월, 매출액 기준

### (3) 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

#### (가) 메모리반도체 사업

[DRAM]

컴퓨팅 메모리(Computing Memory) 사업의 경우 가격이 높고 품질의 신뢰성이 바탕이 되어야 하는 고용량(High Density) 서버용 제품 비중과 이동성 확대에 따른 노트북(Notebook) 및 울트라북(Ultrabook)용 제품의 비중이 확대되고 있습니다. 2013년 PC 시장은 계속되는 경기부진과 태블릿에 의한 PC 수요 잠식으로 인해 2012년 대비 PC 출하량 하락이 예상되고 있습니다. 이 중 휴대성과 편의성이 강조된 울트라북은 판매 비중이 지속적으로 증가하여 태블릿PC와 함께 긍정적인 성장이 전망됩니다.

서버 메모리(Server Memory)는 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)과 스마트 기기의 성장에 따른 인터넷 데이터 트래픽의 폭발적인 증가로 인하여 지속적인 수요 증대가 전망됩니다. 특히 대형 인터넷 포털 업체의 데이터 센터(Data Center)는 서버 시스템 수요를 빠르게 증가시키고 있는 추세입니다. 당사는TCO(Total Cost of Ownership) 절감을 중요시하는 데이터 센터의 제품 효율성 요구 증대에 부응하기 위해 저전력과 고속의 서버용 모듈 제품을 공급하고 있으며, 그 외에도 저전력 마이크로 서버용 제품군을 새롭게 개발하여 서버 메모리 트렌드에 발 빠르게 대응하고 있습니다.

그래픽 메모리(Graphics Memory)는 동영상 및 3D 그래픽 기술의 발전과 함께 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 주요 그래픽 칩셋 업체들과의 전략적 관계강화를 통하여 데스크탑, 노트북용 등 PC 그래픽 및 기존 게임 외에 의료, 교육, 네트워크 커뮤니케이션 등 분야로 활용 영역을 넓히고 있는 차세대 게임콘솔 분야에서도 주도적인 위치를 공고히 하고 있습니다.

컨수머 메모리(Consumer Memory) 시장은 스마트 디지털TV, 디지털 셋톱박스(Set-top Box), 블루레이 플레이어(Blu-ray player)등의 디지털 영상 가전제품과 프린터 등 PC주변기기 및 자동차용 네비게이션 제품 등에 다양하게 사용됩니다. 또 당사는 클라우드 컴퓨팅 확대에 따른 네트워크 인프라 장비에 맞는 고용량, 고속의 첨단 컨수머 메모리를 개발하여 경쟁력 있는 제품을 시장에 공급하고 있으며, 고온 및저온에도 견딜 수 있는 극한 환경에 특성화된 IT(Industrial Temperature)와 AT(Automotive Temperature) 제품을 개발, 공급하는 등 고객의 다양한 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다.

모바일 메모리(Mobile Memory)는 휴대전화뿐만 아니라 모바일 특성에 연산 기능이 향상된 태블릿 PC, 울트라 북에도 사용되고 있으며, 디지털 카메라, 네비게이션, MP3 플레이어 등과 같은 모바일 컨수머 제품에도 채용이 확대되고 있습니다. 라이프 스타일 변화에 따른 IT 수요 증가 및 무선 통신 환경의 발전, 정보통신 융합 (Convergence)의 가속화로 현재 가장 성장성이 높은 제품입니다. 이 중에서도 저전력, 고성능, 대용량 메모리를 필요로 하는 스마트폰 및 태블릿 PC의 보급률 증가 추세는 향후에도 모바일 메모리 제품의 수요를 강하게 견인할 것으로 예상됩니다.

#### [낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 데이터 저장 용도로 쓰이는 대표적인 메모리 반도체로서, 빠른 테크놀로지의 진화로 매년 높은 성장률을 기록하였습니다. 낸드플래시 시장이 이렇게 성장을 지속하는 이유는 최첨단 IT기기 및 다양한 소비자 가전에서 낸드플래시 채용률이 지속적으로 높아지고 있기 때문입니다.

과거에는 플래시카드, USB 드라이브, MP3 플레이어, PMP 등이 낸드플래시 메모리의 주요 수요처였으나, 최근에는 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 분야에서 멀티 미디어 기능의 확대로 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 스마트TV, 스마트카 등의 신 개념 도입으로 인하여 과거에 저용량의 낸드플래시 메모리만 사용했던 이들 시장에서도 고용량 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최근에는 SSD(Solid State Drive)와 같은 낸드플래시를 기반으로 한 다양한 형태의 Storage Solution이 노트북은 물론이고 서버 시장에서도 주요 제품군으로 자리잡고 있어, 향후 낸드플래시 메모리시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 것으로 전망되고 있습니다.

이와 같은 낸드플래시 시장에서 당사는 저용량부터 고용량까지 다양한 단품 및 응용 복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 응용분야별 선택과 집중을 통하여 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장 지배력을 높여 가고 있습니다.

#### (나) 비메모리반도체 사업

회사는 지난 2007년 11월, 제품 포트폴리오를 더욱 다양화하고, 기존 메모리 사업 역량을 활용하여 안정적인 수익성과 높은 투자효율성이 기대되는 CIS 사업에 재진출하였습니다.

#### [CIS (CMOS Image Sensor)]

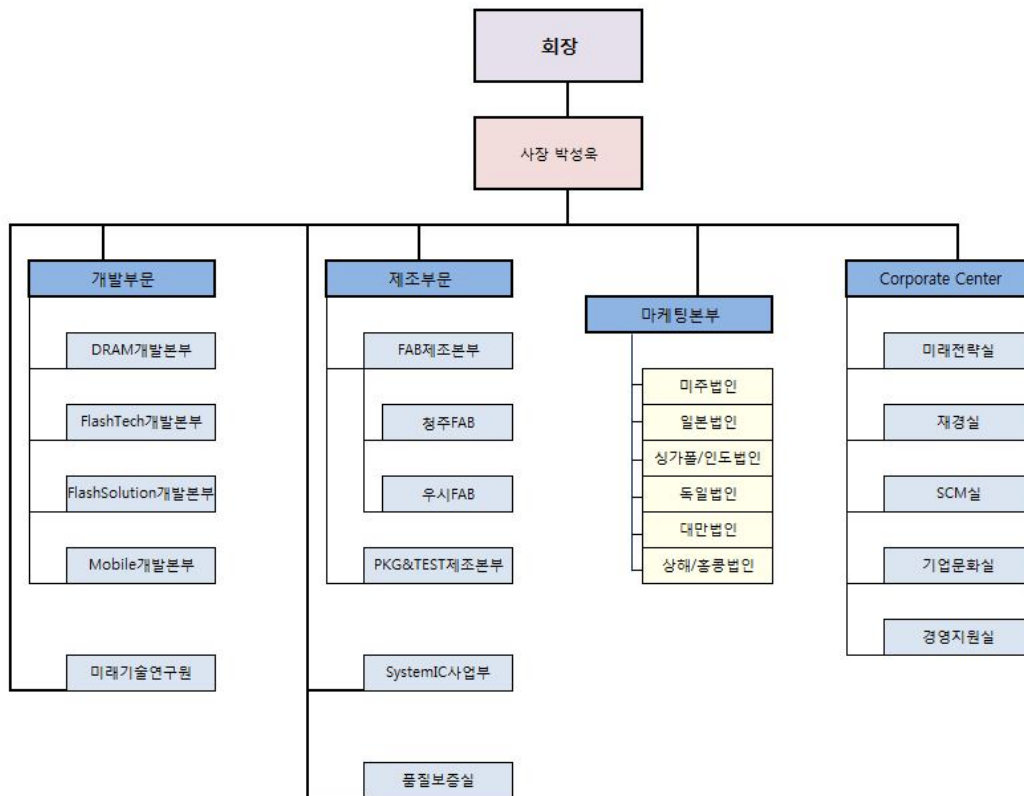
CIS는 휴대 전화, 디지털 카메라, 노트북, 태블릿 PC, 웹캠 등 다양한 디지털 기기에서 촬영 필름 역할을 하는 반도체 소자이며, 2011~2016년까지 약 15%의 연평균 성장률이 예상되는 시장입니다. (출처: Techno-Systems Research, 출하량 기준)

현재는 휴대 전화와 노트북, 태블릿 PC에 가장 많이 쓰이고 있으나 주변 회로가 필요 없고 전력 소모가 적은 장점과 함께 최근 기술의 발전으로 화질이 크게 향상되면서 의료 기기, DSLR 및 캠코더, 자동차, 보안장비, 게임기, 가전 제품 등으로 응용 범위가 급속히 확대되고 있습니다. 또한 최근 카메라사진 촬영과화상 통화를 위해 두 개의 이미지 센서가 휴대전화에 장착되고 있으며, 이러한 경향은 태블릿 PC에도 반영되어 기기당 이미지 센서 탑재 비율 역시 늘어나는 추세입니다.

현재 당사의 CIS는 센서 중 가장 많은 수량 비중을 점유하고 있는 휴대전화 응용시장과 이와 유사한 센서특징을 요구하고 있는 노트북 시장, 그리고 최근 급속한 성장세를 보이고 있는 태블릿 PC와 Toy 시장에 집중하고 있으며, 유사 응용시장으로의 확대를 통해 신규 시장 및 지역, 고객을 발굴하여 사업의 안정성 강화와 수익성을 개선하고 있습니다. 또한 새로운 시장 및 고객 창출을 위해 새로운 IP개발과 신기술 확보를 통해 기술 및 가격 경쟁력을 보유한 제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

당사는 국내와 중국, 일본 지역뿐만 아니라 2013년에는 한층 강화된 사업 역량을 바탕으로 미구주 지역의 고객 확대와 어플리케이션 다양화로 CIS시장에서의 입지를 확대해 나갈 계획입니다.

(4) 조직도(제출일 기준)



다. 사업부문별 재무정보



당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부  
문으로서 부문별 기재를 생략합니다.

## 2. 주요 제품, 서비스 등

### 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash, MCP 등	산업용 전자기기	SK하이닉스	10,797,415(100%)
합계					10,797,415(100%)

### 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

DRAM 가격은 2012년 세계 경기 침체 등의 영향으로 전년 대비 7% 가량 하락하였으나, 2013년에는  
모바일 시장 확대 및 수급 안정 등에 힘입어 약 50%로 큰 폭 상승하였습니다. NAND 가격은 2012년  
전년 대비 15%가량 하락하였으나, 2013년에는 약 18% 상승을 기록하였습니다.

(1) 산출기준 : 시장판매가 기준(용량(Density)별 제품군의 단순 평균 가격)

☞ Density 변화를 감안하지 아니한(기준 Density에 대한 환산수량 미적용) 단순 평균 공급가격  
임.

(2) 주요 가격변동원인

☞ 제품의 고급화 및 시장상황(수출)에 따른 판가변동 등

## 3. 주요 원재료에 관한 사항

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), 리드프레임(Lead  
Frame) 및 셉스트레이트(Substrate), PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료등으로 구성됩니  
다.

웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥  
모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되  
는 핵심 재료입니다.

리드프레임은 반도체 IC를 구성하는 또 다른 주요 요소이며 반도체 칩과 PCB 기판간의 전기신호를  
전달하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다.

셉스트레이트는 리드프레임과 같은 기능을 하지만 전기신호를 전달하는 역할을 하는 다리를 기존의  
금속 다리가 아닌 공(Ball) 모양의 연결부분을 이용한 부품입니다.

PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale

Integration), 스위치 등의 부품을 장치하고 납땀하여 회로기능을 완성시키는 인쇄 배선판입니다. 그 외 가스 및 화학약품 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다.

### 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	투입액	비율	비 고
반도체 부문	원재료	Wafer	F A B	364,486	15	-
		Lead Frame& Substrate	P K G	120,149	5	-
		PCB	M O D	95,058	4	-
		기타		928,072	39	-
		소계		1,507,766	63	-
	저장품	S/P, 부재료		889,204	37	-
	합 계			2,396,969	100	-

### 나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본의 2개사, 독일의 1개사, 한국 1개사, 미국 1개사로부터 반도체 공정의 주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 수입 하고 있습니다. 당사는 당사와 거래하는 매입처 등과 일상적인 영업 활동 이외의 특수한 관계를 갖고 있지 않습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상을 차지하고 있습니다.

웨이퍼는 그 원재료가 되는 폴리 실리콘의 수급 동향에 따라 300mm 웨이퍼 완제품 가격이 큰 영향을 받습니다. 특히, 폴리 실리콘은 웨이퍼 이외에도 태양전지(Solar Cell)의 원료로도 사용되기 때문에 태양전지의 수요에 따라 폴리 실리콘의 일시적 부족현상이 발생하면 웨이퍼의 공급에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서, 당사는 주요 원재료인 웨이퍼의 원활한 확보를 위해 유가 및 폴리 실리콘 시장의 가격동향은 물론, 동일한 원재료를 사용하는 태양전지 수급동향을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.

## 4. 생산 및 설비에 관한 사항

### 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 국내사업장 기준 4조 3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2013년 3분기까지 총 가동일은 273일로, 각 지역별 팹(Fab)의 가동인원 및 수율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월 11,782,680시간입니다.

생산능력은 "해당 3분기까지의 최대생산일의 생산량 x 누적일수 x 평균원가"의 방법으로 산출하고 있으며, 2013년 3분기까지 생산능력은 7,522,825백만원 입니다

(1) 생산능력

(단위 : 백만원 )

사업부문	제66기 3분기	제65기 연간	제64기 연간
반도체 부문	7,522,825	9,942,732	11,773,104

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

※ 제64기의 생산능력은 "당분기내 최대생산월의 생산량 x 누적개월수 x 평균원가"의 방법으로 산출하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률

당사의 2013년 3분기까지 생산실적은 7,522,825백만원으로 집계되었으며, 동 기간 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	제66기 3분기	제65기 연간	제64기 연간
반도체 부문	7,522,825	9,942,732	10,414,567

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 가동률

(단위 :시간, %)

사업부문	분기가동가능시간	분기실제가동시간	평균가동률
반도체 부문	103,879,642	103,879,642	100%

※가동률은 각 지역별 팹(Fab)의 가동인원 및 수율을 고려하여 계산함.

다. 생산설비의 현황

당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 11조 9천 505억원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계
2013.1.1								
취득원가	462,067	1,792,237	486,984	29,149,281	2,537	677,361	419,254	32,989,721
감가상각누계액		△467,030	△285,441	△19,817,741	△2,197	△486,509		△21,058,919
손상차손누계액		△23,877	△19,928	△289,950		△2,832		△336,587
정부보조금				△8,023				△8,023
기초순장부금액	462,067	1,301,330	181,615	9,033,566	340	188,021	419,254	11,586,192
기중변동액								

취득		110	83	7,475	6	4,609	2,561,079	2,573,362
처분	△34	△3,306	△689	△6,413	△42	△739	△336	△11,559
손상차손				△63,290	△1	△1	△10,544	△73,837
감가상각누계액		△39,078	△14,935	△2,084,758	△72	△45,235		△2,184,078
대체	15,499	56,996	40,238	2,136,130	13	51,655	△2,300,532	
환율변동 등	48	4,944	2,210	53,214	△7	206	△185	60,428
분기말순장부금액	477,580	1,320,997	208,521	9,075,924	237	198,515	668,736	11,950,509
2013.09.30								
취득원가	477,580	1,850,981	528,825	31,339,687	2,507	733,093	679,280	35,611,953
감가상각누계액		△506,108	△300,376	△21,902,500	△2,269	△531,745		△23,242,997
손상차손누계액		△23,877	△19,928	△353,241	△1	△2,833	△10,544	△410,424
정부보조금				△8,023				△8,023
분기말순장부금액	477,580	1,320,997	208,521	9,075,924	237	198,515	668,736	11,950,509

## 라. 투자계획

2013년 당사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다.

[입고기준]

(단위 : 십억원)

구 분	투자대상자산	투자효과	투자 기간	기투자액 (제66기 3분기)	비 고
보완투자	기계장치 외	생산능력증가	2013.01.01~ 2013.09.30	2,522	-
합 계				2,522	-

## 5. 매출에 관한 사항

### 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제66기 3분기	제65기	제64기
반도체 부문	제품 외	DRAM, 낸드플래시, MCP 등	10,797,415	10,162,210	10,395,811
합 계			10,797,415	10,162,210	10,395,811

※ 매출실적은 연결기준입니다.

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

### 나. 판매경로 및 판매방법 등

#### (1) 판매조직

국내에서는 마케팅 본부 내 국내영업팀 관할 하에 대리점 6개사를 운영하고 있습니다. 해외 판매 법인인 미국, 독일, 영국, 일본, 싱가포르, 인도, 대만, 중국 등에 10개법인이 소재하고 있으며 산하에 14개 지사 및 21개 대리점을 두고 있습니다.

## (2) 판매경로

당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

## (3) 판매방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점 등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 거래하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 조건 등으로 거래하고 있습니다.

## (4) 판매전략

당사 판매 전략은 '비즈니스 포트폴리오 최적화', '수익 구조 개선', '고객 관계 유지', '지역별 포지셔닝 유지' 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.

비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 서버, 그래픽, 모바일, 컨수머 등 응용분야의 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다.

수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래시장 발굴을 추진하고 있습니다.

고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다.

지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

## (5) 주요 매출처

반도체의 경우 IT 컨수머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에 DELL, HP 등 세계 유수의 PC 및 서버 등 PC 관련 전자 업체와 Apple 등 세계적인 PC 및 스마트폰 제조업체, 메모리 모듈 업체, 그리고 SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산 업체 등에 제품을 공급하고 있습니다.

## 6. 수주상황

당사는 주요 고객사들과 월별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.

## 7. 시장위험과 위험관리

### 가. 회사의 위험관리 정책

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정을 제정하고 외환관리위

원회 구성 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다.

### (1) 위험관리의 일반적 전략

#### [위험관리규정]

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정, 외환관리위원회 구성 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있으며, 그주요 내용은 ①외 환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실 수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으 로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 외환관리위원회가 설정한 지침에 따라 관리하 고 있습니다.

#### [파생상품계약 운용]

당사는 파생상품계약을 환위험 헤지 목적으로 운용하고 있습니다.

### (2) 위험관리조직 및 운영 현황

당사는 외환관리에 관한 의사결정기구로서 외환관리위원회를 설치·운영하고 있으며, 외환관리위원 회의 주요 업무는 다음과 같습니다.

- ① 외환 관리 정책, 전략 심의 및 의결
- ② 외환 관리 규정의 제정 및 개정
- ③ 환관리 목표와 허용 손실한도의 설정
- ④ 환위험 헤지 범위 및 헤지 비율, 관리수단 등의 조정
- ⑤ 환포지션, 환율 변동 영향, 환율 전망 등 환관련 정보의 공유

### 나. 위험관리 관련 추진사항

당사는 종합적 외화 자산 부채 관리의 일환으로 영업상의 환율 변동 영향을 축소하기 위해 파생상품 거래를 체결하고 있습니다. 파생상품 거래를 매매목적의 거래로 분류하여 회계처리 하고 있으며, 발 생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행 이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.

## 8. 파생상품 거래현황

연결회사는 이자 및 원금스왑, 선물환 매도계약, 이자율 스왑, 통화옵션계약 등을통하여 환율변동위험, 현금흐름 이자율위험 등을 관리하고 있습니다. 또한 내재파생상품인 해외전환사채에 내재되어 있는 전환권옵션을 분리하여 공정가치로 평가하여 당기손익으로 인식하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 기타금융자산으로 계상되어 있는 파생금융자산은 1,121백만원(전기말: 198백만원)이며 기타금융부채로 계상되어 있는 파생금융부채는 47,314백만원(전기말:18,635백만 원)입니다.

당분기에 파생상품거래와 관련하여 인식한 평가이익 및 거래이익은 5,557백만원(전분기: 4,744백만

원)이며 평가손실 및 거래손실은 36,924백만원(전분기: 11,214백만원)입니다.

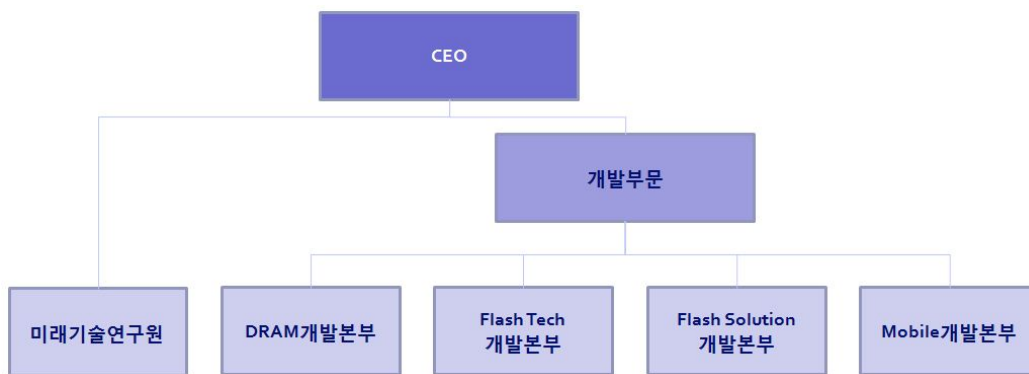
## 9. 경영상의 주요계약 등

계약 상대방	항목	내용	비고
삼성전자	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	
	계약 기간	2013년 6월 1일~	
	목적 및 내용	삼성전자가 보유하고있는 반도체 관련 모든 특허에 대한 사용권을 확보하여 향후 잠재적 분쟁 가능성 원천적 해소	
	기타 주요내용	-	
Rambus Inc.	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	
	계약 기간	2013년 7월 1일~2018년 6월 30일	
	목적 및 내용	라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소	
	기타 주요내용	특허 및 반독점 소송 등 램버스와 진행중이 모든 소송 취하	
Link_A_Media Devices Corp.	계약 유형	미국 NAND 컨트롤러 업체인 LAMD社 인수	
	계약 기간	2012년 6월 19일~	DA 체결일
	목적 및 내용	LAMD의 컨트롤러 기술과 전문 인력 확보로 고부가가치 NAND 솔루션 역량 확충	
	기타 주요내용	컨트롤러 공동개발 진행 및 컨트롤러 기술 리더쉽 확보	
IBM Corp.	계약 유형	공동개발계약 및 기술라이선스 계약	
	계약 기간	2012년 5월 31일~	
	목적 및 내용	기업용 서버의 성능 향상 및 전력 소비완화를 위한 차세대 메모리인 PCRAM의 조기 상용화	
	기타 주요내용	PCRAM 공동개발 진행 IBM社의 PCRAM 기반기술 영구 라이선스 확보	
Italy 기술센터	계약 유형	지분인수 및 서비스 계약	
	계약 기간	2012년 4월 10일~	
	목적 및 내용	Global R&D 체계 구축 및 R&D 역량 강화를 목적으로 Italy에 위치한 NAND 기술센터 인수 및 서비스 계약 체결	
	기타 주요내용	NAND Flash 공동개발 진행	
Toshiba Corp.	계약 유형	공동개발계약 및 라이선스 연장	
	계약 기간	2011년 7월 13일~	
	목적 및 내용	차세대 메모리의 조기 상용화 및 시장 진입 기반 구축 개발비용 절감 및 투자 효율성 제고	
	기타 주요내용	STT-MRAM 공동개발 진행 공동개발 성공시 합작회사를 설립하여 STT-MRAM 공동 생산	
무석산업발전집단유한공사	계약 유형	공동 투자를 통한 반도체 후공정 전문합작회사 설립계약	
	계약 기간	2009년 5월 17일~	
	목적 및 내용	중국 내 일괄생산체제 구축을 통한 제조 및 물류 효율성 증대와 원가경쟁력 강화, 안정적 외주처 확보	
	기타 주요내용	양사의 협의로 합작법인을 후공정 전문회사로 장기 육성, '합작사는 향후 5년간 하이닉스에 후공정 장기 외주 임가공 제공 및	

## 10. 연구개발활동

### 가. 연구개발 담당조직

당사는 보고서 제출일 현재, 미래기술연구원 및 DRAM개발본부, Flash Tech개발본부, Flash Solution개발본부, Mobile개발본부에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.



### 나. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목		제66기 3분기	제65기	제64기	비 고
원 재 료 비		32,910	42,571	42,991	-
인 건 비		321,757	335,212	264,890	-
감 가 상 각 비		94,667	132,448	155,967	-
위 탁 용 역 비		70,972	43,117	33,191	-
기 타		318,367	384,933	336,749	-
연구개발비용 계		838,673	938,281	833,788	-
회계처리	판매비와 관리비	688,924	807,704	679,197	-
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	149,749	130,577	154,592	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 ÷ 당기매출액 × 100]		7.8%	9.2%	8.0%	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.



다. 연구개발 실적

구 분	연구과제명	기대효과
제66기 3분기	1) 4Gb GDDR5	GDDR5 제품중 20nm 공정 기술을 적용한 첫 고용량 제품으로서 그래픽 시장의 프레임 버퍼(Frame Buffer) Size 증가 요구를 반영한 제품임. 저전력 고성능 구현으로 그래픽 시장을 리드할 것으로 기대되는 프리미엄 제품으로, 하이브리드 설계구조 적용으로 원가 경쟁력을 위한 와이어 본딩/8Gbps 솔루션으로 Flip Chip 동시 지원 가능.
	2) 32/64/128/256GB mSATA SSD	지난해 인수한 SKHMS와의 시너지를 통한 첫 자체 20nm SSD(mSATA) 제품으로 기존 26nm SSD 제품 대비 우수한 성능과 원가 경쟁력을 가지고 있음. OEM향 노트북, 태블릿 시장에서 다양한 고객 요구에 대응할 수 있는 제품을 확보함에 따라 매출과 수익성 확대에 크게 기여할 것으로 기대됨.
	3) 4/16/32/64GB e-NAND(eMMC4.5)	2Ynm eMMC4.5 제품으로 기존 2Ynm eMMC4.41 제품 대비 2배 이상 향상된 성능을 통해 Ci-MCP와 고용량 eMMC 제품의 매출 증대와 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
	4) 2M 1/5"(130nm, 1.75um pixel, Hi-257)	중국 시장에서 저가형 스마트폰의 메인 카메라로 2M 제품 채용이 확대되고 있는 시점에서 Net Die를 기존 제품 대비 40% 증가시킨 제품으로서 당사의 시장점유율을 확고히 하는데 기여할 것으로 기대됨.
	5) 4Gb DDR4	20nm급 공정 기술을 적용한 세계 최초의 DDR4 양산 제품으로 인텔 하스웰(Haswell) 시스템 개발 초기부터 참여하여 PMO(Platform Memory Organization) 샘플 대응을 통해 시스템과 모듈간 Align을 진행. 자사 최초로 인텔 CDC(Columbia Design Center) FlugFest에 참석하여 Green Light 획득. DDR4 시장의 선도적 진입 및 리더십 확보를 위한 교두보를 마련하였음.
	6) 2Gb GDDR5	20nm급 공정 기술을 적용한 제품으로 기존 30나노급 대비생산성 향상에 기여. 기존 제품 대비 퍼포먼스(저전력 및 고속 동작 지원)가 향상되어 그래픽 메모리 시장을 선도하며, 2Gb 제품의 주력 생산이 될 제품. High-end PC향 그래픽 및 서버 등에도 채용을 추진중으로 신규 시장 창출이 기대됨.
	7) 2Gb SLC NAND	30nm급 기술을 적용한 4bit ECC 지원 제품으로 모바일향으로 개발되었으며, 기존 40nm급 대비 생산성이 29% 향상됨. 공정 미세화를 통한 수율과 품질을 확보하여 가격 경쟁력 확보 및 수익성 향상이 예상되며, 당사의 시장점유율을 높이는데 기여할 것으로 기대됨.
	8) 64Gb MLC NAND	세계 최초 1Xnm 공정을 적용한 핵심제품으로서 기존 고용량 20nm 64Gb 제품 대비 생산성이 크게 향상되어 원가 경쟁력을 확보하였으며, 최근 크게 수요가 증가되고 있는 모바일향 eMMC 및 PPN, 스토리지향 SSD 등 솔루션 제품 수익성 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됨.
	9) 64/128/256/512GB STD2.5"	자체 개발한 컨트롤러를 채용한 2Ynm 2.5인치 스탠다드SSD

SSD, 64/128/256GB M.2 SSD	및 M.2 SSD 제품으로 기존 2Ynm SSD 제품 대비 우수한 성능과 원가 경쟁력을 확보함으로써 향후 높은 성장성과 수익성이 예상되는 PC OEM 시장 집중 및 고객 다변화로 SSD 매출 및 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
10) 4Gb LPDDR3	모바일 2Xnm 기술로 개발된 제품으로 모바일 기기의 High performance 요구와 울트라북의 Low Power 제품 채용에 따른 모바일 DRAM 매출 확대에 기여할 것으로 예상됨.
11) 1Gb/512Mb DDR2	4Xnm에서 2Xnm로 Tech Migration한 컨수머향 DDR2 제품으로 nVIDIA社 Automotive향 Biz 진입을 통해 지속적으로 수익을 창출하는 제품으로 자리잡을 것으로 기대됨. 또한 Half Chip 설계 기술 적용으로 512Mb Density 시장에 대해서도 전략적 대응이 가능.
12) 8Gb LPDDR3	모바일 2Ynm 기술로 세계 최초 개발된 8Gb LPDDR3 제품으로 최근 요구되고 있는 모바일 기기의 High Performance 와 저전력 특성을 확보하였으며, 두께에 민감한 제품 수요에 대응할 수 있어 모바일 DRAM 매출 확대에 기여할 것으로 예상됨.
13) 16/32/64GB e-NAND(eMMC4.5)	1Xnm Tech의 NAND 제품을 적용한 모바일 솔루션 제품으로 기존 2Ynm eMMC4.5 제품 대비 원가 경쟁력을 확보하였으며, Small PKG 고용량 제품 라인업 완성으로 자사 모바일 제품 경쟁력을 확보하여 매출 증대와 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
14) 128,256GB M.2 2260 SSD	자사 2Ynm Tech NAND를 적용한 울트라북용 SSD 제품으로 차세대 Formfactor를 지원함으로써 신규 시장의 주요 OEM 고객 매출 확대에 기여할 것으로 기대됨.

구 분	연구과제명	기대효과
제65기	1) 64Gb MLC NAND	2Y나노 공정을 적용한 핵심제품으로써 기존의 고용량 2X나노 64Gb 제품 대비 생산성이 40% 이상 향상되어 원가 경쟁력을 확보하였으며, 최근 크게 수요가 증가하고 있는 모바일향 솔루션 제품 수익성 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됨.
	2) 4Gb LPDDR3	30나노급 기술을 적용한 LPDDR3 제품으로 기 양산중인 LPDDR2 제품 대비 고속 및 저전력 동작이 가능함. PC에 채용되는 DDR3 제품의 속도를 구현할 수 있어 저전력 고속 동작을 요구하는 고사양 스마트폰 및 태블릿 PC에 채용될 예정임.
	3) 1Gb DDR3(x16)	30나노급 기술을 적용한 컨수머 제품으로, 컨수머 어플리케이션에서의 Long Term Supportability를 확보하기 위한 제품임. 자사 최초로 Array E-Fuse 기술이 적용된 제품으로 향후 모든 DRAM에 적용 가능한 Array E-Fuse 설계 요소 기술을 확보하여 상용화를 달성하였으며, Cost Effective Test Baseline 구축 가능 효과가 있을 것으로 기대됨.
	4) 2Gb DDR3	20나노급 공정을 적용한 DRAM 핵심제품으로 기존 30나노급 제품 대비 생산성이 크게 향상되어 원가 경쟁력을 확보하였으며, 설계 및 소자 기술의 혁신으로 저전력, 초고속 특성이 확보되어 수익성 향상에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.
	5) 32Gb MLC NAND	20나노급 공정을 적용한 eMMC향 제품으로 모바일 기기의 Small PKG 대응을 통해 제품 경쟁력을 확보하여 모바일향 솔

	루션 제품 수익성 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됨.
6) 16Gb MLC NAND	20나노급 공정을 적용한 저용량 eMMC 및 USD향 제품으로 모바일 기기의 저용량 제품 대응을 통해 20나노급 제품 포트폴리오를 강화하여 모바일향 솔루션 제품 수익성 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됨.
7) 4Gb SLC NAND	30나노급 SLC 제품으로 기존 40나노급 제품 대비 생산성이 크게 향상되어 Mid/Lowend Smartphone향 MCP 제품 경쟁력 확보 및 모바일 제품 수익성 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됨.
8) 4/8/16/32GB e-NAND(eMMC4.41)	20나노급 NAND를 사용 기존 20나노급 제품 대비 높은 성능과 원가 경쟁력을 확보하여 고성능 대용량의 스마트폰과 태블릿 PC등의 모바일 시장에서 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 기대됨.
9) 64/128/256GB STD2.5 " SSD	20나노급 NAND를 사용하여 만든 SSD(SATA 6.0Gbps) 제품으로 자사 브랜드로는 최초의 사용화 제품임. 최근 급성장하는 데스크탑, 노트북등의 SSD 시장에서 고부가가치의 NAND 솔루션 제품으로 수익성 향상에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대됨.
10) 32/64/128GB mSATA SSD	20나노급 NAND를 사용한 mSATA 규격(SATA 6.0Gbps)의 제품으로 최근 급성장하는 울트라북 OEM향 SSD 시장에서 제품 경쟁력을 확보하여 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 기대됨.
11) 1Gb CDR(x512)	소니社의 고객 System 개발과 연계하여 Biz를 이어나갈 제품으로 개발 되었으며 자사 최초로 Multi-Channel Wide IO(x512) DRAM을 개발하였고, 향후 모바일 플랫폼의 주요 기술인 Wide IO TSV기술 개발에 기여할 것으로 기대됨.
12) 4Gb DDR3	2012년까지 주력 제품이 될 High Density 제품으로 30나노급에 이어 원가 및 퍼포먼스 측면에서 경쟁력 있는 20나노급을 개발함으로써 수익성 향상에 기여할 것으로 기대되며, 특히 온도에 따라 대기전류를 효율적으로 제어하는 기술을 통해 저전력 시장요구에 부합하는 제품으로 향후 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대됨.
13) 2GB e-NAND(eMMC4.41)	20나노 Base Emmc4.41 제품 확보로 Low Density 제품 라인업에도 경쟁력을 확보 함. 향후 컨수머향 Low Density 제품에 진입기회를 확보 할 수 있음.
14) 4Gb LPDDR2	20나노급 모바일 DRAM 기술을 적용하여 개발된 제품으로 최근 스마트폰 시장에서 수요가 급증하고 있어 기존 30나노급 제품 대비 수익성 향상에 기여할 수 있을 것으로 예상됨.
15) 2M MIPI CSP, 1.75um, 130nm	기 양산중인 Hi-255 제품을 기반으로 CSP 패키지가 가능하도록 개발된 제품으로 향후 중국 시장 매출 확대에 기여할 것으로 기대됨.
16) 2Gb DDR3(x16)	그래픽&컨수머 시장의 주력 제품으로 30나노급 이후 20나노급 개발을 통해 수익성 향상에 기여한 제품으로, 특히 빠른 속도 (1Ghz) 및 저전력(1.35V) 특성확보를 통해 그래픽&컨수머 시장의 리더쉽을 유지하는데 기여할 것으로 기대됨.
17) 60/120GB STD 2.5" SSD	20나노급 NAND 및 새로운 컨트롤러를 적용한 2.5" 스탠다드

		(SATA 6.0Gbps) SSD 개발로 기존제품 대비 높은 성능과 안정성을 제공할 것으로 예상됨.
	18) 2Gb LPDDR	30나노급 모바일 DRAM 기술을 적용하여 개발된 제품으로 중국향 저가 스마트폰에 채용되는 기존 40나노급 제품 대비수익성 향상에 기여할 수 있을 것으로 예상됨.

구분	연구과제명	기대효과
제64기	1) 2Gb DDR3	30나노급 기술을 적용한 메인메모리 제품으로 서버, 데스크탑 PC, 노트북 등에 사용되는 제품임. 당사 최초로 6F2기술을 적용하여 상용화한 제품으로 기존 40나노급 제품보다 월등히 생산성이 높아지게 되어 경영실적에 크게 기여할것으로 예상됨. 30나노급의 기술 플랫폼을 구축하게 되었으며 향후 개발될 30나노급 파생제품의 개발을 선도할 제품임.
	2) 1Gb LPDDR	40나노급 기술을 적용한 모바일 메모리 제품으로 핸드폰, PMP, MID, 넷북, 게임 콘솔 등 다양한 모바일 어플리케이션에 대응 가능한 제품임. 특히 Small Package가 가능하도록 제작되어 점차 소형화 되고 있는 모바일 시장의 시장점유율확대에 기여할 것으로 예상됨.
	3) 16Gb/32Gb/64Gb MLC eNAND	2X나노 기술을 적용한 응용복합 제품으로 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 시장에 대응하기 위하여 개발된 제품임. eMMC4.4 Spec 요건을 만족하고 있으며, 기존 30나노급 기술 대비 60% 이상의 생산성 향상으로 인해 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상됨.
	4) VGA 1.75um 130nm	1.75um 130나노 기술을 적용한 VGA 제품으로 중국시장내 가격 경쟁력 심화에 대응하기 위한 제품으로 기존 제품 대비 생산성이 14% 증가하였으며 중국 시장에서 VGA 제품의가격이 하락하는 시점에서 시장 진입함으로써 수익성 유지를 목적으로 함.
	5) 256Mb Combo Mobile	40나노급 기술을 적용한 저사양 모바일폰 및 데이터카드,베이스밴드향의 모바일 메모리 제품으로 기존 기술 대비 다이(die) 수 증가로 인한 원가 경쟁력 확보로 수익성 향상에 기여할 것으로 예상됨.
	6) 4Gb DDR3	당사 최초의 30나노급 4Gb 고용량 제품으로 PC용 메인메모리 뿐만 아니라 그래픽, 컨수머 시장에도 대응이 가능함. 32GB RDIMM과 64GB 슈퍼 노바 DIMM 개발을 통해 고용량 모듈 지원이 가능하여 수익성 확보 및 유지에 기여할 것으로 기대됨.
	7) 2Gb DDR3(x16)	30나노급 기술을 적용한 그래픽, 컨수머 시장 주력 제품으로서 1GHz의 빠른 스피드 특성을 확보하여 시장지배력 유지에 기여할 것으로 기대됨. 1.35V의 저전압에서도 900MHz의 속도를 확보하여 Low Vdd 경쟁력도 갖추었음.
	8) 1M, 2.0um, 130nm	2.0um, HD format Pixel array를 적용하여 노트북 시장을 타겟으로 개발한 제품임. 노트북용 카메라 시장이 베가에서1M HD 센서로 급격히 이동함에 따라 이에 대응하기 위한 제품으로 노트북 시장 점유율 확대와 안정적 수익 창출에 기여할 것으로 예상됨.

9) 2Gb DDR5	30나노급 기술을 적용한 그래픽 시장 주력 제품으로 저전력, 초고속, 고용량, 소형화가 요구되는 그래픽 시장 대응을 위한 제품임. 세계 최고 수준의 속도 구현 및 저전력, 고속동작지원으로 기술의 리더십을 유지하는 독보적인 위치를 확보하였음. PC와 노트북 그래픽 카드 및 HPC(High Performance Computing)에 최적화된 제품임.
10) 512Mb LPDDR	40나노급 기술을 적용한 저사양 모바일폰 및 데이터카드, 베이스밴드향의 모바일 메모리 제품으로 기존 50나노급 기술 대비 다이(die) 수 증가로 인한 원가 경쟁력 확보로 수익성 향상에 기여할 것으로 예상됨.
11) 4Gb LPDDR2	30나노급 6F2 기술이 적용된 모바일 제품으로 고용량, 고속동작이 가능한 제품임. 초박형 패키지로 제작되어 고사양 스마트폰 및 태블릿 PC에 채용될 예정으로, 수익성 증대에 기여할 것으로 예상됨.
12) 2Gb LPDDR2	30나노급 기술을 적용한 스마트폰 시장 주력 제품으로서 기존 800Mbps 동작 대비 향상된 1066Mbps 특성을 확보하여 고사양 제품 채용도 가능하여 수익성 향상에 기여할 것으로 예상됨.
13) 1Gb SLC NAND	30나노급 기술을 적용한 SLC 최초 4bit ECC 지원 제품으로 모바일향으로 개발 되었으며, 매출 및 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상됨. LTE 등 통신환경 개선으로 Data card 시장 성장 예상과 중국에서 512Mb~1Gb SLC 제품을 채용하는 SOC가 신규 개발 예정되어 중화권 모바일 시장 확대가 전망됨.
14) 120GB mSATA SSD	20나노급 기술을 적용한 mSATA SSD 개발을 통해 자사 최초로 SSD 시장진입을 달성함. 모바일과 함께 NAND 어플리케이션 중 가장 가파른 성장이 예상되는 SSD 시장 진입에 성공함으로써 매출 및 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상됨.
15) 2M MIPI, 1.75um, 130nm	기 개발된 130nm 1.75um 2M 제품에 MIPI 시리얼 인터페이스를 추가한 제품으로 칩셋업체의 MIPI 지원 제품의 본격적인 출시와 Set 업체의 MIPI 지원에 대한 요구에 대응하기 위한 제품임. 향후 MIPI 지원 제품의 수요가 급격히 증가할 것으로 예상되어 매출 확대에 크게 기여할 것으로 전망됨.
16) 3M, 1.4um, 90nm	1.4um 화소를 적용한 첫 90nm 코어 제품으로 향후 90nm 파생 제품 개발을 통한 제품 라인업 확대와 모바일폰에서 요구되는 소형화 추세에 대응하기 위한 제품임. 낮은 1.2V 전압에서 동작하여 소비전력이 낮은 장점이 있으며, 개발 단계에서부터 고객 평가를 통한 요구사항을 적극 반영하여 개발 완료와 동시에 판매로 이어져 매출 확대가 기대됨.

## 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 최근 3년간 신용등급 [국내]

평가일	평가대상 유가증권등	평가대상 유 가증권의 신용등급	평가회사	신용평가등 급범위	평가구분
10.06.29	회사채(정기평가)	BBB+	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
10.06.30	회사채(정기평가)	BBB+	한기평	AAA ~ D	정기평가
10.06.30	회사채(정기평가)	BBB+	한신평	AAA ~ D	정기평가
10.08.31	회사채(209)	BBB+	NICE신평	AAA ~ D	본평가
10.08.31	회사채(209)	BBB+	한기평	AAA ~ D	본평가
10.08.31	회사채(209)	BBB+	한신평	AAA ~ D	본평가
11.01.05	회사채(210)	BBB+	NICE신평	AAA ~ D	본평가
11.01.05	회사채(210)	BBB+	한기평	AAA ~ D	본평가
11.01.05	회사채(210)	BBB+	한신평	AAA ~ D	본평가
11.04.27	회사채(211)	A-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
11.04.27	회사채(211)	A-	한기평	AAA ~ D	본평가
11.04.27	회사채(211)	A-	한신평	AAA ~ D	본평가
11.04.27	회사채(정기평가)	A-	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
11.04.27	회사채(정기평가)	A-	한기평	AAA ~ D	정기평가
11.04.27	회사채(정기평가)	A-	한신평	AAA ~ D	정기평가
11.11.15	회사채(수시평가)	A-	한신평	AAA ~ D	수시평가
11.11.16	회사채(수시평가)	A-	한기평	AAA ~ D	수시평가
12.02.16	회사채(수시평가)	A	NICE신평	AAA ~ D	수시평가
12.02.17	회사채(수시평가)	A	한기평	AAA ~ D	수시평가
12.02.17	회사채(수시평가)	A	한신평	AAA ~ D	수시평가
12.05.24	회사채(정기평가)	A	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
12.05.24	회사채(정기평가)	A	한기평	AAA ~ D	정기평가
12.05.24	회사채(정기평가)	A	한신평	AAA ~ D	정기평가
12.05.24	회사채(212)	A	한신평	AAA ~ D	본평가
12.05.24	기업어음(본평가)	A2	NICE신평	A1~D	본평가
12.05.24	기업어음(본평가)	A2	한기평	A1~D	본평가
12.05.24	기업어음(본평가)	A2	한신평	A1~D	본평가
12.08.22	회사채(213)	A	NICE신평	AAA ~ D	본평가
12.08.22	회사채(213)	A	한기평	AAA ~ D	본평가
12.08.22	회사채(213)	A	한신평	AAA ~ D	본평가
12.12.24	기업어음(정기평가)	A2	NICE신평	A1~D	정기평가
12.12.24	기업어음(정기평가)	A2	한기평	A1~D	정기평가
12.12.27	기업어음(정기평가)	A2	한신평	A1~D	정기평가
13.06.20	회사채(정기평가)	A+	한기평	AAA ~ D	정기평가
13.06.20	회사채(정기평가)	A+	한신평	AAA ~ D	정기평가
13.06.27	회사채(정기평가)	A+	NICE신평	AAA ~ D	정기평가

13.06.20	기업어음(본평가)	A2+	한기평	A1~D	본평가
13.06.20	기업어음(본평가)	A2+	한신평	A1~D	본평가
13.06.27	기업어음(본평가)	A2+	NICE신평	A1~D	본평가

[해외]

평가일	평가대상 유가증권등	평가대상 유 가증권의 신용등급	평가회사	신용평가등 급범위	평가구분
10.01.25	발행회사	B1	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
10.11.24	해외사채	B+	S & P	AAA ~ D	수시평가
12.02.14	해외사채	BB-	S & P	AAA ~ D	수시평가
12.02.15	발행회사	Ba3	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
13.02.22	발행회사	BB	S & P	Aaa ~ D	수시평가
13.08.20	발행회사	Ba2	Moody's	Aaa ~ C	수시평가

※ 상기 S&P 및 Moody's의 본점 소재지는 미국임.

[참고] 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 등급정의

신용등급	등급의 정의
AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임
AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음
A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음
BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음
BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음
B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임
CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음
CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음
C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음
D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ AA ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 기업어음의 등급정의

신용등급	등급의 정의
A1	적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임
A2	적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3	적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임
B	적기상환능력이 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음
C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
D	상환 불능상태임

※ A2 ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 해외 신용평가사 Moody's 등급 정의

신용등급	등급의 정의
Aaa	최소한의 신용 리스크를 보이며, 최고의 신용상태를 가진 것으로 판단됨.
Aa	신용상태가 우수한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 낮음.
A	중상위 등급으로 간주되며 신용 리스크가 낮음.
Baa	신용 리스크가 보통 수준임. 이들은 중위 등급으로 간주되며 그에 따라 일부 투기적 특징을 가질 수 있음.
Ba	투기적 요소가 있는 것으로 판단되며 신용 리스크가 상당한 수준임.
B	투기적인 것으로 간주되며 신용 리스크가 높음.
Caa	신용상태가 불량한 것으로 판단되며 신용 리스크가 매우 높음.
Ca	투기성이 매우 높고 부도상태이거나 부도에 매우 근접해 있을 가능성이 높으며 원리금 회수 가능성이 어느 정도 있음.
C	채권의 최하 등급. 일반적으로 부도상태이고 원리금 회수 가능성이 거의 없음.

※ Aa부터 Caa까지 각 일반 등급 분류에 1,2,3의 숫자를 부여함. 숫자 1은 해당 등급 분류 내에서 상위에 있음을, 숫자 2는 중위에, 숫자 3은 하위에 있음을 나타냄.

[참고] 해외 신용평가사 S&P 등급 정의

신용등급	등급의 정의
AAA	채무상환능력이 극히 높음. 최상 등급임.
AA	채무상환능력이 매우 높음, 상위 등급과 크게 차이는 없으나 최고 수준은 아님.
A	채무상환능력이 높음, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BBB	채무상환능력은 충분하나, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BB	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나, 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 충분히 고려됨
B	현재로서는 채무상환능력이 있으나, 상위 등급의 기업에 비해 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 높음.
CCC	현재 채무불이행 가능성이 있으며, 채무이행 능력은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 있다고 보여짐.
CC	채무불이행 가능성이 현재로서 상당히 높음.



D	채무만기시 1건 이상의 채무를 상환하지 못한 기업을 의미함.
---	-----------------------------------

※ AA등급에서 CCC등급까지는 해당 등급에서의 상대적인 위치에 따라 '+', '-'를 추가로 부여할 수 있음.

## 나. 회사의 고객관리 정책

당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 당사 매출기여도가 매우 높고 당사 판매 전략과 부합하는 고객을 '전략 고객(Strategic Account, S/A)'으로 정하여 관리하고 있습니다. 당사의 S/A 고객은 본 보고서 작성일 현재 총 13개사로 각 응용 분야별 전략 고객의 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다.

## 다. 지식재산권 보유현황

2013년 9월 30일 현재 당사는 반도체와 관련하여 총 17,414건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 매년 기 등록된 권리를 평가하여 등록유지 또는 포기여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 감소할 수 있습니다.

특허와 실용신안권은 각국의 특허법과 실용신안법에 근거하여 보호되고 있으며, 상표권은 각국의 상표법에 근거하여 보호되고 있습니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년(실용신안은 10년), 상표는 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기한을 연장할 수 있습니다.

당사 지식재산권은 총 58인으로 구성된 전담조직에서 출원, 등록 및 사후관리, 분쟁대응등을 담당하고 있습니다. 다양한 지식재산권이 당사 제품 생산 및 사업운영에 활용되고 있으며 각각의 세부사항 및 특허권의 상세한 내용은 영업비밀에 해당되므로 기술하지 않습니다.

## 라. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항

'산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제11조'에 의하여 국가핵심기술로 지정된 반도체 제조기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 산업통상자원부에 신고할 의무를 지니고 있습니다. 이에 당사는 중국공장의 생산효율성을 극대화하고 현지 시장에서의 우위를 지속적으로 유지하기 위하여 중국 우시공장(SKHYCL)과 후공정 합작사인 HITECH에 디자인룰 25나노 DRAM 공정기술과 조립검사기술의 이전에 대하여 관련법에 의한 국가핵심기술 신고절차를 준수하여 신고 수리를 완료하였으며, 미국 SKHYA 기술센터에 25나노 DRAM 응용제품 설계기술 이전에 관한 사항을 관련법을 준수하여 신고 수리를 완료하였습니다.

당사 경영계획 일정에 따른 적기 기술 이전을 통해 차질 없는 생산 전개로 경영목표를 원활하게 달성해 나갈 것입니다.

## 마. 환경보호 정책 및 현황

### (1) ESH경영시스템 인증

당사는 국제 인증규격인 ISO14001(환경경영시스템) & OHSAS18001(안전보건경영시스템)과 국내 인증규격인 KOSHA18001(안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리하고 있으며, 기업활동으로 인

해 발생하는 환경 및 안전보건 영향요인을 효율적으로 관리하기 위해 전담조직을 구성하여 체계적으로 관리하고 있습니다.

## (2) 기후변화 협약 대응

당사는 기후변화와 관련된 유·무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에 대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.

### [온실가스 에너지 목표관리제]

당사는 정부에서 시행하는 온실가스 에너지 목표관리제 관리업체로서 2011년부터 당사의 온실가스 배출량을 측정·검증하여 보고하고 있으며, 매년 온실가스 저감 목표를 수립하여 달성을 위해 노력하고 있습니다. 공정가스인 PFCs 배출 저감을 위해 대체가스 적용, PFCs 저감 장치 효율 관리를 위한 EPA 방법론 도입 및 운영, 공정 최적화, 촉매가스 활용 등 다양한 아이টে을 지속적으로 추진하고 있으며 에너지 절감 활동에서는 전사 Task Force 운영을 통해 저감 아이টে 발굴 및 이행, 저감 로드맵 수립, 운영현황 공유 등 체계적인 관리 하에 에너지 저감 활동을 강화하고 있습니다.

### [CDP(탄소정보 공개 프로젝트) 탄소경영 최우수기업 5년 연속 선정, 명예의 전당 입성]

당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영 최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 5년 연속 편입되어 국내 최초, 국내 유일 기업으로 명예의 전당에 입성하였습니다.

## (3) 친환경제품을 위한 노력

### [전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/Eco-efficiency/탄소성적]

당사는 2010년 LCA 전산화 시스템을 구축하여 매년 DRAM 및 Nand Flash 메모리 단품 제품의 전과정평가를 확대하고 있습니다. 이러한 노력의 결과로 2013년 10월에는 환경부로부터 30나노급 4Gb DDR3 제품에 대하여 반도체 업계 최초로 환경성적표지 인증을 획득하였습니다. 또한 2008년도부터 Eco-efficiency를 개발하여 각 제품별 환경성을 공개하고, 환경영향을 감소시키기 위한 지표로 활용하고 있습니다.

당사는 2013년 6월에 30나노급 4Gb LPDDR2 제품과 20나노급 64Gb NAND 제품에 대해 환경부로부터 각각 탄소배출량 인증과 저탄소제품 인증을 획득하였습니다. 이는 2009년 탄소성적표지 최초 인증 이후 일곱 번째로 받은 인증으로 회사는 앞으로도 주요 DRAM 및 Nand Flash 제품에 대해 지속적으로 탄소성적표지 인증을 획득할 계획입니다.

## (4) 기타 환경보호 정책

2009년 5월, 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하여, 당사 환경경영성과에 대한 검증을 진행하고 그 결과를 환경경영검증위원회 보고서로 발행하여 대외 공개하였습니다.

2010년에는 검증위원회에서 자문위원회로 변경, 환경경영자문회를 개최하였으며, 당사의 전반적인 환경경영 및 환경전략관련 의견을 수렴하여 당사 경영활동에 반영하고 있습니다.



### III. 재무에 관한 사항

#### 1. 요약 연결재무정보

##### 가. 요약연결재무정보

(단위 :백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기	제64기
[유동자산]	6,802,076	5,313,573	4,936,850
· 현금및현금성자산	600,784	658,387	1,243,788
· 단기금융상품	2,491,256	1,126,229	632,139
· 매출채권	2,188,907	1,719,521	1,540,925
· 재고자산	1,153,245	1,509,331	1,183,608
· 기타	367,884	300,105	336,390
[비유동자산]	13,735,214	13,335,120	12,301,298
· 관계기업 및 조인트벤처투자	103,022	104,100	103,613
· 매도가능금융자산	49,581	44,297	47,492
· 유형자산	11,950,509	11,586,192	10,899,308
· 무형자산	1,055,582	983,630	707,648
· 기타	576,520	616,901	543,237
자산총계	20,537,290	18,648,693	17,238,148
[유동부채]	3,495,675	4,441,180	4,817,286
[비유동부채]	4,727,911	4,468,071	4,545,591
부채총계	8,223,586	8,909,251	9,362,877
[지배기업 소유주지분]	12,314,377	9,740,156	7,875,742
· 자본금	3,568,645	3,488,419	2,978,498
· 자본잉여금	3,406,148	3,053,874	1,229,052
· 기타포괄손익누계액	△57,240	△115,402	107,107
· 기타자본항목	-	-	5,762
· 이익잉여금	5,396,824	3,313,265	3,555,323
[비지배지분]	△673	△714	△471
자본총계	12,313,704	9,739,442	7,875,271
매출액	10,797,415	10,162,210	10,395,811
영업이익	2,595,034	△227,349	369,095
연결총당기순이익	2,083,710	△158,795	△55,971
지배기업의 소유주지분	2,083,680	△158,886	△56,641
비지배지분	30	91	670
기본주당순이익	2,934원	△233원	△96원

연결에 포함된 회사수	22개사	20개사	21개사
-------------	------	------	------

[△는 부(-)의 수치임]

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

※ 제66기의 연결재무상태표에 해당하는 부분은 2013년 9월 30일 기준이며, 연결포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2013년 9월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

## 2. 연결재무제표 이용상의 유의점

### 가. 감사 의견

회사는 회계처리기준 및 연결재무제표준칙에 따라 회계처리하고 있으며, 회사가 작성한 연결재무제표에 대한 감사의견은 다음과 같습니다.

구분	제66기 3분기 (2013.01.01~ 2013.09.30)	제65기 (2012.01.01~ 2012.12.31)	제64기 (2011.01.01~ 2011.12.31)
감사인	삼일회계법인 대표이사 안 경 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태
감사의견	-	적정 의견	적정 의견

### 나. 연결재무제표의 작성기준 및 중요한 회계정책

연결회사의 2013년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2013년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

연결회사는 2013년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정: 기타포괄손익 항목의 표시  
포괄손익계산서의 기타포괄손익을 당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목으로 구분하여 표시하도록 개정되었습니다. 연결회사는 이를 소급하여 적용하였으며, 이로 인하여 연결회사의 총포괄손익에 미치는 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정  
발생한 모든 보험수리적손익은 기타포괄손익으로 즉시 인식하도록 개정되었습니다. 또한 제도의 변경에 따라 발생한 모든 과거근무원가를 즉시 인식하며, 이자원가와 사외적립자산에 대한 기대수익을 별도로 산출하던 것을 순확정급여부채(자산)에 확정급여채무의 측정에 사용한 할인율을 적용하여 순이자비용(수익)을 산출하는 것으로 변경하였습니다. 개정 기준서의 적용으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'  
단일의 지배력 개념이 도입되었으며, 지배력에 대한 구체적인 지침을 제공하고 있습니다. 기업회계

기준서 제1110호의 채택으로 인한 연결회사의 연결범위 변동은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'

약정의 법률적 형식보다는 약정의 당사자가 가지는 권리와 의무에 초점을 맞추어 공동약정의 실질을 반영할 수 있도록 제정되었습니다. 공동약정은 공동영업과 공동기업으로 분류됩니다. 연결회사의 기준서 제1111호의 채택으로 인하여 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1112호 '타기업에 대한 지분의 공시'

종속기업과 관계기업, 공동기업 및 비연결구조화기업에 대한 공시사항을 규정하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정'

공정가치를 명확히 정의하고, 공정가치의 측정을 위한 체계 및 공시사항을 단일의 기준서에서 규정하고 있습니다. 연결회사는 경과규정에 따라 동 제정 내용을 전진적으로 적용하였으며 이로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

**다. 연결대상회사의 변동현황**

사업 연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사	전기대비 연결에서 제외된 사유
제66기	에스케이하이이엔지(주) 등 22개사	SK APTECH Ltd. SK hynix Semiconductor(Chongqing) Ltd. SK hynix Flash Solution Taiwan Ltd.(SKHYFST)	아미파워	청산
제65기	에스케이하이이엔지(주) (구, ㈜하이닉스엔지니어링) 등 20개사	Link_A_Media Devices Corp.(LAMD) SK hynix Italy S.r.l.	하이닉스인재개발원 하이로지텍 큐알티반도체	흡수합병
제64기	㈜하이닉스엔지니어링 (구, ㈜아스텍) 등 21개사	-	현대디스플레이테크놀로지, ProMOS특정금전신탁	청산

※ 연결대상회사의 변동현황은 한국채택국제회계기준임.

**라. 부문별 연결재무정보**

(1) 사업부문별 연결재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하여 지배적 단일사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보

(가) 지역의 구분

지리적 근접도 및 경제활동의 유사성 등을 고려하여 본국(대한민국)과 미주, 중국, 아시아, 유럽(기타) 지역으로 구분하여 표시하였습니다.

(나) 공시대상 지역부문

본국(대한민국)과 미주, 중국, 아시아 지역을 공시대상 지역에 포함하였으며, 총매출액 또는 총자산의 10% 미만인 지역(유럽)은 공시대상 지역부문에서 제외하였습니다.

(다) 지역부문별 현황

- 1) 대한민국 : 반도체소자, 소프트웨어 개발 및 정보서비스 제공업 등 영위
- 2) 미주지역 : 반도체 판매, 비메모리 시스템의 제조 판매 및 연구개발업 등 영위
- 3) 아시아지역 : 반도체소자 판매업 등 영위

(라) 지역별 재무현황

(단위 : 백만원)

구분	제66기 3분기	제65기	제64기
본국(대한민국)			
1. 매출액			
외부매출액	804,658	771,396	709,569
지역간내부매출액	10,029,724	9,513,890	9,745,014
계	10,834,382	10,285,287	10,454,583
2. 영업이익	2,424,768	△611,641	513,073
3. 자산	20,200,519	18,289,432	16,526,560
미주			
1. 매출액			
외부매출액	3,921,936	3,827,725	3,346,611
지역간내부매출액	35,281	31,222	39,646
계	3,957,217	3,858,947	3,386,257
2. 영업이익	6,989	3,814	3,094
3. 자산	1,189,593	927,223	824,293
중국			
1. 매출액			
외부매출액	2,357,184	1,901,742	1,770,690
지역간내부매출액	1,784,474	2,736,390	2,461,780
계	4,141,659	4,638,131	4,232,470
2. 영업이익	170,821	306,423	△240,991
3. 자산	3,929,656	3,862,460	4,259,503
아시아			
1. 매출액			
외부매출액	2,887,981	2,852,579	3,480,037

지역간내부매출액	15,231	8,720	49,427
계	2,903,212	2,861,299	3,529,464
2. 영업이익	5,785	11,343	19,857
3. 자산	774,326	618,703	721,295
유럽			
1. 매출액			
외부매출액	825,656	808,768	1,088,904
지역간내부매출액	15,981	13,404	16,839
계	841,638	822,172	1,105,743
2. 영업이익	3,127	5,467	2,751
3. 자산	415,431	366,474	438,471
합계			
1. 매출액			
외부매출액	10,797,415	10,162,210	10,395,811
지역간내부매출액	11,880,692	12,303,626	12,312,706
계	22,678,107	22,465,836	22,708,517
2. 영업이익			
연결조정	△16,457	57,246	27,690
계	2,595,034	△227,349	325,474
3. 자산			
연결조정	△5,972,236	△5,415,599	△5,531,974
계	20,537,290	18,648,694	17,238,148

[△는 부(-)의 수치임]

#### 마. 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등

(단위:백만달러)

구분	장비그룹	매각금액	적용연도	회계처리	
				별도기준	연결기준
에스케이하이닉스(주)	PROBE TEST	15	2012	담보부차입	담보부차입
에스케이하이닉스(주)	MODULE	10	2011	담보부차입	
에스케이하이닉스(주)	PKG/PKT	177	2010	담보부차입	
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	PROBE TEST	128	2009	금융리스	
		330			

### 3. 요약 재무정보

#### 가. 요약 별도재무정보



(단위 : 백만원)

구분	제66기 3분기	제65기	제64기
[유동자산]	6,145,217	4,695,907	4,307,194
· 현금및현금성자산	335,611	477,747	980,359
· 단기금융상품	2,419,608	1,074,661	588,528
· 매출채권	2,071,358	1,622,659	1,417,886
· 재고자산	963,893	1,199,485	928,891
· 기타	354,747	321,355	391,530
[비유동자산]	13,971,129	13,507,577	12,086,716
· 지분법적용투자주식	3,305,125	3,259,185	2,989,863
· 매도가능금융자산	49,185	43,901	47,327
· 유형자산	9,322,309	8,944,484	7,902,653
· 무형자산	763,388	713,688	705,807
· 기타	531,121	546,319	441,066
자산총계	20,116,346	18,203,484	16,393,910
[유동부채]	3,369,131	4,240,679	4,496,983
[비유동부채]	4,220,573	4,003,162	3,693,866
부채총계	7,589,704	8,243,841	8,190,849
[자본금]	3,568,645	3,488,419	2,978,498
[자본잉여금]	3,444,363	3,092,155	1,267,257
[기타포괄손익누계액]	11,163	8,479	10,375
[기타자본항목]	-	-	5,762
[이익잉여금]	5,502,471	3,370,590	3,941,169
자본총계	12,526,642	9,959,643	8,203,061
매출액	10,617,834	10,001,783	10,188,162
영업이익	2,417,892	△616,285	532,023
당기순이익	2,131,937	△489,990	129,142
기본주당순이익	3,002원	△719원	218원

[△는 부(-)의 수치임]

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

※ 제66기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2013년 9월 30일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2013년 9월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

## 4. 재무제표 이용상의 유의점

### 가. 재무제표의 작성기준 및 중요한 회계정책

회사의 2013년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제

1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2013년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 이 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에따른 별도재무제표입니다.

회사는 2013년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정: 기타포괄손익 항목의 표시  
포괄손익계산서의 기타포괄손익을 당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목으로 구분하여 표시하도록 개정되었습니다. 회사는이를 소급하여 적용하였으며, 이로 인하여 회사의 총포괄손익에 미치는 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정  
발생한 모든 보험수리적손익은 기타포괄손익으로 즉시 인식하도록 개정되었습니다. 또한 제도의 변경에 따라 발생한 모든 과거근무원가를 즉시 인식하며, 이자원가와 사외적립자산에 대한 기대수익을 별도로 산출하던 것을 순확정급여부채(자산)에 확정급여채무의 측정에 사용한 할인율 적용하여 순이자비용(수익)을 산출하는 것으로 변경하였습니다. 개정 기준서의 적용으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

-기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'  
종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 지배기업의 별도재무제표상의 회계처리만을 다루고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1113호 '공정가치측정'  
공정가치를 명확히 정의하고, 공정가치의 측정을 위한 체계 및 공시사항을 단일의 기준서에서 규정하고 있습니다. 회사는 경과규정에 따라 동 제정 내용을 전진적으로 적용하였으며 이로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

## IV. 감사인의 감사의견 등

### 1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

#### 가. 연결 감사인

제63기 3분기 (2013.01.01~ 2013.09.30)	제65기 (2012.01.01~ 2012.12.31)	제64기 (2011.01.01~ 2011.12.31)
삼일회계법인 대표이사 안 경 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태

#### 나. 당해 사업연도의 연결감사절차 요약

##### 1. 감사절차의 개요

본인(삼일회계법인)은 별첨된 에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업의 분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 연결재무제표는 2013년 9월 30일 현재의 연결재무상태표, 2013년과 2012년 9월 30일로 종료하는 3개월 및 9개월 보고기간의 연결포괄손익계산서와 9개월 보고기간의 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

경영자는 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 이 연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

본인의 책임은 상기 연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 대한민국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

본인의 검토결과 상기 연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

본인은 2012년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2013년 2월 20일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시 목적으로 첨부한 2012년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중

요성의 관점에서 차이가 없습니다.

## 2. 검토일정

□ 당반기 감사: 2013. 10. 07 ~ 11. 07

### 다. 연결 감사의견

사 업 연 도	감사의견	지적사항 등 요약
제66기 3분기	-	지적사항 없음
제65기	적정	지적사항 없음
제64기	적정	지적사항 없음

## 2. 회계감사인의 감사의견 등

### 가. 감사인

제66기 3분기 (2013.01.01~ 2013.09.30)	제65기 (2012.01.01~ 2012.12.31)	제64기 (2011.01.01~ 2011.12.31)
삼일회계법인 대표이사 안 경 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태	삼일회계법인 대표이사 안 경 태

### 나. 당해 사업연도의 감사 절차 요약

#### 1. 감사 절차의 개요

본인(삼일회계법인)은 별첨된 에스케이하이닉스 주식회사의 분기재무제표를 검토하였습니다. 동 재무제표는 2013년 9월 30일 현재의 재무상태표, 2013년과 2012년 9월 30일로 종료하는 3개월 및 9개월 보고기간의 포괄손익계산서와 9개월 보고기간의 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

경영자는 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

본인의 책임은 상기 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 대한민국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

본인의 검토결과 상기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 중요성의관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

본인은 2012년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2013년 2월 20일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2012년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

2. 검토일정

□ 당반기 감사: 2013. 10. 07 ~ 11. 07

다. 감사 의견

사업연도	감사 의견	지적사항 등 요약
제66기 3분기	-	지적사항 없음
제65기	적정	지적사항 없음
제64기	적정	지적사항 없음

라. 감사인과의 감사용역계약 체결현황

(단위: 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내용	총소요시간	보수	비고
제66기	삼일회계법인	회계감사(연결포함)	8,000	695	
제65기	삼일회계법인	회계감사(연결포함)	9,000	695	
제64기	삼일회계법인	회계감사(연결포함)	12,940	695	

마. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

(단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	내용	수행기간	보수	비고
제66기	-	-	-	-	
제65기	2012.04	지분인수 재무실사	2012.04	580	
제65기	2012.03	특정목적 감사	2012.03~12	30	
제64기	-	-	-	-	

## V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시 작성지침에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

## VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항

### 1. 이사회에 관한 사항

#### 가. 이사회구성의 개요

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 5인의 사외이사 등 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회의 2개의 소위원회가 있습니다.

#### (1) 이사회에 관한 내용

당사의 이사회는 법령과 회사 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 또한 이사 및 경영진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다.

##### 1. 상법상의 결의사항

- (1) 주주총회의 소집
- (2) 영업보고서의 승인
- (3) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인
- (4) 대표이사의 선임 및 해임
- (5) 공동대표의 결정
- (6) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
- (7) 신주의 발행
- (8) 사채의 모집
- (9) 준비금의 자본전입
- (10) 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행
- (11) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
- (12) 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임
- (13) 주식매수선택권의 부여 및 취소
- (14) 감사위원회를 제외한 위원회의 결의에 대한 수정 결의
- (15) 소규모 주식교환
- (16) 소규모합병 및 소규모분할합병
- (17) 회사 자산 및 매출액의 10분의 1 이하 규모의 영업양도의 결정
- (18) 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에서의 보고
- (19) 지배인의 선임 및 해임

##### 2. 회사 경영에 관한 중요사항

- (1) 주주총회에 부의할 의안
- (2) 사업의 계획과 운영에 관한 사항
- (3) 회사의 예산·결산
- (4) 회사 자기자본 1.5%에 해당하는 금액 또는 1,000억원 중 많은 금액 이상의 신규투자 계획, 차입(1년 이내의 단기 차입 제외), 채무의 보증, 출자, 자산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 (단, 자기

자본이라 함은 유가증권시장 공시규정상 자기자본을 의미함)

(5) <삭제 2012.3.5>

(6) 해외증권의 발행

(7) <삭제 1999.4.9>

(8) 각 위원회 규정 및 대표이사 위임사항의 제정, 개정 및 폐지

(9) <삭제 2012.3.5>

(10) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본 총계 중 큰 금액의 5% 이상이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 행위

단, 감사위원회에 3인 이상의 사외이사가 포함되고 사외이사 수가 위원 총수의 3분의 2 이상인 경우 감사위원회에 그 의결을 위임함

가. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래

나. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품·용역을 제공 또는 거래

(11) 회사 경영기본이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정

3. 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

## (2) 사외이사 현황

[제66기(2013), 2013년 3월 22일 정기주주총회 선임 이후]

(성명, 학력 및 경력, 최대주주등과의 이해관계, 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 등)

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고
김두경	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	해당사항 없음	-	-
박영준	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기공학부 교수(現)	해당사항 없음	-	-
윤세리	서울대 법학 학/석사 캘리포니아대 법학 박사 사법고시 20회 부산지검 검사 우방종합법무법인 변호사 법무법인율촌 대표 변호사(現)	해당사항 없음	-	-



김대일	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	해당사항 없음	-	-
이창양	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대 정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학원 교수(現)	해당사항 없음	-	-

- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 이사회사무국 (담당자 : 김선민 책임 ☎ 02-3459-3617)

### (3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함	
개최시기	정기 이사회	매분기 종료 후 45일 이내에 개최함
	임시 이사회	필요에 따라 수시로 개최함
소집권자	이사회 의장	
소집절차	회의일 2일전까지 각 이사에게 개최 시기, 장소 및 안건을 통지함. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다.	
결의방법	이사 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 함. 그러나, 법령 또는 정관으로 그 비율을 높게 정한 경우에는 법령 또는 정관의 규정을 따름	
부의사항	상법, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 회사에 관한 중요사항	
위 임	다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 이사회내 위원회에 위임할 수 있음 1. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 위원회에 위임할 수 없음을 명시한 사항 - 전항에 의하여 이사회가 이사회내 위원회에 위임할 사항은 해당 위원회 규정에서 정한다.	
의 사 록	이사회 의사에 관하여 의사록을 작성함 (의사록에는 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명함)	

### 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 참석				
				김두경 (출석률: 100%)	박영준 (출석률: 86%)	윤세리 (출석률: 86%)	김대일 (출석률: 86%)	이창양 (출석률: 100%)
1	13.01.29	1. 제65기(2012년) 재무제표(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 제65기(2012년) 영업보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. 2013년 경영계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

		4. 계열사(SK C&C)와의 거래	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	13.02.19	1. 대표이사 선임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 제65기 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	13.03.22	1. 계열사와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
4	13.04.23	1. 2013년 SUPEX추구협의회 관련 운영비용 거래(안)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
5	13.05.10	1. 중국 신규 후공정 회사 설립을 위한 타법인 출자(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	13.06.19	1. 계열사(SK C&C, SKT)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	13.07.24	1. 2013년 수정사업계획(안)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
8	13.09.25	1. 계열사(SK C&C)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 계열사(SK, SK플래닛)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	13.10.25	1. 결의 안건 없음	-	-	-	-	-	-

#### 다. 이사회내 위원회

##### (1) 이사회내의 위원회 구성현황

[제66기(2013), 2013년 3월 22일 정기주주총회 선임 이후]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 3명	김두경(위원장) 김대일 이창양	"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조	-
사외이사후보추천위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	박영준 윤세리 하성민	"라. (2) 이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조	-

##### (2) 이사회내의 위원회 활동내역

###### (가) 감사위원회

"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조

###### (나) 사외이사후보추천위원회

"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조

#### 라. 이사의 독립성

당사의 이사는 총 9인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 5명입니다. 사외이사는 심층면접 및 사외이사후보추천위원회의 추천에 따라 주주총회에서 선임합니다.

(1) 이사회 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 경영참고사항 비치·공시 시(2013. 03. 04) 이사 후보에 대한 인적사항 공시

성명 (생년월일)	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	비고
최태원 (1960.12.03)	SK에너지 대표이사 회장 SK주식회사 대표이사 회장(現) SK이노베이션 대표이사 회장(現) SK하이닉스 대표이사 회장(現)	이사회	없음	-
하성민 (1957.03.24)	SK텔레콤 MNO Biz 사장 SK텔레콤 대표이사 사장(現) SK하이닉스 이사회 의장(現)	이사회	없음	이사회 의장
박성욱 (1958.01.08)	하이닉스반도체 미국생산법인 담당 이사/상무 하이닉스반도체 연구소장 전무 SK하이닉스 부사장 SK하이닉스 대표이사 사장(現)	이사회	없음	
김준호 (1957.08.28)	법무부 부장검사 SK(주) 윤리경영실장/부사장 SK에너지(주) CMS 사장 겸 SK(주) 윤리경영부 문장 SK텔레콤(주) GMS 사장 SK하이닉스 Corporate Center장(現)	이사회	없음	2013년 03월 22일 선임
김두경 (1949.10.10)	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	사외이사후보 추천위원회	없음	감사위원회 위원
박영준 (1952.11.17)	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기공학부 교수(現)	사외이사후보 추천위원회	없음	
윤세리 (1953.11.20)	서울대 법학 학/석사 캘리포니아대 법학 박사 사법고시 20회 부산지검 검사 우방종합법무법인 변호사 법무법인윌촌 대표 변호사(現)	사외이사후보 추천위원회	없음	
김대일 (1962.08.18)	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	사외이사후보 추천위원회	없음	감사위원회 위원

이창양 (1962.09.20)	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학원 교수(現)	사외이사후보 추천위원회	없음	감사위원회 위원
---------------------	---	-----------------	----	----------

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

(가) 사외이사후보추천위원회 설치목적 및 권한사항

[설치목적]

관계법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하고 심사함.

[권한]

① 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정

(나) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

[제66기(2013), 2013년 3월 22일 정기주주총회 선임 이후]

성명	사외이사 여부	비고
박영준	○	- 사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8항 충족)
윤세리	○	
하성민	×	

(다) 사외이사후보추천위원회 활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명	
			박영준(출석률: -)	윤세리(출석률: -)
			찬반여부	
-	-	-	-	-

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직의 현황

지원조직	구성	주요담당업무
이사회사무국	직원 4명 (팀장 1명 포함)	- 이사회 및 소위원회 지원 - 이사직무활동 지원

(2) 사외이사 교육실적

교육일시	교육내용	교육주체
2013.03.14, 15:00	- 제1차 이사회 워크샵 ·부문 및 본부별 사업계획 보고	이사회사무국
2013.05.10, 09:00	- 제2차 이사회 워크샵 ·SK hynix의 NPE 대응 ·SK hynix NPE presentation	이사회사무국
2013.10.25, 14:30	- 제3차 이사회 워크샵 ·Rambus 분쟁 경과 ·경제민주화 관련 법률 제·개정 현황 및 회사 대응 방향	이사회사무국

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사위원이 되는사외이사 3인(김두경, 김대일, 이창양)으로 구성되어 있습니다.

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

- 설치 여부 : 감사에 갈음하는 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치(정관 제48조)
- 권한과 책임 : 회계 및 업무에 대한 감사, 외부감사인의 선임 등
- 구성 방법 : 3인 이상의 이사로 구성(단 위원 총수의 2/3 이상을 사외이사로 구성)  
위원장은 호선에 의하여 선임
- 회의 : 정기 위원회(매 분기 종료 후 45일 이내) 및 임시 위원회(필요에 따라 수시로)

나. 감사위원회의 인적사항

[제66기(2013), 2013년 3월 22일 정기주주총회 선임 이후]

성명	주요경력	결격요건 여부	비고
김 두 경	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	해당사항 없음	위원장
김 대 일	서울대 경제학 학사 시카고대 경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	해당사항 없음	-

이 창 양	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대 정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학원 교수(現)	해당사항 없음	-
-------	--	---------	---

### 다. 감사위원회의 위원의 독립성

당사는 감사위원회 3인 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 3인 중 최소 1인 이상의 회계 또는 재무전문가를 선임하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다.

- 감사위원회 규정 제3조

③ 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제12조(부의사항)

#### 3. 감사에 관한 사항

(1) 업무·재산 조사

(2) 자회사의 조사

(3) 이사의 보고 수령

(7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

(8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

- 감사위원회 규정 제13조 (관계인의 출석)

① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 경영진, 재무담당임원, 내부감사부서의 장 및 외부감사인 등을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.

② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제14조의7 (의견교환)

위원회는 감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 감사인과 회사의 내부통제제도 및 회사 재무제표의 정확성 등에 관하여 의견을 교환할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제16조 (내부감사부서의 설치)

① 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하는 전담 지원부서를 설치·운영하거나 회사의 내부감사부서를 활용할 수 있다.

② 전담 지원부서 또는 내부감사부서의 장은 위원회의 명을 받아 회사 또는 자회사의 업무 또는 재산상태 등을 조사할 수 있다.

## 라. 감사위원회의 주요활동내역

회차	일자	의안	가결여부	사외이사의 성명		
				김두경 (출석률 :100%)	김대일 (출석률 :86%)	이창양 (출석률 :100%)
				찬반여부		
1	13.01.28	1. 내부회계관리 운영 실태	보고	-	-	-
		2. 계열사(아미파워)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성
2	13.02.18	1. 2012 회계연도 회계감사 결과	보고	-	-	-
		2. 내부회계관리제도 운영실태 평가(안)	가결	찬성	찬성	찬성
3	13.03.14	1. 계열회사 대상 내부거래 한도(안)	가결	찬성	찬성	찬성
		2. 제65기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		3. 감사보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성
		4. 내부감시장치에 대한 의견서(안)	가결	찬성	찬성	찬성
		5. 내부감시부서 책임자 임명에 대한 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4	13.03.22	1. 계열사(SK C&C)와의 거래(안)	가결	찬성	불참	찬성
5	13.06.19	1. 계열사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안)	가결	찬성	찬성	찬성
		2. 계열사(SK C&C)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성
6	13.07.22	1. 2013년 상반기 재무결산 실적	보고	-	-	-
		2. 2013년 내부회계관리제도 운영 개선(안)	보고	-	-	-
		3. 2013년 상반기 내부감사 실적 및 하반기 업무 계획	보고	-	-	-
7	13.09.25	1. 계열사(SK증권) 대상 내부거래한도(안)	가결	찬성	찬성	찬성
		2. 계열사(SK C&C)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성

## 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있으며, 집중투표제나 서면투표제, 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 또한 본 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

## 4. 계열회사 등의 현황

### (1) 기업집단의 개요

- 명칭 : SK계열

### (2) 관련법령상의 규제내용 등

1) "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 상 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단 ○  
지정시기 : 1987년

○ 규제내용 요약

- 기업결합의 제한
- 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등
- 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시
- 기업집단 현황 공시 등

2) "은행법"상 동일인 및 동일차주 신용공여한도 관리 대상 기업집단

○ 규제내용 요약

- 동일인 신용공여한도 : 금융기관 자기자본의 20%
- 동일차주 신용공여한도 : 금융기관 자기자본의 25%

3) "은행감독규정"상 주채권은행 선정 대상 기업집단

○ 규제내용 요약

- 주채권은행 지정

(3) 관계회사간 출자현황

[2013년 9월 30일 기준]

(보통주 기준)

\ 피투자회사 투자회사	SK(주)	SK이노베이션	SK에너지	SK종합화학	SK텔레콤	SK네트웍스	SKC	SK건설	SK해운	SK증권
SK(주)		33.4%			25.2%	39.1%	42.5%	40.0%	83.1%	
SK이노베이션			100.0%	100.0%						
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤										
SK케미칼						0.02%		25.4%		
SKC										
SK건설										
SK가스										
SK C&C	31.8%									10.0%
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛										
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신택										
계열사 계	31.8%	33.4%	100.0%	100.0%	25.2%	39.2%	42.5%	65.4%	83.1%	10.0%



\ 피투자회사 투자회사	SK E&S	SK가스	대한송유관 공사	충청에너지 서비스	영남에너지 서비스	코원에너지 서비스	엔티스	SK텔레콤	부산도시가스	전남도시가스
SK(주)	94.1%									
SK이노베이션			41.0%							
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤								83.5%		
SK케미칼		45.5%					50.0%			
SKC										
SK건설										
SK가스										
SK C&C	5.9%									
SK E&S				100.0%	100.0%	99.9%			40.0%	100.0%
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛										
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신텍		10.0%								
계열사 계	100.0%	55.5%	41.0%	100.0%	100.0%	99.9%	50.0%	83.5%	40.0%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	강원도시가스	전북에너지 서비스	엠앤서비스	SK와이번스	인포섹	행복나래	SK텔레시스	김천에너지	에프앤유 신용정보	하남에너지 서비스
SK(주)										
SK이노베이션						42.5%				
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤				100.0%		42.5%			50.0%	
SK케미칼										
SKC							50.0%			
SK건설										
SK가스						5.0%				
SK C&C					100.0%	5.0%				
SK E&S	100.0%	100.0%						80.0%		
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛			100.0%							
SK하이닉스										
코원에너지서비스										100.0%
SK신텍										
계열사 계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.0%	50.0%	80.0%	50.0%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	SK디앤디	내트릭	로엔 엔터테인먼트	스피드모터스	SK모바일 에너지	SK유화	SK커뮤니 케이션즈	SK플래닛	SKC에어가스	SK네트웍스 서비스
SK(주)										
SK이노베이션					100.0%					
SK에너지		100.0%								
SK종합화학						100.0%				
SK네트웍스				100.0%						86.5%
SK텔레콤								100.0%		
SK케미칼										
SKC									80.0%	
SK건설	40.4%									
SK가스										
SK C&C										
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛			15.0%				64.5%			
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신텍										
계열사 계	40.4%	100.0%	15.0%	100.0%	100.0%	100.0%	64.5%	100.0%	80.0%	86.5%

\ 피투자회사 투자회사	커머스플래닛	리얼베스트	SKC솔믹스	SK브로드밴드	엘씨앤씨	피엠피	PS&마케팅	유비케어	평택에너지 서비스	위례에너지 서비스
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스					79.6%					
SK텔레콤				50.6%			100.0%			
SK케미칼								44.0%		
SKC			46.3%							
SK건설		100.0%								
SK가스										
SK C&C										
SK E&S						100.0%			100.0%	71.0%
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										
SK해운										
SK플래닛	100.0%									
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신텍										
계열사 계	100.0%	100.0%	46.3%	50.6%	79.6%	100.0%	100.0%	44.0%	100.0%	71.0%

\ 피투자회사 투자회사	제주유나이티 드 FC	MKS캐런티	SK임업	SK루브리컨츠	SKC라이팅	비젠	SK하이이엔지	SK하이스텍	실리콘화일	SK에스엠
SK(주)			100.0%							
SK이노베이션				100.0%						
SK에너지	100.0%									
SK종합화학										
SK네트웍스										
SK텔레콤										
SK케미칼										
SKC					72.2%					
SK건설										
SK가스										
SK C&C						99.0%				
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D		100.0%								
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										
SK해운										100.0%
SK플래닛										
SK하이닉스							100.0%	100.0%	27.9%	
코원에너지서비스										
SK신텍										
계열사 계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	72.2%	99.0%	100.0%	100.0%	27.9%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	SK신택	대전얌은물	광주얌은물	에스케이 더블유	텔레비전 미디어코리아	네트웍 오앤에스	서비스에이스	서비스탑	SK핀크스	유베이스메뉴 팩처링아시아
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK네트웍스									100.0%	
SK텔레콤						100.0%	100.0%	100.0%		
SK케미칼	100.0%									
SKC				90.0%						
SK건설		32.0%	42.0%							
SK가스										
SK C&C										
SK E&S										
SK커뮤니케이션즈										
SK브로드밴드										
SK D&D										
SK-컨티넨탈이모션										
SK루브리컨츠										100.0%
SK해운										
SK플래닛					51.0%					
SK하이닉스										
코원에너지서비스										
SK신택										
계열사 계	100.0%	32.0%	42.0%	90.0%	51.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

\ 피투자회사 투자회사	SK하이닉스	울산아로마틱스	SK바이오팜	SK컨티넨탈 이모션코리아	지허브	SK인천 석유화학	SK트레이딩 인터내셔널	보령 LNG터미널	이니츠
SK(주)			100.0%						
SK이노베이션						100.0%	100.0%		
SK에너지									
SK종합화학		50.0%							
SK네트웍스									
SK텔레콤	20.6%								
SK케미칼									66.0%
SKC									
SK건설									
SK가스					100.0%				
SK C&C									
SK E&S								50.0%	
SK커뮤니케이션즈									
SK브로드밴드									
SK D&D									
SK-컨티넨탈이모션				100.0%					
SK루브리컨츠									
SK해운									
SK플래닛									
SK하이닉스									
코원에너지서비스									
SK신텍									
계열사 계	20.6%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	66.0%

(\*) 사명 변경 : 울산아로마틱스(주) (舊 아로케미(주)), 행복나래(주) (舊 엠알오코리아(주)), 비젠(주) (舊 텔스크(주)), SK하이텍(주) (舊 (주)하이텍), 에스케이하이엔지(주) (舊 (주)하이닉스엔지니어링) 엔티스(주) (舊 SK사이텍(주))

#### (4) 계열회사 관리조직 현황

[SK하이엔지, SK하이텍]

당사는 상기 계열회사들과 특별약정을 체결하고 있으며, 경영기획팀에서 당사를 대표하여 대주주로서의 역할을 담당하고 있습니다. 각 계열회사의 경영상 의사결정은 자체적인이사회 의결을 원칙으로 하되, 경영계획, 이사 및 경영진 임면 등 주요 경영 사항과 관련해서는 특별약정에 의거하여 당사와 사전 협의하도록 하고 있습니다. 당사의 경영기획팀은 회사를 대표하여 이들 계열회사들에 상기 특별약정에 의거한 대주주로서의 의사표시를 하고 있습니다. 한편, 당사와 동 계열회사간의 서비스도급계약은 다른 일반 계약과 상이하지 않게 진행하고 있습니다.

[실리콘화일]

당사는 CIS(CMOS 이미지 센서)사업에 진출하면서 보다 빠른 시일내에 사업경쟁력을 확보하기 위해, 설계 경쟁력을 갖추고 있는 국내 팹리스 업체인 실리콘화일과 2007년 11월에 CIS 기술공동개발, 판권허여 및 파운드리 협력계약을 체결하였고, 2008년 8월에는 협력관계를 보다 강화하기 위해 주식인수를 통하여 실리콘화일의 경영권을 확보한 바 있습니다. 또한, 2009년 9월에는 공간적 통합을 통한 개발 효율성 및 성과 극대화 도모를 위해 CIS 사업 협력 강화를 위한 합의서를 체결하였습니다.

본 보고서 제출일 현재 당사는 최대주주로서 실리콘화일과 특별약정을 체결하고, 1인의 이사를 선임하여 경영계획, 이사 및 경영진 임면 등 주요 경영 사항과 관련하여 당사와 사전에 협의토록 하고 있으며, 계약 관계 및 기타 이사회 관련 사항 등 경영 사안에 대해 조정하고 있습니다.

[SKHYA, SKHYD, SKHYU, SKHYJ, SKHYS, SKHYIS, SKHYH, SKHYT, SKHYCS, SKHYCW]  
 당사의 상기 계열회사들은 "Distribution Agreement"에 의해 당사의 해외 법인으로서 판매행위를 대  
 행하며, 이에 계열회사 운영에 필요한 운영전반에 대해 본사의 지원을 보장 받습니다. 계열회사는  
 본사 조직으로 구성, 운영되며 각 기능상의 소속본부에서 각 업무를 관장합니다. 계열회사의 판매  
 및 마케팅 활동 등 영업활동에 필요한 제반항목에 대해 본사의 마케팅기획팀이 커뮤니케이션 창구  
 로서의 지원 업무를 수행하며 영업과 무관한 고유업무는 해당기능의 본부에서 관할합니다.

(5) 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

[제출일 현재]

겸직임원		겸직 계열회사		비고
성명	직위	회사명	상근여부	
최태원	대표이사/회장	SK(주)	상근	-
		SK이노베이션(주)	상근	-
		SK C&C(주)	상근	-
하성민	이사회 의장	SK텔레콤(주)	상근	-
박성욱	대표이사/사장	SK hynix America Inc.	비상근	-
		SK hynix Semiconductor China Ltd.	비상근	-
김준호	Corporate Center장	SK hynix America Inc.	비상근	-
		SK hynix Semiconductor China Ltd.	비상근	-

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2013년 09월 30일 )

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초 취득일자	출자 목적	최초 취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	정부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	정부 가액	총자산	당기 순이익
							수량	금액						
에스케이하이엔지(주)	2001.07.05	경영참 가	15,032	674,327	100.00	15,154			0	674,327	100.00	15,154	47,917	3,634
에스케이하이텍(주)	2008.03.15	경영참 가	5,840	277,203	100.00	6,760			0	277,203	100.00	6,760	22,748	1,590
아이파워(주)	2010.01.26	경영참 가	13,885	526,721	100.00	715	-526,721	-715	0	-	-	-	15,283	-3,067
(주)실리콘화일	2008.08.12	경영참 가	22,835	2,358,832	27.93	8,137			0	2,358,832	27.93	8,137	61,204	3,348
SK hynix America Inc. (SKHYA)	1983.03.15	경영참 가	1,231,196	6,285,587	97.74	31			0	6,285,587	97.74	31	867,351	10,498
Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA)	2004.07.09	경영참 가	98	100,000	0.05	0			0	100,000	0.05	0	52,500	-6,954
SK hynix Deutschland GmbH. (SKHYD)	1989.03.01	경영참 가	80,956	출자증서	100.00	22,011			0	출자증서	100.00	22,011	82,039	2,534
SK hynix Europe Holding Ltd. (SKHYE)	1995.04.27	경영참 가	446,766	335,640,000	100.00	1,811			0	335,640,000	100.00	1,811	199,518	0



SK hynix Asia Pte. Ltd. (SKHYS)	1991.09.12	경영참 가	137,531	196,303,500	100.00	52,380			0	196,303,500	100.00	52,380	146,471	4,619
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd. (SKHYH)	1995.04.27	경영참 가	223,233	170,693,661	100.00	32,624			0	170,693,661	100.00	32,624	326,673	3,548
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(SKHYCS)	2006.06.29	경영참 가	6,357	출자증서	100.00	4,032			0	출자증서	100.00	4,032	54,294	2,134
SK hynix Japan Inc.(SKHYJ)	1996.09.16	경영참 가	81,587	20,000	100.00	42,905			0	20,000	100.00	42,905	194,729	13,410
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc. (SKHYT)	1996.09.16	경영참 가	13,330	35,725,000	100.00	37,562			0	35,725,000	100.00	37,562	276,666	3,815
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(SKHYIS)	2007.03.29	투자	5	270	1.00	5			0	270	1.00	5	837	-12
SK hynix Semiconductor (China) Ltd. (SKHYCL)	2005.06.30	경영참 가	1,866,810	출자증서	90.26	2,421,631			0	출자증서	90.26	2,421,631	3,234,346	244,995
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SKHYMC)	2006.04.17	경영참 가	47,384	출자증서	100.00	238,271			0	출자증서	100.00	238,271	246,213	69
Hitech Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(HITECH)	2009.11.17	경영참 가	90,150	출자증서	45.00	92,608			0	출자증서	45.00	92,608	578,072	32,404
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SKHYCW)	2010.07.29	경영참 가	237	출자증서	100.00	237			0	출자증서	100.00	237	933	31
SK hynix Italy(SKHYIT)	2012.05.11	경영참 가	18	출자증서	100.00	18			0	출자증서	100.00	18	3,240	332
SK hynix memory solutions Inc.(SKHMS)	2012.08.20	경영참 가	282,293	100	100.00	282,293			0	100	100.00	282,293	7,373	-5,802
SK hynix Semiconductor Flash Solution Taiwan(SKHYFST)	2012.08.29	경영참 가	7,819	-	-	-	출자증서	7,819	0	출자증서	100.00	7,819		
SK APTech Ltd.	2013.09.02	경영참 가	38,836	-	-	-	35,000,000	38,836	0	35,000,000	100.00	38,836		
현대정보기술㈜	1994.03.24	투자	3,481	1,160,180	2.30	2,251			-203	1,160,180	2.30	2,048	156,135	-6,391
현대아이비티㈜	2007.03.23	출자전 환	63	25,286	0.01	5			-1	2,528	0.01	4	32,061	-7,958
(주)피델릭스	2008.04.18	투자	3,560	1,605,854	8.79	3,019			1,469	1,605,854	8.79	4,488	50,868	2,359
(주)아이에이	2008.09.03	투자	4,508	1,031,590	3.90	3,389			0	1,031,590	3.90	3,389	59,440	-15,751
(주)아이테스트	2006.03.13	투자	1,166	481,780	1.04	990			-31	481,780	1.04	959	174,937	430
현대로지스틱스(주)	1995.10.16	투자	76	15,115	0.08	98			0	15,115	0.08	98	727,648	-53,199
(주)이큐베스텍	2002.01.18	투자	10	2,000	1.67	10			0	2,000	1.67	10	4,689	-248
Phison Electronics Corp.	2008.07.16	투자	11,661	3,277,054	1.83	23,277			2,144	3,277,054	1.82	25,422	638,792	99,580
특정금융신탁	2008.11.17	투자	21,847	201,600,000	7.93	0			0	201,600,000	7.93	0	1,405,327	-470,296
인텔렉추얼디스커버리	2011.05.13	투자	4,000	800,000	8.94	4,000			0	800,000	8.94	4,000	41,462	-7,947
기타	-	투자	16,332			2			0			2		
합 계						3,296,226			3,378			3,345,545		

※ 최근 사업년도 재무현황은 2012년말 실적이며, 미공시 법인은 2012년 9월말 재무제표를 반영

※ 법인명 '기타' 항목은 손상차손 및 출자전환 주식으로 장부가액이 감소한 법인들을 표시함

## VII. 주주에 관한 사항

### 1. 최대주주 등에 관한 사항

#### 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

[제출일 현재]

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
에스케이텔레콤(주)	최대주주	보통주	146,100,000	21.05	146,100,000	20.57	유상증자 참여 / 구주지분 인수
최신원	특별관계자	보통주	5,000	0.00	5,000	0.00	장내매수
박성욱	특별관계자	보통주	1,394	0.00	1,394	0.00	장내매수
김준호	특별관계자	보통주	8,940	0.00	8,940	0.00	장내매수
엄낙용	특별관계자	보통주	40	0.00	40	0.00	장내매수
계		보통주	146,115,374	21.05	146,115,374	20.57	-
		우선주	0	0.00	0	0.00	
		합계	146,115,374	21.05	146,115,374	20.57	

최대주주명 : 에스케이텔레콤(주)

특수관계인의 수 : 4명

#### (주1) 최대주주(법인)에 대한 개요

에스케이텔레콤은 정보통신업, 단말기 매매 및 임대업, 뉴미디어사업 등을 영위하는 사업자로 1984년 3월 29일 설립되었습니다. 에스케이텔레콤은 단말, 요금제, 네트워크, 콘텐츠등의 본원적 경쟁력을 기반으로 하여 이동통신서비스를 제공하고 있으며, 국내 최초 LTE 상용화를 통해 기존에는 유선 네트워크 환경에서 가능했던 고품질의 동영상 서비스 및 멀티미디어 게임 등 다양한 서비스가 무선 환경에서도 활성화될 수 있는 제공 기반을 마련하였습니다. 2013년 3월 23일 정기주주총회 기준 에스케이텔레콤의 등기임원은 총 8명으로 사내이사 3명(하성민, 조대식, 지동섭), 사외이사 5명(엄낙용, 오대식, 임현진, 정재영, 조재호)으로 구성되어 있습니다.

#### - 등기임원 현황

이름	약력
----	----

하성민	- SK텔레콤 경영기획실장(前) - SK텔레콤 경영지원부문장(前) - SK텔레콤 MNO Biz 사장(前) - SK텔레콤 대표이사/사장(現)
조대식	- SK(주) 재무담당(前) - SK(주) 경영분석실장(前) - SK(주) 사업지원부문장(前) - SK(주) 재무팀장 겸 자율책임경영지원단장(前) - SK(주) 사장(現)
지동섭	- SK(주) 기업문화부문장(前) - SK텔레콤 IPE 사업단장(前) - SK텔레콤 MNO기획실장(前) - SK텔레콤 미래경영실장(現)
엄낙용	- 한국산업은행 총재(前) - 제2대 재정경제부 차관(前) - 제16대 관세청장(前) - 중앙대학교 초빙교수(現)
오대식	- 국세청 정책홍보관리관(前) - 국세청 조사국 국장(前) - 서울지방국세청 청장(前) - 법무법인 태평양 고문(現)
임현진	- 미국 듀크대 사회학과 초빙교수(前) - 제48대 한국사회학회 회장(前) - 서울대학교 사회과학대학 학장(前) - 서울대학교 사회과학대학 사회학과 교수(現) - 서울대학교 아시아연구소 소장(現)
정재영	- 성균관대학교 인문사회과학캠퍼스 부총장(前) - 한국국제통상학회 회장(前) - 성균관대학교 경영학부 교수(前) - 한선국가전략포럼 공동대표(現) - 성균관대학교 명예교수(現)
조재호	- 뉴욕시립대 바루크대학 교수(前) - 금융위원회 금융발전심의회 자본시장분과위원장(現) - 학교법인 경희학원 재단이사(現) - 서울대학교 경영대학 교수(現)

- 재무현황

(단위: 백만원)

구분	2012년말	2011년말
자산총계	25,595,560	24,366,036
부채총계	12,740,777	11,633,327
자본총계	12,854,782	12,732,709
영업이익	1,760,171	2,295,613

당기순이익	1,115,663	1,582,073
-------	-----------	-----------

나. 최대주주의 변동 현황

[제출일 현재]

(단위 : 주, %)

최대주주명	사업연도	지분변동일	소유주식수	지분율(%)	변동 사유
(주)한국외환은행	2007	-	37,742,000	8.2	-
	2008	-	37,742,000	8.2	-
	2009	2009.01.17	37,742,000	7.3	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
		2009.05.19	37,742,000	6.4	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
한국정책금융공사	2010	2010.03.16	32,412,935	5.5	변경 전 최대주주의 지분매각
미래에셋자산운용투자자문(주)		2010.03.19	35,362,056	6.0	장내 매수/매도
		2010.05.04	44,041,030	7.46	장내 매수/매도
한국정책금융공사		2010.08.03	32,412,935	5.50	변경 전 최대주주의 지분매각
국민연금공단	2010	2010.10.11	35,894,454	6.08	장내 매수/매도
	2011	2011.01.10	47,786,668	8.10	장내 매수/매도
		2011.04.11	53,774,325	9.11	장내 매수/매도
		2011.07.08	47,838,426	8.08	장내 매수/매도
		2011.10.07	54,202,391	9.15	장내 매수/매도
에스케이텔레콤(주)	2012	2012.02.15	146,100,000	21.05	유상증자 참여 및 구주 지분 인수
		2012.02.23	146,105,000	21.05	특별관계자 추가
		2012.04.02	146,119,894	21.05	계열편입에 따른 특별관계자 추가
		2012.06.22	146,127,934	21.05	특별관계자 추가
	2013	2013.05.09	146,115,374	20.57	특별관계자 제외 및 추가

## 2. 주식의 분포

### 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황

[제출일 현재]

(단위 : 주, %)

순위	성명(명칭)	보통주		우선주		소계		비고
		주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	
1	에스케이텔레콤(주)	146,115,374	20.57	-	-	146,115,374	20.57	(주1)
2	국민연금공단	66,862,226	9.41	-	-	66,862,226	9.41	(주2)
합 계		212,977,600	29.99			212,977,600	29.99	

(주1) 상기 에스케이텔레콤(주)의 보유내역은 주식관리협회의 구주지분 44,250,000주 인수 및 제3자배정 유상증자 참여 주식 101,850,000주와 특별관계자의 보유주식 15,374주를 합산한 것임.

(주2) 상기 국민연금공단의 보유내역은 2012년 12월 31일자 주주명부 기준임.

### 나. 주주 분포

[실질주주기준]

2012년 12월 31일 현재

구분	주주수	비율	주식수	비율	비고
소액주주 합계	327,191	99.99	439,533,884	63.31	-
소액주주(법인)	2,104	0.64	135,130,053	19.46	-
소액주주(개인)	325,087	99.35	304,403,831	43.85	-
대주주 1인	1	0	101,850,000	14.67	-
기타주주 합계	9	0	152,771,883	22.00	-
기타주주(법인)	6	0	125,365,148	18.06	-
기타주주(개인)	3	0	27,406,735	3.94	-
합 계	327,201	100.00	694,155,767	100.00	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2012년 12월 31일 기준임.

## 3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	<p>제10조(신주인수권)</p> <p>① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.</p> <p>② 이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 신주를 인수하게 하는 경우 &lt;개정 2009.3.26&gt;</p> <p>2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하게 하는 경우 &lt;개정 2009.3.26&gt;</p>
------------------	--

	<p>3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 &lt;개정 2009.3.26&gt;</p> <p>4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 &lt;개정 2009.3.26&gt;</p> <p>5) 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &lt;개정 2000.3.24, 2009.3.26&gt;</p> <p>6) 자금조달, 기술도입 기타 경영상 필요로 국내외 금융 기관 (여기서 '금융기관'이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항의 전문투자자를 의미하되, 동항 제4호의 주권상장법인, 동법 시행령 제10조 제3항 제16호 및 제17호의 법인, 단체 또는 개인은 포함하지 아니한다), 제휴법인, 전략적 투자자 또는 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 &lt;개정 1999.3.26, 2001.3.29, 2009.3.26, 2010.3.26&gt;</p> <p>7) 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>8) 회사가 "경영상 필요로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 제1항 제2호 가목 내지 다목의 자"에게 신주를 발행하는 경우 [신설 1999.3.26] &lt;개정 2009.3.26&gt;</p> <p>9) 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우[신설 1999.3.26]</p> <p>10) 근로자복지기본법의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 [신설 2006.3.28]</p> <p>③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.</p>		
결산일	12월 31일	정기주주총회	3월중
주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 31일 까지		
주권의 종류	일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권 (8종)		
명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 여의도동 43-2)		
주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지게재<개정 2012.03.23>

## 4. 주가 및 주식 거래실적

### 가. 국내증권시장

(단위 : 원, 천주)

종류		'13년 09월	'13년 08월	'13년 07월	'13년 06월	'13년 05월	'13년 04월
보통주	최고주가	30,550	29,150	31,550	32,650	32,200	29,900
	최저주가	27,100	26,200	27,000	29,500	28,550	27,800
	평균주가	29,261	27,802	28,378	31,303	30,279	28,827
거래량	최고일거래량	20,625	10,263	21,019	6,709	10,882	11,395
	최저일거래량	3,036	2,594	2,614	2,590	2,519	1,973
	월간거래량	111,131	107,296	159,347	92,187	99,765	86,134

※ 주가는 일별 종가 기준임.

## 나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 룩셈부르크]

(단위 : USD, DR)

종 류		'13년 09월	'13년 08월	'13년 07월	'13년 06월	'13년 05월	'13년 04월
GDR	최 고	-	-	-	-	-	-
	최 저	-	-	-	-	-	-
월간거래량		-	-	-	-	-	-

※ GDR의 거래량은 미미하며, 장외비중이 크므로 거래량의 정확한 산정이 어려워 기재를 생략함.

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

### 1. 임원 및 직원의 현황

#### 가. 임원의 현황

##### (1) 등기임원의 현황 [제66기]

(기준일 : 2013년 09월 30일 )

(단위 : 주)

성명	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
							보통주	우선주		
최태원	1960.12	회장	등기임원	상근	대표이사	미국 시카고대 경제학 박사수료 SK주식회사 대표이사 회장(現) SK이노베이션 대표이사 회장(現) SK C&C 이사(現) SK하이닉스 대표이사 회장(現)	-	-	선임(12.02.14)	-
하성민	1957.03	이사회 의장	등기임원	상근	이사회 의장	성균관대 경영학 학사 SK텔레콤 MNO Biz 사장 SK텔레콤 대표이사 사장(現) SK하이닉스 이사회 의장(現)	-	-	선임(12.02.14)	-
박성욱	1958.01	사장	등기임원	상근	대표이사	한국과학기술원(KAIST) 재료공학 박사 SK하이닉스 연구개발총괄	1,394	-	선임(09.03.26) 중임(12.02.14)	-
김준호	1957.08	사장	등기임원	상근	Corporate Center장	고려대 법학 학사 법무부 부장검사 SK(주) 윤리경영실장/부사장 SK에너지(주) CMS 사장 겸 SK(주) 윤리경영부문장 SK텔레콤(주) GMS 사장	8,940	-	선임(13.03.22)	-
김두경	1949.10	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	-	-	선임(12.02.14)	-
박영준	1952.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사후보 추천위원회 위원	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기공학부 교수(現)	-	-	선임(12.02.14)	-
윤세리	1953.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사후보 추천위원회 위원	서울대 법학 학/석사 캘리포니아대 법학 박사 사법고시 20회 부산지검 검사 우방종합법무법인 변호사 법무법인윌촌 대표 변호사(現)	-	-	선임(12.02.14)	-



김대일	1962.08	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	-	-	선임(12.02.14)	-
이창양	1962.09	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학원 교수(現)	-	-	선임(12.02.14)	-

※ 등기임원의 담당업무 및 소유주식현황은 제66기 분기보고서 제출일 기준임.

## (2) 등기임원의 겸직 현황

[제출일 현재]

겸직임원		겸직회사		비고
성명	직위	회사명	직위	
최태원	대표이사/회장	SK(주)	대표이사/회장	
		SK이노베이션(주)	대표이사/회장	
		SK C&C(주)	이사	
하성민	이사회 의장	SK텔레콤(주)	대표이사/사장	
박성욱	대표이사/사장	SK hynix America Inc.	이사	
		SK hynix Semiconductor China Ltd.	이사	
김준호	Corporate Center장	SK hynix America Inc.	이사	
		SK hynix Semiconductor China Ltd.	이사	
김두경	사외이사	주식회사 전북은행	사외이사	
윤세리	사외이사	두산인프라코어(주)	사외이사	
이창양	사외이사	Tokai Carbon Korea	사외이사	

## (3) 미등기 임원 현황(제출일 현재)

직명 (상근여부)	등기임원 여부	성명	생년월일	약력	담당업무	소유주식수		비고
						보통주	우선주	
사장 (상근)	미등기임원	오세용	54.12.15	MIT(재료) 박사 AIPT	제조부문장	-	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	김용탁	58.09.25	성균관대(전자) 학사 DRAM개발본부장	개발부문장	17,548	-	-
전무 (상근)	미등기임원	이석희	65.06.23	Stanford Univ.(재료) 박사 KAIST 교수	미래기술연구원장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	홍성주	62.11.06	KAIST(물리학) 박사 연구소장	DRAM개발본부장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	김진웅	64.02.01	KAIST(재료) 박사 연구소 FLASH공정그룹장	FLASH Tech개발본부장	2,771	-	-

전우 (상근)	미등기임원	배기현	58.11.16	경북대(전자) 학사 Anobit	Flash Solution개발본부장	-	-	-
전우 (상근)	미등기임원	김동균	57.11.05	고려대(재료) 학사 구매실장	FAB제조본부장	-	-	-
전우 (상근)	미등기임원	한성규	58.10.27	경북대(전자) 학사 제조본부장	SystemIC사업부장	4,933	-	-
전우 (상근)	미등기임원	고요환	60.07.23	KAIST(전자) 박사 Flash개발본부장	품질보증실장	10,000	-	-
전우 (상근)	미등기임원	진정훈	63.10.21	JOHN MARSHALL LAW SC 박사 마케팅본부 해외영업단장	마케팅본부장	-	-	-
전우 (상근)	미등기임원	송현중	65.11.23	M.I.T(경영) 석사 SK텔레콤	미래전략실장	-	-	-
전우 (상근)	미등기임원	현순엽	63.10.27	서울대(경영) 석사 SK이노베이션	기업문화실장	3,520	-	-
전우 (상근)	미등기임원	최영준	63.01.09	동국대(전자) 학사 ADATA	Flash상품기획그룹장	-	-	-
전우 (상근)	미등기임원	진교원	62.09.22	서울대(물리) 학사 마케팅본부 상품기획그룹장	SC사업기획본부파견	112	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박정식	63.12.05	홍익대(전자) 석사 PKG&TEST제조본부 D-TEST기술그룹장	PKG&TEST제조본부장	112	-	-
상무 (상근)	미등기임원	양예석	60.01.11	인하대(화학) 학사 Flash개발본부장	Mobile개발본부장	428	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이상선	61.09.23	고려대(전기) 학사 FAB제조본부 M11제조기술/신제품그룹장	청주FAB장	4,000	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장성춘	59.01.04	연세대(기계공학) 학사 제조지원실장	경영지원실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이명영	62.02.20	연세대(경영) 학사 SK네트웍스	재경실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	임종필	60.11.14	고려대(화학공업) 학사 SK텔레콤	SCM실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정재관	60.09.09	영남대(물리) 석사 DRAM개발사업부 MM소자2팀장	미래기술연구원 DRAM소자 기술그룹장	2,144	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이석규	63.12.21	서울대(재료) 박사 연구소 Flash개발소자그룹장	미래기술연구원 Flash소자기 술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김형수	65.02.24	KAIST(재료) 박사 연구소 기술기획팀장	미래기술연구원 NM공정그룹 장	500	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박성기	59.08.12	연세대(요업) 학사 연구소 NM공정그룹장	미래기술연구원 DRAM공정 그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이병석	61.03.25	영남대(화학) 석사 연구소 Flash공정3팀장	미래기술연구원 Flash공정그 룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	임동규	64.04.10	서울대(물리교육) 박사 연구소 선행공정1팀장	미래기술연구원 MASK기반 기술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김동석	60.02.12	경북대(물리) 석사 연구소 FAB기술Etch팀장	미래기술연구원 DRAM공정 2팀장	2,990	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정병태	61.03.01	경북대(물리) 석사 연구소 설계2그룹장	DRAM개발본부 DRAM설계그 룹장	-	-	-

상무 (상근)	미등기임원	위보령	64.06.26	KAIST(물리) 박사 제품개발본부 MM소자1팀장	DRAM개발본부 DRAM응용그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박근우	66.04.20	KAIST(전자) 석사 연구소 선행설계그룹장	Flash Tech개발본부 Flash설계그룹장	2,141	-	-
상무 (상근)	미등기임원	안근옥	59.08.15	단국대(전자) 학사 리디스테크놀로지	Flash Tech개발본부 Flash소자그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	양중섭	64.12.19	KAIST(물리) 석사 Flash개발본부 Flash제품그룹장	FlashSolution개발본부 MobileSolution그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김현근	62.07.17	KAIST(물리) 박사 Mobile사업부 Mobile개발그룹장	Mobile개발본부 Mobile설계그룹장	2,749	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김진국	64.07.17	연세대(전기) 학사 DRAM개발본부 MM소자그룹장	Mobile개발본부 Mobile소자그룹장	543	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김영호	61.05.17	고려대(재료) 학사 FAB제조본부 M10Yellow제조기술그룹장	SCM실 구매1그룹장	328	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이승용	59.08.05	중앙대(전자계산) 학사 PKG&TEST제조본부 F-P&T그룹장	PKG&TEST제조본부 D-TEST제조그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	변광유	59.08.11	인하대(기계) 학사 PKG&TEST제조본부 PKG연구1그룹장	PKG&TEST제조본부 PKG연구2그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김남석	67.02.20	서울대(금속) 박사 PKG&TEST제조본부 PKG연구2그룹장	PKG&TEST제조본부 PKG연구1그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	유경동	61.12.23	옥스포드(재료) 박사 CIS개발설계그룹장	SystemIC사업부 Image개발그룹장	2,480	-	-
상무 (상근)	미등기임원	홍상후	63.02.20	성균관대(전자) 학사 품질보증실 품질기술담당	품질보증실 응용복합품질보증그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	오종훈	64.08.20	서울대(전자) 학사 키몬다	DRAM상품기획그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박래학	61.05.05	한양대(물리) 학사 마케팅본부 MobileSolution마케팅그룹장	마케팅본부 Mobile&Consumer마케팅그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최춘엽	60.08.28	전북대(경영) 학사 SKHYD 법인장	마케팅본부 영업1그룹장	1,428	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이우빈	64.10.27	Univ. of Washington(전자) 박사 Aptina	마케팅본부 SystemIC 상품기획TF장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이상래	65.07.09	Boston(MBA) 경영전략실 기술경영팀장	미래전략실 경영전략그룹장	2	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최석문	66.04.13	Univ. of Michigan(경영학) 석사 SK텔레콤	미래전략실 경영기획그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장종태	64.10.20	한양대(사회학) 학사 SK텔레콤	기업문화실 인력개발그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최석훈	57.12.23	일산고등학교	기업문화실 노사협력그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	천명환	58.09.07	경기대(회계) 학사 현장경영그룹장	경영지원실 경영지원그룹장	6,088	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김정수	59.06.06	연세대(제어공학) 석사	재경실 IR/PR그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이철호	60.09.15	광운대(재료) 학사 품질보증실 DRAM품질보증그룹장	현장경영그룹장	-	-	-

상무 (상근)	미등기임원	김은태	58.11.12	인하대(전자) 학사 특허그룹장	윤리경영그룹장	-	-	-
------------	-------	-----	----------	---------------------	---------	---	---	---

※ 미등기임원의 담당업무 및 소유주식현황은 제66기 3분기보고서 제출일 기준임.

## 나. 직원의 현황

(기준일 : 2013년 09월 30일 )

(단위 : 천원)

사업부문	성별	직원 수				평균 근속연수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
		정규직	계약직	기 타	합 계				
-	남	10,880	9	-	10,889	10.1	569,980,529	52,345	-
-	녀	9,356	11	-	9,367	7.7	331,957,706	35,439	-
합 계		20,236	20	-	20,256	9.0	901,938,235	44,527	-

※ 상기 직원의 수는 본사기준이며, 사내이사 제외 기준임.

※ 상기 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임.

## 다. 노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고
가입대상	이천 7,489명 / 청주 5,148명	-
가입인원	이천 7,291명 / 청주 5,095명	-
근로시간 면제자	이천 10명 / 청주 6명	-
소속된 연합단체	한국노총 금속연맹	-
기 타	-	-

## 라. 회계 및 공시 전문인력 보유현황

구 분	보 유 인 원	담 당 업 무	비 고
미국공인회계사	2	재무회계	-
	2	관리회계	-
	2	재무관리	-
공인회계사	1	IR	-
공 시	2	공 시 / 상 장	-
국내변호사	6	법률자문	-
미국변호사	5		-

## 2. 임원의 보수 등

## 가. 임원의 보수 현황

### (1) 주총승인금액

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	비고
등기임원	9명	5,000	-

### (2) 지급금액

(단위 : 백만원)

구분	인원수	지급총액	1인당 평균 지급액	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	4	2,637	659	-	-
사외이사	2	90	45	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	135	45	-	-
계	9	2,862	318	-	-

※ 제 66기 이사 및 감사위원회 위원 기준임.

※ 지급총액은 공시대상기간 중 임기만료한 이사의 보수를 포함함.

## 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

※ 해당사항 없음.

## 다. 임원배상책임보험 가입 현황

### (1) 보험의 개요

[2013. 09. 30 현재]

(단위 : 백만원)

보험의 명칭	보험료납입액		부보(보상) 한도	비고
	당기 납입액	누적납입액 (당기분 포함)		
임원배상책임보험	128	128	50,000	

### (2) 피보험자

회사 및 회사의 과거·현재·미래의 모든 임원으로 보험기간 중 선임, 퇴임 임원을 모두 포함합니다.

### (3) 보상하는 손해

임원의 업무상 과실 및 임원으로서 의무위반으로 최초 제기된 손해배상 청구에 따른 주주 또는 제

3자에 대한 손해배상책임을 보상하며, 임원의 손해배상청구에 대해 회사가 해당임원에게 지급한 회사발생 손해를 보상합니다.

#### (4) 보험회사의 면책사항

- 보험개시일 이전의 원인행위로 인해 발생한 손해배상
- 법령을 위반하여 발생한 환경오염에 대해 제기되는 손해배상청구
- 임원의 범죄행위(사기, 횡령, 배임 등)로 인한 손해배상청구

## IX. 이해관계자와의 거래내용

### 1. 대주주등에 대한 신용공여 등

#### 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역				미수 이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
SK hynix America Inc.(SKHYA)	계열사	단기 대여금	48,200 (USD45,000,000)	202	-	48,402 (USD45,000,000)	78 (USD72,686)	거래기간: 2010.11.16 ~ 2013.11.15
SK hynix memory solutions Inc. (SKHMS)	계열사	장기 대여금	5,356 (USD5,000,000)	22	-	5,378 (USD5,000,000)	1 (USD694)	거래기간: 2012.09.27 ~ 2015.09.27
		장기 대여금	5,356 (USD5,000,000)	22	-	5,378 (USD5,000,000)	8 (USD7,362)	거래기간: 2012.11.20 ~ 2015.09.27
아이파워	자회사	장기 대여금	12,465	-	12,465	-	-	-
합 계			71,377	246	12,465	59,158	87	-

※ 당기 중 증감분에는 환율변동으로 인한 외화평가금액이 반영되었음.

#### 나. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	거 래 내 역				비 고
		기초	증가	감소	기말	
SK hynix America Inc. (SKHYA)	계열사	13,003 (USD12,139,860)	-	1,589 (USD1,527,954)	11,414 (USD10,611,907)	-
합 계		13,003	-	1,589	11,414	-

※ 당기 중 증감분에는 환율변동으로 인한 외화평가금액이 반영되었음.

### 2. 대주주와의 자산양수도 등

#### 가. 영업양수도 내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	거래일자	거래일자 기준	거래금액	거래내용	비고
SK텔레콤(주)	최대주주	2011.11.14	계약 체결일	1,084,125	지분인수계약 체결	-

회사의 주식관리협의회 및 회사는 2011년 11월 14일 SK텔레콤(주)와 지분인수계약을 체결하였습니다. SK텔레콤(주)는 동 계약에 따라 2012년 2월 14일에 주식관리협의회가 보유한 지분 4,425만주를 매입하고 회사가 제3자 배정방식으로 발행한 신주 1억 185만주를 인수하여 회사 발행 보통주식의 약 21.05%를 취득함으로써 회사의 최대주주가 되었습니다.

## 나. 자산양수도 내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	거래일자	거래일자 기준	거래금액	거래내용	비고
SK에너지(주)	계열회사	2013.03.01	양수도일	9,106	비용 절감 목적으로 해당 설비를 Utility 전문업체에 매각	-
아미파워(주)	자회사	2013.07.31	매입대금 지급일	18,262	아미파워 토지 매입	매입대금 및 철거비용 포함



## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

### 1. 공시내용의 진행 · 변경사항 및 주주총회 현황

#### 가. 공시사항의 진행 · 변경사항

신고일자	제 목	신고한 내용	신고사항의 진행상황
2011.09.26	소송 등의 제기 · 신청	1. 사건의 명칭 : 약정금등 청구의 소 2. 원고·신청인: 현대중공업 주식회사 3. 피고: (주)하이닉스반도체, 현대증권(주), 이익 치	<p>1. 2009년 10월 22일 서울중앙지방법원은 다음과 같이 판결함.</p> <p>가) 피고 (주)하이닉스반도체는 원고에게 50,302,838,040원 및 그 중 별지 1. 도표 '청구금액'란 기재 각 금액에 대하여 목록 '지연손해금 기산일'란 기재 각 일자부터 2009. 10. 22까지는 연 6%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.</p> <p>나) 피고 (주)현대증권, 이익치는 피고 (주)하이닉스반도체와 연대하여 원고에게 40,242,270,429원 및 그 중 별지 2. 도표 '청구금액'란 기재 각 금액에 대하여 같은 목록 '지연손해금 기산일'란 기재 각 일자부터 2009. 10. 22까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.</p> <p>- 당사대책: 당사는 지연이자 지급 부담을 회피하기 위하여 공동피고인 현대증권(주)과 연대하여 동 판결 선고일인 2009. 10. 22 현대중공업(주)에 지연이자를 포함한 판결에 따른 책임금액 전부를 가지급 완료하였으며, 2009년 11월 11일, 위 약정금 등 청구사건의 판결에 불복하여 고등법원에 항소를 제기함.</p> <p>2. 2010년 12월 17일 서울중앙지방법원은 다음과 같이 판결함.</p> <p>(주)하이닉스반도체는 현대증권(주)에게 금 99,172,640,749원 및 이에 대한 지연이자를 지급하라.</p> <p>- 당사대책: 당사는 동 판결 선고일인 2010. 12. 17일자로 현대증권(주)에 판결에 따른 판결금액 및 지연이자를 합산한 1,607억원을 전액 지급 완료함.</p> <p>3. 2011년 9월 23일 서울 고등법원은 당사의 항소건과 관련하여 다음과 같이 판결함.</p> <p>가) 원고의 항소를 기각한다.</p> <p>나) 항소비용은 원고가 부담한다.</p>

2012.02.14	소송 등의 제기·신청	<p>1. 사건의 명칭 : 외화대납금 반환등 청구</p> <p>2. 원고: 현대중공업 주식회사</p> <p>3. 피고: (주)하이닉스반도체 [파기환송 前 공동피고: 현대증권(주), 이익치]</p>	<p>1. 2009년 8월 21일 서울고등법원은 다음과 같이 판결함. 대법원에서 파기환송된 (주)하이닉스반도체 부분에 대하여 서울고등법원은 당심에서 추가된 청구를 포함하여 제1심 판결을 다음과같이 변경하여 판결함.[판결 주문]: 피고는 원고에게 167,218,970,904원 및 그 중 160,730,470,835원에 대하여 2002. 4. 18.부터 2009. 8. 21.까지는 연6%, 그 다음날부터 다 갚는날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라.</p> <p>- 당사대책: 당사는 자연이자 지급 부담을 회피하기 위하여 동 판결 선고일인 2009년 8월 21일 현대중공업에 이자를 포함하여 86,226백만원을 가지급 완료함으로써 판결에 따른 책임금액을 전부지급하였음.</p> <p>2. 2009년 09월 10일, 위 외화대납금반환 등 청구사건의 서울고등법원 파기환송심 판결에 대하여 현대중공업(주)는 원고 패소부분 중 금 13,136,180,341원 및 이에 대한 지연손해금 부분에 대하여 불복하여 대법원에 상고를 제기하였으며, 2012년 02월 09일 대법원은 원심판결의 원고 패소부분 중 4,283,500,000원 및 이에대한 지연손해금 부분을 파기하고 서울고등법원에 환송함.</p> <p>- 당사대책: 당사는 동 대법원 판결에 따라 변경될 판결금액 원리금 합계금7,971,137,550원을 현대중공업(주)에 2012년 02월 14일자로 조건부 변제하였으며, 향후 서울고등법원의 판결 선고 결과에 따라 정산할 예정임.</p>
------------	----------------	---	--

2013.06.12	기술도입·이전·제휴계약 체결 (자율공시)	<p>1. 사건의 명칭: 램버스와의 특허권 침해소송</p> <p>2. 원고(항소인) : Hynix Semiconductor Inc., Hynix Semiconductor America Inc., Hynix Semiconductor U.K.Ltd., and Hynix Semiconductor GmbH.</p> <p>3. 피고 (피항소인) : Rambus, Inc.</p>	<p>1. 2009년 3월 10일(미국 현지시간), 미국 캘리포니아주 북부지구 연방지방법원(The United States District Court For the Northern District of California) San Jose Division은 미화 396,881,244달러의 손해배상금 및 2009년 2월 1일 이후부터 향후 2010년4월 18일까지 미국에 판매되는 당사 제품에 대해서는 SDR(Single Data Rate) DRAM의 경우 1%, DDR(Double Data Rate) DRAM의 경우 4.25%의 로열티 요율을 적용한 손해배상금을 당사가 램버스에 지불할 것을 결정하는 1심 최종 판결을 내린바 있음.</p> <p>2. 당사는 이에 불복하여 미국 현지시간으로 2009년 4월 6일 미국 연방고등법원에 항소한 결과, 미국 현지시간으로 2011년 5월 13일 미국 연방고등법원은 램버스의 불법적인 증거 파기 행위가 있었음을 판시하고, 1심 법원의 원심을 파기환송하면서 1심 법원이 증거 파기 행위에 고의(Bad-faith)가 있었는지, 하이닉스의 방어권에 악영향을 미쳤는지 (Prejudice) 부분에 대하여 재 심리하고 그에 따른 적절한 조치를 취할 것을 명령하였음.</p> <p>3. 2013년 5월 8일(미국 현지시간), 미국 캘리포니아주 북부지구 연방지방법원(The United States District Court For the Northern District of California)은 기존 입장을 바꾸어, 램버스의 증거파기행위는 불법이라고 판시하며 원심에서 인정한 손해배상금에서 미화 2억 5천만불을 감액하라는 결정을 내렸음.</p> <p>4. 2013년 6월 11일, 램버스와 향후 5년간 반도체 전제품 관련 특허 기술의 사용권에 대해 특허 라이선스 계약을 체결하였으며, 양사간 진행 중인 모든 소송을 취하함.</p>
------------	------------------------	---	--

**나. 주주총회 의사록 요약**

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제 65기 정기주주총회 (2013.03.22)	제65기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건(후보: 김준호)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 50억원)	
제 64기 정기주주총회 (2012.03.23)	제64기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인	-
	정관 변경의 건	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 50억원)	
임시주주총회 (2012.02.13)	정관 변경의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건	원안대로 승인	

	사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
제 63기 정기주주총회 (2011.03.30)	제63기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	원안대로 승인	-
	이사 선임의 건	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 50억원)	

## 2. 우발채무 등

### 가. 중요한 소송사건

#### □ Rambus 특허권 침해소송

회사는 High-bandwidth chip connection 기술의 개발자인 Rambus사로부터, 회사의 SDR SDRAM, DDR SDRAM, GDDR 메모리 제품이 Rambus사 특허권을 침해한다고 주장하는 특허 침해 소송과 회사와 회사의 경쟁회사들이 Rambus사 제품인 RDRAM의 시장진입을 방해하였다고 주장하는 반독점 소송에 피소된 바 있습니다.

그러나, 2013년 6월 11일 회사와 Rambus사는 특허 라이선스 계약을 체결하면서 진행 중인 모든 소송을 취하하였고, 회사는 향후 5년간 Rambus사의 특허를 사용할 수 있는 권리를 확보하였습니다.

#### □ 외화대납금 반환 및 손해배상금 청구소송

회사는 1997년 7월 24일자로 Canadian Imperial Bank of Commerce (이하 "CIBC")에 한화투자증권(주)(구, 현투증권(주)) 발행주식 13백만주를 매각하였으며, 이와 관련하여 현대중공업(주)는 CIBC와 동 주식의 재매입에 관한 약정(Share Option Agreement)을 체결한 바 있습니다. 동 재매입 약정과 관련하여 회사와 상기 거래를 주선한 현대증권(주)는 연명으로 동 약정상의 현대중공업(주)의 의무가 현대중공업(주)에 부담을 주지 않도록 한다는 내용의 각서를 현대중공업(주)에 제공하였고, 회사는 유사한 내용의 각서를 현대증권(주)로부터 징구받았습니다. 현대중공업(주)는 2000년 7월에 CIBC의 요구에 따라 USD 220,480천에 상기 주식을 매입하고, 동 매입대금의 지급을 회사와 현대증권(주)에 요청하였습니다. 그러나 회사는 현대중공업(주)와 CIBC간의 거래에 회사가 직접 관여한 바 없었고 위 각서는 경영상의 책임을 분담한다는 의미이며 법적인 보증이 아니라는 점을 이유로 위의 요청을 거부하였습니다.

이에 현대중공업(주)는 회사와 현대증권(주) 및 동 발행주식 매각 당시 현대증권(주)의 대표이사를 상대로 외화대납금 반환 및 손해배상청구소송을 2000년 7월 28일 자로 법원에 제기하였습니다. 상기 소송의 결과로 2002년 1월 25일자 1심 판결에서 법원은 회사와 현대증권(주) 및 동 발행주식 매각 당시 현대증권(주)의 대표이사 등 3인의 공동피고에 대해 현대중공업(주)에 주식매입대금의 70%인 171,822백만원의 손해배상금 지급을 명령하는 원고 일부승소를 선고한 바 있습니다. 이에 회사는 동 1심 판결금액의 임시 귀속분 및 이에 대한 이자 123,677백만원을 현대중공업(주)에 지급하고 이에

대해 2002년 2월 항소하였습니다. 2006년 6월 14일 항소심 판결에서 법원은 주식매입대금의 약 80%인 192,942백만원의 손해배상금 지급을 명하는 원고 일부승소 판결을 하였습니다.

회사는 동 항소심 판결금액의 임시 귀속분 및 이에 대한 이자 1,926백만원을 현대중공업(주)에 추가로 지급하고 이에 대하여 2006년 6월 30일자로 대법원에 상고하였습니다.

대법원은 2009년 3월 26일자로 3심 판결에서 현대증권(주)와 상기 발행주식 매각 당시 현대증권(주)의 대표이사에 대해서는 제2심의 판결내용을 그대로 인정하면서, 회사에 대한 부분에 대하여는 회사가 현대중공업(주)에 대해 비용상환의무가 있다는 점을 이유로 서울고등법원으로 파기환송을 선고한 바, 서울고등법원은 2009년 8월 21일자 파기환송심 판결에서 회사가 현대중공업(주)에 제공한 각서에 따른 약정에 기한책임을 인정하여, 현대중공업(주)의 청구금액에서 현대증권(주)가 현대중공업(주)에 지급한 금액을 변제 총당한 나머지 금액인 167,219백만원 및 지연이자의 지급을 명하는 원고 일부승소 판결을 하였습니다.

이에 회사는 상기 판결금액에서 회사가 1심 판결 및 2심 판결에 따라 현대중공업(주)에 지급한 금액을 차감한 나머지 금액인 86,226백만원을 현대중공업(주)에 지급 완료하였습니다. 그러나 현대중공업(주)는 2009년 9월 10일자로 대법원에 상고한 바, 대법원은 2012년 2월 9일자 재상고심 판결에서 이 사건 주식의 시가를 공제한 원심판단에 위법이 있다는 이유로, 원심판결의 원고 패소부분 중 4,284백만원 및 이에 대한지연손해금 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다고 선고하였습니다.

이에 회사는 지연이자 부담을 감면하기 위하여, 대법원 판결선고 직후 현대중공업(주)와 조건부 변제 합의를 하고 청구원리금 7,971백만원을 가지급 완료하였습니다. 한편서울고등법원은 2012년 7월 13일자 재파기환송심 판결에서 대법원의 파기 환송 취지에 따라 원고 일부 승소 판결을 하였으며, 동 판결에 따라 회사는 2012년 8월 2일에 회사가 추가로 지급하여야 할 944백만원을 현대중공업(주)에게 지급 완료하였습니다. 또한 회사는 이에 대하여 상고 실익을 검토한 결과 상고하지 않기로 결정하였고, 현대중공업(주)도 이에 대해 상고하지 않음에 따라 본 소송은 최종 확정, 종결 되었습니다.

또한 현대중공업(주)는 상기의 한화투자증권(주)의 주식매입과 관련하여 발생한 법인세비용 등과 관련하여 2004년 12월에 회사와 현대증권(주) 및 당시 현대증권(주)의 대표이사를 상대로 50,303백만원을 청구하는 별도의 소송을 서울중앙지방법원에 제기하였습니다. 상기 소송의 결과로 2009년 10월 22일자 1심 판결에서 서울중앙지방법원은 회사와 현대증권(주) 및 동 발행주식 매각 당시 현대증권(주)의 대표이사 등 3인의 공동피고에 대해 현대중공업(주)에 청구금액 전부 및 지연이자의 지급을 명령하는 원고 승소를 선고하였고, 이에 회사와 현대증권(주)는 동 1심 판결금액 73,692백만원을 현대중공업(주)에 지급하고, 이에 대해 2009년 11월 11일자로 항소하였습니다. 2011년 11월 10일 항소심 판결에서 법원은 현대중공업의 청구금액 중 48,770백만원 및 지연이자의 지급을 명령하는 원고 일부 승소를 선고하여 1심 판결 결과를 일부 감축하였습니다. 이에 대해 회사와 현대증권(주) 및 현대중공업(주)는 2011년 11월 25일 대법원에 상고 하였습니다. 상기 소송의 최종결과는 보고기간 종료일 현재 예측될 수 없으며 이로 인한 영향은 중요할 수 있습니다.

#### □ 기타의 소송 및 특허 Claim 등

연결회사는 상기 소송을 포함하여 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며 향후 자원의 유출가능성이 매우 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다. 그러나 보고기간 종료일 현재 이러한 우발상황의 최종결과는 예측될 수 없으며 이로

인한 영향은 중요할 수 있습니다.

## 나. 채무보증 현황

(단위: 백만원)

채무자 (회사와의 관계)	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간 (개시일~종료일)	비고
종업원	한국외환은행, 국민은행	28	28	2000.12.06 ~	- . 우리스주관련 금융기관 차입금 지급보증

## 다. 그 밖의 우발채무 등

### □ 특허라이선스 계약

연결회사는 보고기간 종료일 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이선스 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이선스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

### □ 공업용수공급계약

연결회사는 2001년에 베올리아워터산업개발(주) ("Veolia")와 2001년 3월부터 2013년 3월까지 총 12년간 공업용수를 공급받는 계약을 체결하였습니다. 그리고 2006년 12월에 2018년 3월까지의 연장계약을 체결하였으며 이후 공장 등 신설공사에 따른 수정계약을 체결한 바 있습니다. 동 계약에 의하면 연결회사는 계약기간 동안 Base Service Charge ("BSC")와 공급받는 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additional Service Charge ("ASC")를 Veolia에 지급해야 합니다.

### □ HITECH와 후공정서비스계약

연결회사는 2009년 중 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하였습니다. 그리고 HITECH은 회사 및 회사의 종속기업인 SKHYMC로부터 기계장치를 매입하기로 계약하였으며, 설립 후 5년 동안 연결회사에 대한 후공정 서비스 제공을 위하여 동 매입 장비를 배타적으로 사용하기로 하였습니다. 이후 연결회사는 2011년 중 HITECH과 기존 후공정 서비스 공급계약과 연계하여 모듈서비스 공급을 추가하는 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 의하면 연결회사는 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 후공정서비스 가격을 지불하기로 하였습니다.

## 라. 사모자금의 사용내역

2012년 2월 당사 보통주 101,850,000주에 대한 제3자배정 방식의 유상증자 결과(발행가액: 23,000원), 2012년 2월 14일 2,342,550백만원의 대금이 납입되었으며, 당사는 시설자금결제와 운영자금결제 및 기타비용으로 자금을 집행하여 본 보고서 제출일 현재 사모자금의 사용을 모두 완료하였습니다.

## 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2013년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등
주권상장법인사모증자 (증권시장사모)	2012년 02월 14일	2,342,550	-	- 운영자금: 2,107,816 - 시설자금: 218,161 - 기타(발행비용): 16,573	-

## 3. 녹색경영 현황

### 가. 온실가스·에너지 관리업체 지정

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스·에너지 관리업체 지정·관리 지침(환경부 고시 제2010-109호)'에 따라 2010년 9월 30일 산업·발전 부문 관리 업체로 지정되었습니다.

매년 주어지는 온실가스 및 에너지 배출 할당량을 달성하기 위해 당사는 온실가스 에너지 목표관리제 TF를 조직하여 기후변화의 영향에 신속하고 체계적으로 대응하고 있습니다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2012년 온실가스 배출량은 2,766,192톤 CO<sub>2</sub>e (tCO<sub>2</sub>e), 에너지 사용량은 37,198 테라줄(TJ)입니다.

## 4. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

### 가. 가족친화기업 인증

당 인증은 '가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률' 제15조에 따라 가족친화 사회환경의 조성을 촉진하기 위하여 가족친화 제도를 모범적으로 운영하고 있는 기업 또는 공공기관을 대상으로 하는 인증 제도입니다.

당사는 구성원, 고객, 주주, 투자자, 협력업체 등 모든 이해관계자의 행복을 목표로 상고 노력을 기울여왔으며 구성원의 행복증진을 위해 다양한 가족친화경영 프로그램을 운영하고 있습니다.

이러한 성과를 인정받아 2009년 11월 17일 제조분야 대기업 및 전자업계 최초로 가족친화기업 인증을 받았고, 2012년에 인증연장을 받았습니다.

## XI. 재무제표 등

### 1. 연결재무제표

#### 연결 재무상태표

제 66 기 3분기말 2013.09.30 현재

제 65 기말            2012.12.31 현재

제 64 기말            2011.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 66 기 3분기말	제 65 기말	제 64 기말
자산			
유동자산	6,802,076	5,313,573	4,936,850
현금및현금성자산	600,784	658,387	1,243,788
단기금융상품	2,491,256	1,126,229	632,139
매출채권	2,188,907	1,719,521	1,540,925
기타수취채권	163,874	125,055	201,999
재고자산	1,153,245	1,509,331	1,183,608
매각예정자산	27,068	26,958	29,033
당기법인세자산	18,695	12,719	10,642
기타금융자산	878		1
기타유동자산	157,369	135,373	94,715
비유동자산	13,735,214	13,335,120	12,301,298
조인트벤처 및 관계기업 투자	103,022	104,100	103,613
매도가능금융자산	49,581	44,297	47,492
유형자산	11,950,509	11,586,192	10,899,308
무형자산	1,055,582	983,630	707,648
투자부동산	28,929	29,888	31,168
기타수취채권	41,720	19,127	38,461
기타금융자산	1,977	525	3,441
이연법인세자산	227,747	378,366	315,718
기타비유동자산	276,147	188,995	154,449
자산총계	20,537,290	18,648,693	17,238,148
부채			
유동부채	3,495,675	4,441,180	4,817,286
매입채무	691,013	592,738	678,408
미지급금	620,416	381,260	516,724
기타지급채무	541,880	361,076	345,878



유동총당부채	97,067	330,615	353,467
기타금융부채	2,625	17,020	38,678
차입금	1,472,522	2,719,197	2,830,426
기타유동부채	62,726	25,906	42,535
당기법인세부채	7,426	13,368	11,170
비유동부채	4,727,911	4,468,071	4,545,591
차입금	3,806,805	3,752,779	3,946,039
기타지급채무	186,300	97,533	94,326
확정급여부채	646,270	575,096	458,699
기타금융부채	44,689	1,615	7,796
기타비유동부채	43,847	41,048	38,731
부채총계	8,223,586	8,909,251	9,362,877
자본			
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	12,314,377	9,740,156	7,875,742
자본금	3,568,645	3,488,419	2,978,498
자본잉여금	3,406,148	3,053,874	1,229,052
기타포괄손익누계액	(57,240)	(115,402)	107,107
기타자본항목			5,762
이익잉여금(결손금)	5,396,824	3,313,265	3,555,323
비지배지분	(673)	(714)	(471)
자본총계	12,313,704	9,739,442	7,875,271
자본과부채총계	20,537,290	18,648,693	17,238,148

연결 포괄손익계산서

제 66 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지

제 65 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지

제 65 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

제 64 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 66 기 3분기		제 65 기 3분기		제 65 기	제 64 기
	3개월	누적	3개월	누적		
매출액	4,083,621	10,797,415	2,423,482	7,443,823	10,162,210	10,395,811
매출원가	2,379,274	6,848,384	2,014,255	6,347,051	8,550,989	8,704,921
매출총이익	1,704,347	3,949,031	409,227	1,096,772	1,611,221	1,690,890
판매비와경상개발비	539,866	1,353,997	433,249	1,379,093	1,838,570	1,321,795
영업이익(손실)	1,164,481	2,595,034	(24,022)	(282,321)	(227,349)	369,095
금융수익	340,882	423,947	196,004	454,615	689,709	630,310
금융비용	279,218	572,844	177,223	509,897	682,594	911,399
지분법 손익	5,665	13,369	4,077	11,036	16,713	10,533
기타영업외수익	6,995	30,765	15,534	52,138	67,130	72,446
기타영업외비용	219,058	249,506	9,186	35,290	62,910	125,838

법인세비용차감전순이익(손실)	1,019,747	2,240,765	5,184	(309,719)	(199,301)	45,147
법인세비용	61,511	157,055	3,143	12,770	(40,506)	101,118
당기순이익(손실)	958,235	2,083,710	2,041	(322,489)	(158,795)	(55,971)
기타포괄손익	(219,646)	58,121	(75,020)	(94,379)	(305,601)	68,850
보험수리적손익	(17)	(52)	(254)	(268)	(82,872)	(60,780)
매도가능금융자산평가손익	(4,074)	2,684	(449)	2,962	(1,896)	7,129
해외사업환산손익	(209,365)	54,903	(71,435)	(96,853)	(216,490)	123,236
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지 분	(6,190)	586	(2,882)	(220)	(4,343)	(735)
총포괄손익 소계	738,589	2,141,831	(72,979)	(416,868)	(464,396)	12,879
당기순이익(손실)의 귀속						
지배기업의 소유지분	958,278	2,083,680	1,885	(322,392)	(158,886)	(56,641)
비지배지분	(42)	30	156	(97)	91	670
총포괄손익의 귀속						
지배기업의 소유지분	738,837	2,141,790	(73,046)	(416,673)	(464,267)	12,947
비지배지분	(247)	41	67	(195)	(129)	(68)
지배기업의 소유지분에 대한 주당이익						
기본주당이익(원)	1,349	2,934	3	(476)	(233)	(96)
희석주당이익(원)	1,289	2,934	(12)	(476)	(233)	(96)

연결 자본변동표

제 66 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지  
제 65 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지  
제 65 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지  
제 64 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

(단위 : 백만원)

		자본							비지배지분	자본 합계
		지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본								
		자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계 액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주 에게 귀속되는 자본 합계			
2011.01.01 (기초자본)		2,969,023	1,193,100	(23,261)	5,762	3,761,299	7,905,923	1,653	7,907,576	
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)				(56,641)	(56,641)	670	(55,971)	
		보험수리적손익					(60,780)	(60,780)		(60,780)
		매도가능금융자산평가손익			7,905			7,905	(776)	7,129
		부의지분법자본변동			(735)			(735)		(735)
		해외사업환산손익			123,198			123,198	38	123,236
		총포괄손익			130,368		(117,421)	12,947	(68)	12,879
	자본에 직접 변영된 소유 주와의 거래	유상증자								
		연차배당					(88,541)	(88,541)		(88,541)
		전환사채의 전환	9,475	36,193				45,668		45,668
		주식선택권 행사								
		주식선택권 소멸								
		종속기업의 지분율변동효과								
		연결범위의 변동							(2,056)	(2,056)
		지배력을 상실하지 않는 종 속기업에 대한 지배기업의 소유지분 변동								
기타의 변동			(241)		(14)	(255)		(255)		
자본에 직접변영된 소유주와	9,475	35,952			(88,555)	(43,128)	(2,056)	(45,184)		

		의 거래 소계									
2011.12.31 (기말자본)			2,978,498	1,229,052	107,107	5,762	3,555,323	7,875,742	(471)	7,875,271	
2012.01.01 (기초자본)			2,978,498	1,229,052	107,107	5,762	3,555,323	7,875,742	(471)	7,875,271	
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					(158,886)	(158,886)	91	(158,795)	
		보험수리적손익					(82,872)	(82,872)		(82,872)	
		매도가능금융자산평가손익			(1,896)			(1,896)		(1,896)	
		부의지분법자본변동			(4,343)			(4,343)		(4,343)	
		해외사업환산손익			(216,270)			(216,270)	(220)	(216,490)	
		총포괄손익			(222,509)		(241,758)	(464,267)	(129)	(464,396)	
	자본에직접 반영된 소유 주와의 거래	유상증자	509,250	1,816,726					2,325,976		2,325,976
		연차배당									
		전환사채의 전환	52	210					262		262
		주식선택권 행사	619	4,440		(2,200)			2,819		2,819
		주식선택권 소멸		3,562		(3,562)					
		종속기업의 지분율변동효과									
		연결범위의 변동									
		지배력을 상실하지 않는 종 속기업에 대한 지배기업의 소유지분 변동		(76)					(76)	(105)	(181)
		기타의 변동						(300)	(300)	(9)	(309)
		자본에직접반영된 소유주와 의 거래 소계	509,921	1,824,822		(5,762)	(300)		2,328,681	(114)	2,328,567
2012.12.31 (기말자본)			3,488,419	3,053,874	(115,402)		3,313,265	9,740,156	(714)	9,739,442	
2012.01.01 (기초자본)			2,978,498	1,229,052	107,107	5,762	3,555,323	7,875,742	(471)	7,875,271	
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					(322,392)	(322,392)	(97)	(322,489)	
		보험수리적손익					(260)	(260)	(8)	(268)	
		매도가능금융자산평가손익			2,962				2,962		2,962
		부의지분법자본변동			(220)				(220)		(220)
		해외사업환산손익			(96,763)				(96,763)	(90)	(96,853)
		총포괄손익			(94,021)		(322,652)	(416,673)	(195)	(416,868)	
	자본에직접 반영된 소유 주와의 거래	유상증자	509,250	1,816,726					2,325,976		2,325,976
		연차배당									
		전환사채의 전환	36	147					183		183
		주식선택권 행사	468	3,322		(1,662)			2,128		2,128
		주식선택권 소멸									
		종속기업의 지분율변동효과									
		연결범위의 변동									
		지배력을 상실하지 않는 종 속기업에 대한 지배기업의 소유지분 변동		(74)					(69)	(143)	(105)
		기타의 변동							(69)	(143)	(105)
		자본에직접반영된 소유주와 의 거래 소계	509,754	1,820,121		(1,662)	(69)		2,328,144	(105)	2,328,039
2012.09.30 (기말자본)			3,488,252	3,049,173	13,086	4,100	3,232,602	9,787,213	(771)	9,786,442	
2013.01.01 (기초자본)			3,488,419	3,053,874	(115,402)		3,313,265	9,740,156	(714)	9,739,442	
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					2,083,680	2,083,680	30	2,083,710	
		보험수리적손익					(51)	(51)		(51)	
		매도가능금융자산평가손익			2,684				2,684		2,684
		부의지분법자본변동			586				586		586
		해외사업환산손익			54,892				54,892	11	54,903
		총포괄손익			58,162			2,083,629	2,141,791	41	2,141,832
	자본에직접 반영된 소유 주와의 거래	유상증자									
		연차배당									
		전환사채의 전환	80,226	352,208					432,434		432,434
		주식선택권 행사									
주식선택권 소멸											

	종속기업의 자본율변동효과								
	연결범위의 변동								
	지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 지배기업의 소유지분 변동								
	기타의 변동		66			(70)	(4)		(4)
	자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	80,226	352,274			(70)	432,430		432,430
2013.09.30 (기말자본)		3,568,645	3,406,148	(57,240)		5,396,824	12,314,377	(673)	12,313,704

### 연결 현금흐름표

제 66 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지  
제 65 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지  
제 65 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지  
제 64 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 66 기 3분기	제 65 기 3분기	제 65 기	제 64 기
영업활동현금흐름	4,652,778	1,598,458	2,211,651	2,855,960
영업으로부터 창출된 현금흐름	4,765,405	1,761,722	2,420,894	3,079,865
이자수취	39,111	64,086	81,931	68,107
이자지급	(152,043)	(219,075)	(275,169)	(275,866)
배당금수취	17,414	12,098	12,098	8,883
법인세의환급(납부)	(17,109)	(20,373)	(28,103)	(25,029)
투자활동현금흐름	(3,919,118)	(4,326,710)	(4,698,379)	(3,389,264)
단기금융상품의 감소	2,114,846	1,725,112	2,754,789	2,653,392
단기금융상품의 증가	(3,479,392)	(2,346,962)	(3,252,006)	(2,334,896)
기타금융자산의 증가	(29,670)			(5,983)
기타금융자산의 처분	29,682			
기타수취채권의 감소	1,414	4,485	11,487	10,182
기타수취채권의 증가	(4,193)	(7,308)	(8,661)	(7,379)
국고보조금의 수령		153	153	67
파생상품거래로 인한 현금유입	2,663	2,363	2,419	19,013
파생상품거래로 인한 현금유출	(6,319)	(44,175)	(44,507)	(5,974)
매각예정자산의 처분		23	23	6,931
관계기업투자의 취득				(12,180)
매도가능금융자산의 처분	331	9,422	11,190	
매도가능금융자산의 취득	(2,032)	(1,621)	(3,618)	(7,897)
유형자산의 처분	13,640	35,006	35,809	14,371
유형자산의 취득	(2,370,781)	(3,319,569)	(3,772,879)	(3,568,238)
무형자산의 처분	200	4	1,226	13,946
무형자산의 취득	(189,507)	(108,911)	(159,072)	(176,111)
투자부동산의 처분				12,153

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름				(661)
종속기업의 지배력획득		(274,732)	(274,732)	
재무활동현금흐름	(786,490)	2,093,463	1,917,122	519,133
차입금의 증가	2,801,959	5,327,800	6,966,003	2,434,510
차입금의 상환	(3,588,449)	(5,562,258)	(7,377,491)	(1,826,595)
보통주의 발행		2,328,102	2,328,791	
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동		(181)	(181)	(241)
'배당금의 지급				(88,541)
현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	(4,773)	(3,344)	(15,795)	4,733
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(57,603)	(638,133)	(585,401)	(9,438)
기초현금및현금성자산	658,387	1,243,788	1,243,788	1,253,226
기말현금및현금성자산	600,784	605,655	658,387	1,243,788

## 2. 재무제표(별도)

### 재무상태표

제 66 기 3분기말 2013.09.30 현재

제 65 기말 2012.12.31 현재

제 64 기말 2011.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 66 기 3분기말	제 65 기말	제 64 기말
자산			
유동자산	6,145,217	4,695,907	4,307,194
현금및현금성자산	335,611	477,747	980,359
단기금융상품	2,419,608	1,074,661	588,528
매출채권	2,071,358	1,622,659	1,417,886
기타수취채권	202,174	184,907	298,260
재고자산	963,893	1,199,485	928,891
매각예정자산			5
당기법인세자산	4,972	11,014	9,493
기타금융자산	878		
기타유동자산	146,723	125,434	83,772
비유동자산	13,971,129	13,507,577	12,086,716
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,305,125	3,259,185	2,989,863
매도가능금융자산	49,185	43,901	47,327

유형자산	9,322,309	8,944,484	7,902,653
무형자산	763,388	713,688	705,807
투자부동산	28,929	29,888	31,168
기타수취채권	45,357	20,065	30,208
기타금융자산	566	521	3,436
이연법인세자산	181,099	307,918	221,935
기타비유동자산	275,171	187,927	154,319
자산총계	20,116,346	18,203,484	16,393,910
부채			
유동부채	3,369,131	4,240,679	4,496,983
매입채무	804,589	737,207	840,146
미지급금	640,678	377,239	489,684
기타지급채무	495,192	335,020	320,395
유동충당부채	101,466	335,752	449,696
기타금융부채	396	13,764	34,315
차입금	1,286,335	2,427,207	2,343,892
기타유동부채	40,475	14,490	18,855
비유동부채	4,220,573	4,003,162	3,693,866
차입금	3,324,585	3,317,533	3,130,094
기타지급채무	176,572	79,614	70,617
퇴직급여부채	633,101	565,495	448,430
기타금융부채	44,689	1,615	7,796
기타비유동부채	41,626	38,905	36,929
부채총계	7,589,704	8,243,841	8,190,849
자본			
자본금	3,568,645	3,488,419	2,978,498
자본잉여금	3,444,363	3,092,155	1,267,257
기타포괄손익누계액	11,163	8,479	10,375
기타자본항목			5,762
이익잉여금(결손금)	5,502,471	3,370,590	3,941,169
자본총계	12,526,642	9,959,643	8,203,061
자본과부채총계	20,116,346	18,203,484	16,393,910

#### 포괄손익계산서

제 66 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지

제 65 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지

제 65 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

제 64 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 66 기 3분기		제 65 기 3분기		제 65 기	제 64 기
	3개월	누적	3개월	누적		
매출액	3,982,663	10,617,834	2,384,163	7,398,194	10,001,783	10,188,162
매출원가	2,376,991	6,983,426	2,188,089	6,682,761	8,947,795	8,479,381
매출총이익	1,605,672	3,634,408	196,074	715,433	1,053,988	1,708,781
판매비와경상개발비	498,414	1,216,516	393,084	1,260,731	1,670,273	1,176,758
영업이익(손실)	1,107,258	2,417,892	(197,010)	(545,298)	(616,285)	532,023
금융수익	328,524	361,477	182,357	418,408	627,348	521,195
금융비용	264,134	513,287	152,908	435,632	606,002	786,628
기타영업외수익	9,736	26,575	16,035	57,251	64,646	77,587
기타영업외비용	10,380	34,595	11,541	35,659	46,584	107,864
법인세비용차감전순이익(손실)	1,171,004	2,258,062	(163,067)	(540,930)	(576,877)	236,313
법인세비용	57,953	126,125	82	(2,490)	86,887	(107,171)
당기순이익(손실)	1,113,051	2,131,937	(163,149)	(538,440)	(489,990)	129,142
기타포괄손익	(4,094)	2,628	(459)	2,939	(82,485)	(50,254)
매도가능금융자산평가손익	(4,074)	2,684	(449)	2,962	(1,896)	7,906
보험수리적손익	(20)	(56)	(10)	(23)	(80,589)	(58,160)
총포괄손익 소계	1,108,957	2,134,565	(163,608)	(535,501)	(572,475)	78,888
지배기업의 소유지분에 대한 주 당이익						
기본주당이익(원)	1,567	3,002	(235)	(794)	(719)	218
계속영업기본주당이익(손 실)	1,567	3,002	(235)	(794)	(719)	218
희석주당이익(원)	1,503	3,002	(244)	(794)	(719)	218
계속영업희석주당이익(손 실)	1,503	3,002	(244)	(794)	(719)	218

**자본변동표**

제 66 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지

제 65 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지

제 65 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

제 64 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

(단위 : 백만원)

		자본						
		자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계 액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계	
2011.01.01 (기초자본)		2,969,023	1,231,064	2,469	5,762	3,958,228	8,167,046	
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)				129,142	129,142	
		보험수리적손익				(58,160)	(58,160)	
		매도가능금융자산평가손 익			7,906			7,906
		총포괄손익			7,906		70,982	78,888
	주식선택권의행사							
	주식선택권의소멸							
	전환사채의전환	9,475	36,193				45,668	
	배당금지급					88,541	88,541	
유상증자								

2011.12.31 (기말자본)			2,978,498	1,267,257	10,375	5,762	3,941,169	8,203,061
2012.01.01 (기초자본)			2,978,498	1,267,257	10,375	5,762	3,941,169	8,203,061
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					(489,990)	(489,990)
		보험수리적손익					(80,589)	(80,589)
		매도가능금융자산평가손익			(1,896)			(1,896)
		총포괄손익			(1,896)		(570,579)	(572,475)
	주식선택권의행사	619	4,400		(2,200)		2,819	
	주식선택권의소멸		3,562		(3,562)			
	전환사채의전환	52	210				262	
	배당금지급							
	유상증자	509,250	1,816,726				2,325,976	
	2012.12.31 (기말자본)			3,488,419	3,092,155	8,479	3,370,590	9,959,643
2012.01.01 (기초자본)			2,978,498	1,267,257	10,375	5,762	3,941,169	8,203,061
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					(538,440)	(538,440)
		보험수리적손익					(24)	(24)
		매도가능금융자산평가손익			2,961			2,961
		총포괄손익			2,961		(538,464)	(535,503)
	주식선택권의행사	468	3,323		(1,662)		2,129	
	주식선택권의소멸							
	전환사채의전환	37	146				183	
	배당금지급							
	유상증자	509,250	1,816,726				2,325,976	
	2012.09.30 (기말자본)			3,488,252	3,087,452	13,337	4,100	3,402,706
2013.01.01 (기초자본)			3,488,419	3,092,155	8,479	3,370,590	9,959,643	
자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)					2,131,937	2,131,937
		보험수리적손익					(55)	(55)
		매도가능금융자산평가손익			2,683			2,683
		총포괄손익			2,683		2,131,882	2,134,565
	주식선택권의행사							
	주식선택권의소멸							
	전환사채의전환	80,226	352,209				432,435	
	배당금지급							
	유상증자							
	2013.09.30 (기말자본)			3,568,645	3,444,363	11,163	5,502,471	12,526,642

### 현금흐름표

제 66 기 3분기 2013.01.01 부터 2013.09.30 까지

제 65 기 3분기 2012.01.01 부터 2012.09.30 까지

제 65 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지

제 64 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 66 기 3분기	제 65 기 3분기	제 65 기	제 64 기
영업활동현금흐름	3,872,093	498,359	924,749	1,817,256
영업으로부터 창출된 현금흐름	3,954,985	612,809	1,086,482	1,975,138
이자수취	36,104	62,091	76,376	65,503



이자지급	(142,452)	(195,133)	(255,180)	(231,595)
배당금수취	17,414	18,019	18,019	8,882
법인세납부(환급)	6,042	573	(948)	(672)
투자활동현금흐름	(3,289,584)	(3,493,225)	(3,899,695)	(2,526,151)
단기금융상품의 감소	2,009,751	1,543,435	2,354,352	1,983,348
파생상품거래로 인한 현금유입	2,663	2,363	2,418	19,013
기타수취채권의 감소	15,755	40,133	40,674	11,661
매각예정자산의 처분		23	23	6,931
매도가능금융자산의 처분	331	9,422	11,190	
기타금융자산의 처분	29,670			
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	368			14,420
유형자산의 처분	17,065	31,962	36,139	9,207
무형자산의 처분	200	4	1,226	10,107
투자부동산의 처분				12,151
파생상품거래로 인한 현금 유출	(6,319)	(44,175)	(44,506)	(51,381)
매도가능금융자산의 취득	(2,032)	(1,390)	(3,387)	(11,163)
단기금융상품의 증가	(3,354,697)	(2,049,898)	(2,840,486)	(1,727,508)
기타금융자산의 증가	(29,670)			
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(46,655)	(282,492)	(282,492)	(12,426)
유형자산의 취득	(1,757,057)	(2,625,629)	(3,001,628)	(2,613,485)
무형자산의 취득	(165,014)	(108,781)	(158,879)	(175,242)
기타수취채권의 증가	(3,943)	(8,202)	(14,339)	(320)
기타투자활동으로 인한 현금유출				(1,464)
재무활동현금흐름	(723,570)	2,435,732	2,472,334	730,964
차입금의 증가	2,588,026	5,180,354	6,538,147	1,990,943
차입금의 상환	(3,311,596)	(5,072,726)	(6,394,604)	(1,171,438)
보통주의발행		2,328,104	2,328,791	
배당금의 지급				(88,541)
지배력을 상실하지 않은 종속기업에 대한 소유지분의 변동				
현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	0	0		(1,756)
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(141,061)	(559,134)	(502,612)	20,313
기초현금및현금성자산	477,747	980,359	980,359	960,046
기말현금및현금성자산	335,611	421,226	477,747	980,359

### 3. 대손충당금 설정현황

가. 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률
제66기 3분기	매출채권	2,193,216	4,310	0
	장·단기 대여금	9,151	6	0
	장·단기 미수금	177,351	13,512	8
	장·단기 미수수익	16,305	0	0
	장·단기 보증금	13,370	204	2
	장·단기 예치금	4,710	1,569	33
	장기성 외상매출금	104	104	100
	합 계	2,414,207	19,705	1
제65기 연간	매출채권	1,722,778	3,257	0
	장·단기 대여금	8,459	6	0
	장·단기 미수금	128,016	15,950	12
	장·단기 미수수익	8,569	0	0
	장·단기 보증금	12,039	179	1
	장·단기 예치금	4,796	1,561	33
	장기성 외상매출금	176	176	100
	합 계	1,884,834	21,131	1
제64기 연간	매출채권	1,544,780	3,855	0
	장·단기 대여금	10,784	6	0
	장·단기 미수금	143,738	16,127	11
	장·단기 미수수익	7,565	0	0
	장·단기 보증금	10,086	155	2
	장·단기 예치금	86,121	1,547	2
	장기성 외상매출금	74	74	100
	합 계	1,803,149	21,764	1

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

나. 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제66기 3분기	제65기	제64기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	21,131	21,764	21,567
2. 순대손처리액(① - ② ± ③)	-	-	324
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	324
② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	(1,426)	(633)	521
4. 기말 대손충당금 잔액합계	19,705	21,131	21,764

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

#### 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분		설정 기준
매출채권	1)정상채권	-.과거 경험률을 바탕으로 설정
	2)장기채권	-.거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정 -.담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정 -.담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

\* 연결대상회사 매출채권 충당금 설정 제외

#### 라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 :백만원, %)

구분		6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금액	일반	2,170,541	79	93	887	2,171,600
	특수관계자	21,617	0	0	0	21,617
	계	2,192,157	79	93	887	2,193,216
구성비율		100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

## 4. 재고자산 현황 등

### 가. 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제66기 3분기	제65기	제64기	비고
반도체	제품	440,962	563,251	384,231	-
	재공품	497,656	683,352	530,123	-
	원재료	132,811	175,986	137,742	-
	저장품	49,619	42,165	44,761	-
	미착품	32,197	44,577	86,752	-
	합계	1,153,245	1,509,331	1,183,608	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]		5.6%	8.1%	6.9%	-

재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	6.9회	6.4회	7.1회	-
---	------	------	------	---

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

## 나. 재고자산의 실사내역

실사내역	실사 일자	입회자	비고
제품	2013-02-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2013-01-01	삼일회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2011-12-01	삼일회계법인/ 삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2011-01-01	한영회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2010-01-01	한영회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2009-12-30		-

## 5. 채무증권 발행실적 등

### 가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2013년 09월 30일 )

(단위 : 백만원, %)

종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환여부	주관회사
회사채	공모	2011년 01월 14일	200,000	6.35	BBB+ (NICE신평/한기평/한신평)	2015년 01월 14일	미상환	우리투자증권
회사채	공모	2011년 05월 06일	400,000	6.20	A- (NICE신평/한기평/한신평)	2016년 05월 06일	미상환	NH투자증권
회사채	공모	2012년 09월 04일	200,000	3.72	A (NICE신평/한기평/한신평)	2017년 09월 04일	미상환	신한금융투자
회사채	사모	2012년 05월 30일	550,000	5.35	A (한신평)	2019년 05월 30일	미상환	삼성증권 외
회사채	공모	2010년 05월 14일	537,800	2.65	B1(Moody's), B+(S&P)	2015년 05월 14일	미상환	Credit Suisse
회사채	사모	2012년 06월 20일	107,560	-	A (S&P)	2017년 06월 20일	미상환	Shinhan Asia Limited

기업어음증권	사모	2012년 05월 25일	100,000	3.90	A2 (NICE신평/한기평/한신평)	2015년 05월 26일	미상환	동양증권
기업어음증권	사모	2012년 05월 25일	100,000	3.90	A2 (NICE신평/한기평/한신평)	2015년 05월 26일	미상환	한양증권
기업어음증권	사모	2012년 06월 20일	20,000	3.63	A2 (NICE신평/한기평/한신평)	2014년 06월 24일	미상환	하이투자증권
기업어음증권	사모	2012년 06월 20일	80,000	3.63	A2 (NICE신평/한기평/한신평)	2014년 06월 24일	미상환	KTB증권
기업어음증권	사모	2012년 07월 05일	70,000	3.63	A2 (NICE신평/한기평/한신평)	2014년 07월 07일	미상환	한양증권
합 계	-	-	2,365,360	-	-	-	-	-

※ 외화로 발행된 회사채의 경우 기준일의 환율을 적용하였습니다.

#### 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	170,000	200,000	-	-	370,000
	합계	-	-	-	-	170,000	200,000	-	-	370,000

#### 다. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 08월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	737,800	400,000	200,000	-	-	-	1,337,800
	사모	-	-	-	107,560	-	550,000	-	657,560
	합계	-	737,800	400,000	307,560	-	550,000	-	1,995,360

**마. 신종자본증권 미상환 잔액**

(기준일 : 2013년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

**바. 조건부자본증권 미상환 잔액**

(기준일 : 2013년 09월 30일 )

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## XII. 부속명세서

### 1. 공정가치평가 절차요약

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다..

수준	내용
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

보고기간 종료일 현재 공정가치로 측정된 회사의 자산과 부채는 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위: 백만원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계
자산				
당기손익인식금융자산				
파생상품자산	-	1,121	-	1,121
매도가능금융자산				
시장성있는 지분증권	36,309	-	-	36,309
합 계	36,309	1,121	-	37,430
부채				
당기손익인식금융부채				
파생상품부채	-	47,314	-	47,314
합 계	-	47,314	-	47,314

<전기말>

(단위: 백만원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계
자산				
당기손익인식금융자산				
파생상품자산	-	198	-	198
매도가능금융자산				

시장성있는 지분증권	32,932	-	-	32,932
합 계	32,932	198	-	33,130
부채				
당기손익인식금융부채				
파생상품부채	-	18,635	-	18,635
합 계	-	18,635	-	18,635

연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법을 사용하고 있습니다.

구분	공정가치	수준	평가기법
파생상품자산			
통화선도	879	2	현재가치기법
이자율스왑	242	2	현재가치기법
파생상품부채			
이자율스왑	2,946	2	현재가치기법
전환옵션	44,368	2	옵션가격결정모형

## 2. 유형자산의 공정가치와 그 평가방법

당사는 한국채택국제회계기준 2011년 도입을 위해 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준 최초채택' 규정에 의거 토지자산의 개별항목별 공정가치를 간주원가로 사용하였습니다.

당사의 토지자산에 대한 공정가치 평가는 다음과 같습니다.

- (1) 평가기관: (주)가온감정평가법인
- (2) 평가대상: 유형자산 중 토지자산
- (3) 평가금액: 4,383억원

- (4) 공정가액 추정시 사용한 방법 및 중요한 가정

:전문 감정평가기관(가온감정평가법인)의 감정평가를 기초로 회사 토지에 대한 재평가를 수행하였으며, 「부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 의거 공시지가를 기준하여 평가한 금액과 「감정평가에 관한 규칙」 제10조제1항의 규정에 따라 원가방식, 비교방식, 수익방식의 세가지 방식 중 대상 부동산의 성격, 평가목적 또는 평가조건을 고려하여 적정하다고 판단되는 거래사례비교법에 의한 시산가격을 비교·검토하여 최종 평가금액을 산정함.

- (5) 원가모형 비교

:재평가된 유형자산이 토지에 대해 원가모형을 적용하여 평가하였을 경우 장부금액은 2,567억원입니다.

공정가치평가 결과는 한국채택국제회계기준 도입기준일인 2011년 1월 1일에 장부에 반영하고, 한국채택국제회계기준 전환일인 2010년 1월 1일의 재무상태표에 포함하여 비교 표시하였습니다.



## 【 전문가의 확인 】

### 1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.

### 2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.